
股票简称：长电科技

股票代码：600584



江苏长电科技股份有限公司

与

中银国际证券股份有限公司

关于

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复（修订稿）

保荐机构



上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼

二〇一八年三月

中国证券监督管理委员会：

贵会于 2017 年 11 月 23 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172097 号）（以下简称“一次反馈意见”）已收悉。

江苏长电科技股份有限公司会同中银国际证券股份有限公司、江苏世纪同仁律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构对《一次反馈意见》进行了认真核查和逐项落实，并于 2018 年 2 月 2 日向贵会提交了书面反馈意见回复。根据公司的最新情况，相关各方对书面反馈意见回复的部分内容进行了修订（该修订内容已在本反馈回复中以**楷体加粗**的字体显示），请予以审核。

（除非文义另有所指，本回复中的简称与《中银国际证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》中的简称具有相同涵义。本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，主要系四舍五入造成。）

目 录

一、重点问题	2
重点问题一	2
重点问题二	2
重点问题三	9
重点问题四	13
重点问题五	22
重点问题六	28
重点问题七	54
重点问题八	59
重点问题九	126
重点问题十	138
重点问题十一	145
重点问题十二	163
重点问题十三	166
二、一般问题	170
一般问题一	170
一般问题二	173
一般问题三	176
一般问题四	179
一般问题五	183
一般问题六	186

一、重点问题

重点问题一

1、本次非公开发行已确定的认购对象中，芯电半导体（上海）有限公司及国家集成电路产业投资基金股份有限公司为持有申请人股份 5%以上的股东。请上述认购对象出具从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份的承诺并公开披露。

回复：

公司本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，公司持股 5%以上股东产业基金已就从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份事项出具承诺如下：

“自本次非公开发行的定价基准日前六个月至本次非公开发行完成后六个月内，本公司将不减持所持长电科技的股份；本承诺为不可撤销的承诺，如违反上述承诺，本公司承诺减持所得全部收益归长电科技所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

公司持股 5%以上股东芯电半导体已就从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不减持所持股份事项出具承诺如下：

“自长电科技本次非公开发行定价基准日前六个月至长电科技本次非公开发行完成后六个月内，本公司将不减持所持长电科技股份；本承诺为不可撤销的承诺，如本公司违反上述承诺而发生减持情况，本公司承诺因减持所得全部收益归长电科技所有，并依法承担由此产生的法律责任。”

公司已公开披露上述承诺内容。

重点问题二

2、请保荐机构核查发行对象是否具备履行认购义务的能力；全面核查各出资人的认购资金来源，对其是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购等情形发表明确意见，并提供相

关工作底稿。

回复：

根据公司第六届董事会第九次临时会议决议、《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行对象为产业基金、芯电半导体及金投领航。

一、产业基金

（一）关于履行认购义务能力的说明

产业基金系经国务院批准，为促进国家集成电路产业发展而设立的国家产业投资基金，主营业务为运用多种形式投资集成电路行业内企业，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，自 2014 年 9 月设立以来投资了多家集成电路行业内企业。

产业基金目前注册资本为 987.2 亿元，产业基金本次认购金额不超过 29 亿元。产业基金经审计的 2016 年度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日
流动资产	6,500,202.98
非流动资产	21.92
资产总额	6,500,224.90
流动负债	4,322.49
非流动负债	24,657.91
负债总额	28,980.40
所有者权益	6,471,244.50
项目	2016 年度
营业收入	20,488.70
营业利润	195,254.05
利润总额	214,839.82
净利润	213,085.33

注：产业基金 2017 年度财务报告尚未完成审计。

根据上表内容，产业基金 2016 年末的资产总额约为 650.02 亿元，所有者权益约为 647.12 亿元，2016 年度净利润约为 21.31 亿元，财务状况良好。相较产业基金本次拟不超过 29 亿元的认购金额而言，产业基金的资产和利润规模均较大，具备履行认购义务的能力。

2018 年 1 月，产业基金出具《承诺函》，承诺：“在中国证券监督管理委员会

会（以下简称“中国证监会”）核准本次非公开发行后至发行人及/或保荐人（主承销商）向本公司发出缴款通知书期间，本公司具备履行本次非公开发行的股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，按时、足额将本公司应缴的出资缴付至指定账户，参与本次非公开发行的认购。本公司资产、资信状况良好，截至本承诺函出具之日，不存在任何影响本公司认购本次非公开发行股票的情形。”

经核查，保荐机构认为：产业基金财务状况良好，履约能力较强，具备履行本次发行相应认购义务的能力。

（二）关于认购资金来源等情形的说明

目前产业基金主要股东包括财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、武汉金融控股（集团）有限公司、上海国盛（集团）有限公司和中国移动通信集团公司等。

2018年1月，产业基金出具《承诺函》，承诺：“本公司参与本次非公开发行的认购资金系本公司自有资金，资金来源合法合规。本公司参与本次非公开发行的认购资金不存在对外募集、代持、结构化安排，未直接或间接来源于长电科技或其关联方，非通过与长电科技进行资产置换或其他交易方式获得，不存在占用长电科技或其子公司的资金或要求长电科技或其子公司提供担保的情形。”

2018年1月，发行人及发行人持股5%以上的未参与本次认购的股东新潮集团分别出具《承诺函》，承诺其及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购长电科技2017年非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。

经核查，保荐机构认为：产业基金参与长电科技本次非公开发行股票的认购资金来源于其自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排，未直接或间接使用长电科技及其关联方资金用于本次认购。

二、芯电半导体

（一）关于履行认购义务能力的说明

芯电半导体系中芯国际(香港联交所股票代码:0981,纽交所股票代码:SMI)全资附属子公司,中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。根据中芯国际于2018年1月出具的《承诺函》,中芯国际将通过增资或股东借款的方式向芯电半导体支付其履行本次非公开发行认购义务所需的资金。

芯电半导体本次认购总金额不超过65,000万元。中芯国际公开披露的2016年度主要财务数据如下:

单位:千美元

项目	2016年12月31日
流动总资产	3,683,753
非流动总资产	6,431,525
总资产	10,115,278
流动总负债	1,980,900
非流动总负债	2,731,151
总负债	4,712,051
总权益	5,403,227
项目	2016年度
收入	2,914,180
营业利润	339,206
年内利润	316,434

注:中芯国际尚未公开披露2017年度财务数据。

根据上表内容,中芯国际的2016年末资产总额约为101.15亿美元,总权益约为54.03亿美元,2016年度收入约为29.14亿美元,年内利润约为3.16亿美元,财务状况良好。鉴于芯电半导体本次认购的资金来源于中芯国际,相较芯电半导体本次拟不超过6.5亿元的认购金额而言,中芯国际的资产和利润规模均较大,具备履行认购义务的能力。

2018年1月,芯电半导体出具《承诺函》,承诺:“在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准本次非公开发行后至发行人及/或保荐人(主承销商)向本公司发出《缴款通知书》期间,本公司具备履行本次非公开发行认购义务所需要的资金,从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定,按时、足额将本公司应缴的出资缴付至指定账户,参与本次非公开发行的认购;截至本承诺函出具之日,本公司资产、资信状况良好,不存在任何影响本公司认购长电科技本次非公开发行的情形。”

2018年1月,中芯国际出具《承诺函》,承诺:“在中国证券监督管理委员会

会（以下简称“中国证监会”）核准本次非公开发行后至发行人及/或保荐人（主承销商）发出《缴款通知书》期间，本公司将通过增资或股东借款的方式向芯电半导体（上海）有限公司支付其履行本次非公开发行认购义务所需要的资金，确保芯电半导体（上海）有限公司按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，按时、足额将应缴付的认购资金支付至指定账户，参与本次非公开发行的认购。”

经核查，保荐机构认为：中芯国际已承诺将通过增资或股东借款的方式向芯电半导体提供本次认购所需资金，中芯国际财务状况良好，芯电半导体具备履行本次发行相应认购义务的能力。

（二）关于认购资金来源等情形的说明

芯电半导体作为一人有限责任公司，其股权结构中不存在结构化安排的情形。

2018年1月，芯电半导体出具《承诺函》，承诺：“本公司参与长电科技本次非公开发行的认购资金系本公司自有资金或自筹资金，资金来源合法。本公司本次非公开发行的认购资金不存在对外募集、代持、结构化安排，未直接或间接来源于长电科技及其关联方，非通过与长电科技进行资产置换或其他交易方式获得，不存在占用长电科技及其子公司的资金或要求长电科技及其子公司提供担保的情形。”

2018年1月，发行人及发行人持股5%以上的未参与本次认购的股东新潮集团分别出具《承诺函》，承诺其及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购长电科技2017年非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。

经核查，保荐机构认为：芯电半导体参与长电科技本次非公开发行股票认购资金主要来源于其股东中芯国际对其增资或借款，不存在对外募集、代持、结构化安排，未直接或间接使用长电科技及其关联方资金用于本次认购。

三、金投领航

（一）关于履行认购义务能力的说明

金投领航系无锡金投浦银投资管理有限公司和无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）为出资人的私募股权投资基金。其中，无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）系由江苏省政府、无锡市政府和上海浦银安盛资产管理有限公司等主体共同发起成立的股权投资基金。金投领航主要围绕无锡及周边地区企业进行产业升级、并购相关投资。

金投领航本次认购总金额不超过 5 亿元。经核查金投领航的《合伙协议》，金投领航的基金规模为 50.01 亿元人民币。根据金投领航提供的截至 2017 年 10 月 31 日的财务报表（未经审计），其主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017 年 10 月 31 日
流动资产	58,515.62
非流动资产	40,644.86
资产总额	99,160.48
流动负债	0.91
非流动负债	0
负债总额	0.91
所有者权益	99,159.58
项目	2017 年 1-10 月
营业收入	-
营业利润	-703.21
利润总额	-703.21
净利润	-703.21

根据上表内容，金投领航截至 2017 年 10 月 31 日的流动资产约为 5.85 亿元，资产总额约为 10 亿元，所有者权益约为 10 亿元，财务状况良好。相较金投领航本次拟不超过 5 亿元的认购金额而言，金投领航的资产规模较大，具备履行认购义务的能力。

2018 年 1 月，金投领航出具《承诺函》，承诺：“在中国证监会核准本次非公开发行后至发行人及/或保荐人（主承销商）发出《缴款通知书》期间，具备履行本次非公开发行股票认购义务所需要的资金，从而按照本次非公开发行的相关合同、协议的约定，按时、足额将本公司应缴的出资缴付至指定账户，参与本次非公开发行的认购；本企业资产、资信状况良好，不存在任何影响本企业认购长电科技本次非公开发行股票的情形。”

经核查，保荐机构认为：金投领航财务状况良好，具备履行本次发行相应认购义务的能力。

(二) 关于认购资金来源等情形的说明

经核查金投领航的《合伙协议》，金投领航投资人之间不存在优先级享受固定收益、劣后级享受浮动收益的结构化安排条款。

截至 2017 年 9 月 30 日，金投领航穿透后最终出资人合计 13 名，金投领航合伙人及其穿透后的最终出资人中不存在长电科技董监高以及持股 5% 以上股东等关联方，其穿透后的最终出资人情况如下：

序号	出资人名称/姓名	出资人类型
1	无锡商业大厦大东方股份有限公司	上海证券交易所上市公司
2	中国人寿保险股份有限公司	上海证券交易所上市公司
3	上海浦东发展银行股份有限公司	上海证券交易所上市公司
4	安盛投资管理公司	外国（地区）企业
5	江苏省财政厅	政府机关
6	无锡市人民政府	政府机关
7	上海市国有资产监督管理委员会	政府机关
8	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会	政府机关
9	江苏省产权交易所（江苏省股权登记中心）	事业单位
10	无锡广播电视集团	事业单位
11	王晓明	自然人
12	戈政	自然人
13	范淼	自然人

2017 年 9 月，金投领航出具《承诺函》，承诺：“本企业参与长电科技本次非公开发行股票认购资金系本企业自有资金或自筹资金，资金来源合法合规。本企业不存在为认购长电科技本次非公开发行股票对外募集资金情况，本企业认购长电科技本次非公开发行股票不存在代持情况。本企业及本企业合伙人之间不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排。本企业本次非公开发行股票认购资金未直接或间接来源于长电科技及其关联方，未通过与长电科技进行资产置换或其他交易方式获得任何资金，不存在占用长电科技及其子公司的资金或要求长电科技及其子公司提供担保的情形。”

2017 年 9 月，金投领航的合伙人无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）、无锡金投浦银投资管理有限公司分别出具《承诺函》，承诺：“本企业/公司不存在为认购长电科技本次非公开发行股票对外募集资金的情况，本企业/公司参与长电科技本次非公开发行股票认购资金系本企业/公司自有资金或自筹资

金，资金来源合法合规。本企业/公司对金投领航的出资均为本企业/公司真实出资，不存在通过协议、信托或任何其他方式为他人代为持有合伙份额的情形。本企业/公司对金投领航的出资不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排。本企业/公司本次非公开发行股票的认购资金未直接或间接来源于长电科技及其关联方，未通过与长电科技进行资产置换或其他交易方式获得任何资金，不存在占用长电科技及其子公司的资金或要求长电科技及其子公司提供担保的情形。”

2018年1月，发行人及发行人持股5%以上的未参与本次认购的股东新潮集团分别出具《承诺函》，承诺其及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购长电科技2017年非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。

经核查，保荐机构认为：金投领航参与长电科技本次非公开发行股票的认购资金为其自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排，未直接或间接使用长电科技及其关联方资金用于本次认购。

重点问题三

3、申请人与发行对象签订的附条件生效合同的违约责任条款未明确约定违约责任的承担方式，请保荐机构及申请人律师就违约责任是否明确、违约赔偿金金额是否合理，以及是否能够防止侵害上市公司股东利益发表核查意见。

回复：

发行人与各发行对象在《股份认购协议》或《附条件生效之股份认购协议之补充协议》（以下称“《补充协议》”）中对违约责任约定的具体情况如下：

一、发行人与产业基金关于违约责任的约定

（一）《股份认购协议》中对违约责任的约定

发行人（“甲方”）与产业基金（“乙方”）签署的《股份认购协议》对违约责任的约定如下：

“11.1 除本协议另有约定外，本协议任何一方如存在虚假不实陈述，或违反其声明、承诺、保证，或不履行其在本协议项下的任何责任与义务的，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方赔偿相应损失。

11.2 本次非公开发行事宜如未获得（1）甲方股东大会通过；或/和（2）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成甲方违约，亦不构成甲方的缔约过失责任；双方应友好协商后续处理事宜。

11.3 若因任何一方（包括一方的高级管理人员、员工等内幕信息知情人）违反本协议约定的保密义务，公开地或非公开地泄露信息，或利用内幕信息买卖甲方股票等原因导致本协议所述之交易未能完成，或因任何一方不履行本协议项下有关义务或不履行法律法规规定的有关强制性义务，其结果实质性地导致本协议不能生效或本协议所述之交易不能完成，则违约方需向守约方赔偿因其违约行为导致守约方所蒙受的经济损失。”

（二）《补充协议》对违约责任的约定

2018年1月，发行人（“甲方”）与产业基金（“乙方”）签署了《补充协议》对违约责任的约定如下：

“4、在《股份认购协议》及本补充协议生效且甲方适当启动非公开发行股票认购程序后，乙方应当按照保荐机构（主承销商）发出的股票认购价款缴纳通知书的要求，将认购总金额及时足额汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门指定的账户，否则乙方将承担以下违约责任：

除因甲方原因导致外，乙方未能按照股票认购价款缴纳通知书载明的期限足额缴纳认购总金额的，自股票认购价款缴纳通知书载明的缴款截止日起每逾期一日须向甲方就应付而未付金额的万分之一支付滞纳金；逾期超过15个工作日的，乙方应当在逾期满15个工作日的第二日起一个月内向甲方支付其应付而未付金额的1%的违约金。”

二、发行人与芯电半导体关于违约责任的约定

（一）《股份认购协议》中对违约责任的约定

发行人（“甲方”）与芯电半导体（“乙方”）签署的《股份认购协议》对违约责任的约定如下：

“11.1 除本协议另有约定外，本协议任何一方如存在虚假不实陈述，或违反其声明、承诺、保证，或不履行其在本协议项下的任何责任与义务的，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方赔偿相应损失。

11.2 本次非公开发行事宜如未获得（1）甲方股东大会通过；或/和（2）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成甲方违约，亦不构成甲方的缔约过失责任；双方应友好协商后续处理事宜。

11.3 若因任何一方（包括一方的高级管理人员、员工等内幕信息知情人）违反本协议约定的保密义务，公开地或非公开地泄露信息，或利用内幕信息买卖甲方股票等原因导致本协议所述之交易未能完成，或因任何一方不履行本协议项下有关义务或不履行法律法规规定的有关强制性义务，其结果实质性地导致本协议不能生效或本协议所述之交易不能完成，则违约方需向守约方赔偿因其违约行为导致守约方所蒙受的经济损失。”

（二）《补充协议》对违约责任的约定

2018年1月，发行人（“甲方”）与芯电半导体（“乙方”）签署了《补充协议》对违约责任的约定如下：

“3、在《股份认购协议》及本补充协议生效且甲方适当启动非公开发行股票的认购程序后，乙方应当按照保荐机构（主承销商）发出的《股票认购价款缴纳通知书》的要求，将认购总金额及时足额汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门指定的账户，否则乙方将承担以下违约责任：

除因甲方原因导致外，乙方未能按照《股票认购价款缴纳通知书》载明的期限足额缴纳认购总金额的，自股票认购价款缴纳通知书载明的缴款截止日起每逾期一日须向甲方就应付而未付金额的万分之一支付滞纳金；逾期超过15个工作日的，视为乙方未按《股份认购协议》约定的认购金额认购，乙方应当在逾期满15个工作日的第二日起一个月内向甲方支付其应付而未付金额的1%的违约金。”

三、发行人与金投领航关于违约责任的约定

（一）《股份认购协议》中对违约责任的约定

发行人（“甲方”）与金投领航（“乙方”）签署的《股份认购协议》对违约责任的约定如下：

“11.1 除本协议另有约定外，本协议任何一方如存在虚假不实陈述，或违反其声明、承诺、保证，或不履行其在本协议项下的任何责任与义务的，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方赔偿相应损失。

11.2 本次非公开发行事宜如未获得（1）甲方股东大会通过；或/和（2）中国证监会及/或其他有权主管部门（如需）的核准及/或豁免，不构成甲方违约，亦不构成甲方的缔约过失责任；双方应友好协商后续处理事宜。

11.3 若因任何一方（包括一方的高级管理人员、员工等内幕信息知情人）违反本协议约定的保密义务，公开地或非公开地泄露信息，或利用内幕信息买卖甲方股票等原因导致本协议所述之交易未能完成，或因任何一方不履行本协议项下有关义务或不履行法律法规规定的有关强制性义务，其结果实质性地导致本协议不能生效或本协议所述之交易不能完成，则违约方需向守约方赔偿因其违约行为导致守约方所蒙受的经济损失。”

（二）《补充协议》对违约责任的约定

2018年1月，发行人（“甲方”）与金投领航（“乙方”）签署了《补充协议》对违约责任的约定如下：

“在《股份认购协议》及本补充协议生效且甲方启动非公开发行股票的认购程序后，乙方应当按照保荐机构（主承销商）发出的《股票认购价款缴纳通知书》的要求，将认购总金额及时足额汇入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门指定的账户，否则乙方将承担以下违约责任：

除因甲方原因导致外，乙方未能按照《股票认购价款缴纳通知书》载明的期限足额缴纳认购总金额的，自股票认购价款缴纳通知书载明的缴款截止日起每逾期一日须向甲方就应付而未付金额的万分之一支付滞纳金；逾期超过15个工作

日的，视为乙方未按《股份认购协议》约定的认购金额认购，乙方应当在逾期满15个工作日的第二日起一个月内向甲方支付其应付而未付金额的1%的违约金（不含滞纳金）。因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方还应当另行向甲方赔偿损失。”

四、保荐机构及申请人律师核查意见

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人与各发行对象已通过《股份认购协议》或其《补充协议》明确约定了违约责任的具体形式及违约赔偿金额，违约责任明确，违约赔偿金额合理，能够有效防止侵害上市公司股东利益。

重点问题四

4、资管产品或有限合伙等作为发行对象

1) 关于资管产品或有限合伙等作为发行对象的适格性

请申请人补充说明：a. 作为认购对象的资管产品或有限合伙等是否按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理了登记或备案手续，请保荐机构和申请人律师进行核查，并分别在《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《法律意见书》、《律师工作报告》中对核查对象、核查方式、核查结果进行说明；b. 资管产品或有限合伙等参与本次认购，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定；c. 委托人或合伙人之间是否存在分级收益等结构化安排，如无，请补充承诺；d. 申请人、控股股东、实际控制人及其关联方是否公开承诺，不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。

2) 关于资管合同或合伙协议、附条件生效的股份认购合同的必备条款

请申请人补充说明，资管合同或合伙协议、附条件生效的股份认购合同是否明确约定：a. 委托人或合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与申请人的关联关系等情况；b. 在非公开发行获得我会核准后、发行方案于我

会备案前，资管产品或有限合伙资金募集到位；c. 资管产品或有限合伙无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任；d 在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

针对委托人或合伙人与申请人存在关联关系的，除前述条款外，另请申请人补充说明：资管合同或合伙协议，是否明确约定委托人或合伙人遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务；依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将委托人或合伙人与产品或合伙企业认定为一致行动人，将委托人或合伙人直接持有的公司股票数量与产品或合伙企业持有的公司股票数量合并计算。资管合同或合伙协议是否明确约定，管理人或普通合伙人应当提醒、督促与公司存在关联关系的委托人或有限合伙人，履行上述义务并明确具体措施及相应责任。

3) 关于关联交易审批程序

针对委托人或合伙人与申请人存在关联关系的，请申请人补充说明：a. 公司本次非公开发行预案、产品合伙或合伙协议、附条件生效的股份认购合同，是否依照有关法规和公司章程的规定，履行关联交易审批程序和信息披露义务，以有效保障公司中小股东的知情权和决策权；b. 国有控股上市公司董监高或其他员工作为委托人或合伙人参与资管产品或有效合伙，认购公司非公开发行股票，是否需要取得主管部门的批准，是否符合相关法规对国有控股企业高管或员工持有公司股份的规定。

4) 关于信息披露及中介机构意见

请申请人公开披露前述资管合同或合伙协议及相关承诺；请保荐机构和申请人律师就上述事项补充核查，并就相关情况是否合法合规，是否有效维护公司及其中小股东权益发表明确意见。

回复：

一、关于资管产品或有限合伙等作为发行对象的适格性

(一) 作为认购对象的资管产品或有限合伙办理登记或备案手续的情况

1、核查对象

公司本次非公开发行的发行对象为芯电半导体、产业基金、金投领航。其中金投领航为有限合伙企业，该发行对象应当按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定办理备案手续。

2、核查方式

保荐机构及发行人律师履行的核查方式包括但不限于以下方式：

（1）查阅了《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规；

（2）查阅了金投领航《营业执照》、《合伙协议》；

（3）登录“国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）”查询了金投领航的公示信息；

（4）登录“中国证券投资基金业协会（<http://www.amac.org.cn/>）”网站查询金投领航及其基金管理人的备案和登记情况；

（5）查阅了金投领航及其合伙人出具的《承诺函》。

3、核查结果

经核查，金投领航已于2017年8月18日完成中国证券投资基金业协会的私募基金备案，基金编号为SW4419；金投领航的基金管理人无锡金投资本管理有限公司于2015年4月23日完成中国证券投资基金业协会基金管理人的登记，登记编号为P1011019。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行对象金投领航及其基金管理人均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定于中国证券投资基金业协会分别办理了私募投资基金备案手续和私募基金管理人登记手续。

保荐机构和发行人律师已经将上述核查对象、核查方式、核查结果分别在《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《补充法律意见书》中进行了说明。

（二）资管产品或有限合伙等参与本次认购，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定

根据《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定，“非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：（一）特定对象符合股东大会决议规定的条件；（二）发行对象不超过十名。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。”根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定，“《上市公司证券发行管理办法》所称‘发行对象不超过 10 名’，是指认购并获得本次非公开发行股票的法人、自然人或者其他合法投资组织不超过 10 名；证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。”

经发行人第六届董事会第十四次会议、2017 年第四次临时股东大会、第六届董事会第八次临时会议及**第六届董事会第九次临时会议**的批准，发行人本次非公开发行的对象为芯电半导体、产业基金、金投领航，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条第（一）项“特定对象符合股东大会决议规定的条件”的规定。

发行人本次非公开发行的发行对象共 3 名，且不包括境外战略投资者及信托公司，发行人已分别与上述 3 名发行对象签订了《股份认购协议》，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条第（二）项“发行对象不超过十名”的规定和《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。

发行对象中，金投领航为依法设立并有效存续的有限合伙企业，已在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案，具备参与本次认购的主体资格，属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条规定的其他合法投资组织。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：金投领航参与本次认购，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。

（三）委托人或合伙人之间不存在分级收益等结构化安排

经核查金投领航的《合伙协议》，金投领航的《合伙协议》中不存在分级收

益等结构化安排条款，金投领航的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。

2017年9月，金投领航出具《承诺函》，承诺：“本企业及本企业合伙人之间不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排。”

2017年9月，金投领航的合伙人无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）、无锡金投浦银投资管理有限公司分别出具《承诺函》，承诺：“本企业/公司对金投领航的出资不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排。”

经核查，保荐机构和发行人律师认为：本次发行对象中有限合伙的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。

（四）申请人及其持股5%以上的股东关于不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对投资公司、资管产品及其受托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿的承诺

2018年1月，公司及公司持股5%以上的股东新潮集团分别出具《承诺函》，承诺：“本公司及本公司关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购本公司/长电科技2017年非公开发行股票的投资公司、资管产品及其受托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿”。

2018年1月，公司持股5%以上的股东芯电半导体、产业基金分别出具《承诺函》，承诺：“本公司及本公司关联方将遵守《证券发行与承销管理办法》的相关规定，不以直接或间接方式对参与认购长电科技本次非公开发行股票的基金产品、资管产品及其受托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿”。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行人及其持股5%以上的股东已做出不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次发行的投资公司、资管产品及其受托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿的承诺。

二、关于资管合同或合伙协议、附条件生效的股份认购合同的必备条款

（一）受托人或合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与申请人的关联关系等情况的约定

根据金投领航全体合伙人签署的《合伙协议》，金投领航的合伙人共 2 名，合伙人及认缴出资情况如下：

合伙人名称	合伙人类别	出资方式	认缴出资额（万元）
无锡金投浦银投资管理有限公司	普通合伙人	货币	100
无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	500,000
合计			500,100

金投领航全体合伙人均在其《合伙协议》中承诺为符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的合格投资者，财产来源及用途符合国家有关规定，并保证其向基金管理人提供的财产收入情况和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法。

根据发行人与金投领航签署的《股份认购协议》、金投领航及其合伙人分别出具的《承诺函》：金投领航本次认购资金系自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，金投领航及其合伙人之间不存在分级收益、杠杆融资等结构化的安排；金投领航及其合伙人与长电科技及其董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的主要股东等关联方不存在关联关系，不存在直接或间接接受长电科技及长电科技前述关联方提供财务资助或补偿的情形。

经核查金投领航合伙人及其穿透后的最终出资人（金投领航的合伙人及其穿透后的最终出资人情况详见本反馈回复“重点问题二”），金投领航及其合伙人与长电科技及其董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的主要股东等关联方不存在关联关系，不存在直接或间接接受长电科技及长电科技前述关联方提供财务资助或补偿的情形。

（二）在非公开发行获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前，资管产品或有限合伙资金募集到位的约定

关于募集资金到位时间，发行人与金投领航签署的《股份认购协议》第 9.2 条中已明确约定：“在甲方本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准，且发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，保证本次非公开发行的认购资金及时、足额到位。”

同时，金投领航及其合伙人均已出具《承诺函》，承诺：本次认购长电科技

非公开发行股票认购资金将于本次非公开发行股票获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前募集到位，如认购资金未在前述期间内到位产生违约，将承担违约责任。

（三）资管产品或有限合伙无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任

金投领航已于 2016 年 9 月 20 日在无锡市工商行政管理局注册成立，并取得统一社会信用代码为 91320200MA1MUKAY9P 的《营业执照》。2017 年 8 月 18 日，金投领航完成在中国证券投资基金业协会的私募基金备案，基金编号为 SW4419；金投领航的基金管理人无锡金投资本管理有限公司于 2015 年 4 月 23 日完成中国证券投资基金业协会基金管理人的登记，登记编号为 P1011019。

发行人与金投领航签署的《股份认购协议》第 9.2 条约定：“在甲方本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准，且发行方案于中国证券监督管理委员会备案前，保证本次非公开发行的认购资金及时、足额到位”；第 11.1 条约定：“除本协议另有约定外，本协议任何一方如存在虚假不实陈述，或违反其声明、承诺、保证，或不履行其在本协议项下的任何责任与义务的，即构成违约。违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方赔偿相应损失。”

（四）委托人或合伙人在锁定期内不得转让其持有的产品份额或退出合伙的约定

发行人与金投领航签署的《补充协议》第 5 条约定：“乙方承诺：乙方在甲方本次非公开发行股票中认购的股票，自该等股票上市之日起 36 个月内不以任何方式转让，上述锁定期内，乙方的委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。”

同时，金投领航的合伙人均已出具《承诺函》，承诺其持有的金投领航合伙份额自长电科技本次非公开发行股票结束之日起，36 个月内不以任何方式转让。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：

在金投领航《合伙协议》、《股份认购协议》及其《补充协议》、金投领航出具的《承诺函》中，包含了合伙人的具体身份、人数、认购资金来源、与发行人

的关联关系等内容；已就在非公开发行获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前，资管产品或有限合伙资金募集到位进行了约定或承诺；已就认购方无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任进行了约定；已就金投领航及其合伙人在锁定期内不得转让其持有的产品份额或退出合伙进行了约定或承诺。

三、关于关联交易审批程序

本次发行对象金投领航的合伙人与发行人不存在关联关系，具体如下：

根据金投领航提供的资料及在“国家企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn/>）”的查询，截至2017年9月30日，金投领航穿透后最终出资人合计13名，金投领航合伙人及其穿透后的最终出资人中不存在长电科技董监高以及持股5%以上股东等关联方（金投领航合伙人及其穿透后最终出资人情况详见本反馈回复“重点问题二”之“三、金投领航”）。同时，2017年9月，金投领航出具了《承诺函》，承诺：“本企业与长电科技及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的主要股东等关联方不存在关联关系，本企业不存在直接或间接接受长电科技及长电科技前述关联方提供财务资助或补偿的情形。”

2017年9月，金投领航的合伙人无锡太湖浦发股权投资基金企业（有限合伙）、无锡金投浦银投资管理有限公司分别出具了《承诺函》，承诺：“本企业/公司与长电科技及其董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的主要股东等关联方不存在关联关系，本企业/公司不存在直接或间接接受长电科技及长电科技前述关联方提供财务资助或补偿的情形。”

2018年1月，发行人及发行人持股5%以上的未参与本次认购的股东新潮集团分别出具了《承诺函》，承诺其及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购长电科技2017年非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。

2018年1月，发行人及发行人持股5%以上的未参与本次认购的股东新潮集团分别出具了《承诺函》，承诺其及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与认购长电科技2017年非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务

资助或者补偿。

综上，保荐机构和发行人律师认为：本次非公开发行发行对象金投领航的合伙人与发行人不存在关联关系。

四、关于信息披露及中介机构意见

公司已公开披露前述《合伙协议》及相关承诺。

保荐机构和发行人律师查阅了发行人与金投领航签署的《股份认购协议》或其《补充协议》，金投领航及其合伙人的《合伙协议》，金投领航及其合伙人分别出具的《承诺函》。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：发行对象金投领航及其基金管理人均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定于中国证券投资基金业协会分别办理了私募投资基金备案手续和私募基金管理人登记手续。金投领航参与本次认购，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。本次发行对象中有限合伙的合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。发行人及其持股 5% 以上的股东已做出不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次发行的投资公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿的承诺。

在金投领航《合伙协议》、《股份认购协议》及其《补充协议》、金投领航出具的《承诺函》中，包含了合伙人的具体身份、人数、认购资金来源、与发行人的关联关系等内容；已就在非公开发行获得证监会核准后、发行方案于证监会备案前，资管产品或有限合伙资金募集到位进行了约定或承诺；已就认购方无法有效募集成立时的保证措施或者违约责任进行了约定；已就金投领航及其合伙人在锁定期内不得转让其持有的产品份额或退出合伙进行了约定或承诺。

本次发行对象金投领航的合伙人与发行人不存在关联关系。

金投领航及其合伙人已通过协议或承诺方式对上述相关情况进行了约定或承诺，且《股份认购协议》或其《补充协议》明确约定了认购方的违约责任，能

够有效维护发行人及其中小股东权益。

重点问题五

5、报告期内，申请人及子公司共收到 6 项行政处罚通知书。请申请人说明受到行政处罚的原因及整改情况。请保荐机构和律师核查上述违法情节是否严重，并就申请人是否存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的情形发表明确意见。

回复：

一、公司及子公司行政处罚的原因及整改情况的说明

序号	子公司简称	处罚机关	处罚日期	违法事实发生日期	处罚原因	处罚结果	整改情况
1	SCC	上海市质量技术监督局	2015.9.14	2012.10.1-2015.3.11	使用列入工业产品生产许可证目录但未取得生产许可证的工业氮气	责令改正，罚款 18 万元并没收违法所得	已停止使用现场制氮装置并缴纳罚款，目前 SCC 工厂已经整体搬迁
2	SCC	青浦区市场监督管理局	2015.11.9	2015.7	使用检验不合格的电梯	停止使用检验不合格的特种设备并罚款 15 万元	涉案电梯已经检验合格；已缴纳罚款；目前 SCC 工厂已经整体搬迁
3	SCC	上海市环境保护局	2016.1.22	2015.10	烟尘烟气浓度超标排放、环保设施未保持正常运行	采取限制生产的措施确保大气污染物排放达标并罚款 5 万元	SCC 已缴纳了罚款，目前 SCC 工厂已经整体搬迁
4	SCC	上海浦东国际机场海关	2017.1.25	2015.6.3	向海关申报进口货物编号错误，导致漏缴税款 16,091.24 元	罚款 9,700 元	已缴纳罚款
5	JSCC	江阴市国家税务局	2017.5.18	2017.5.18	未按规定保存、报送开具	终止违法行为并予以纠	已按规定保存、报送开具

序号	子公司简称	处罚机关	处罚日期	违法事实发生日期	处罚原因	处罚结果	整改情况
					发票的数据	正并罚款 310 元	发票的数据并缴纳罚款
6	长电先进	上海浦东国际机场海关	2017.9.12	2015.9.28	进口报关漏报晶圆表面自动检测系统 1 台	罚款 67,300 元	自查发现后主动向海关进行补申报

注：上表中关于整改情况的具体说明详见下一节内容

二、发行人及其子公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的情形

《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定，“上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形”。发行人及子公司在报告期内收到 6 项行政处罚通知书，关于该等违法情节是否严重，以及发行人是否存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项情形的分析如下：

（一）SCC 行政处罚情况

1、星科金朋子公司 SCC 在被发行人收购前（购买日为 2015 年 8 月 5 日）的违法行为所导致的收购日后受到行政处罚的情况

（1）SCC 受上海市质量技术监督局行政处罚情况

2015 年 9 月 14 日，SCC 因使用列入工业产品生产许可证目录但未取得生产许可证的工业氮气，被上海市质量技术监督局责令改正，罚款 18 万元并罚没收违法所得。关于该行政处罚的情况分析如下：

①SCC 该次行政处罚的违法事实发生于 2012 年 10 月 1 日至 2015 年 3 月 11 日期间，发行人于 2015 年 8 月 5 日收购星科金朋，SCC 系星科金朋全资子公司，违法事实发生于公司收购星科金朋前。

②SCC 本次行政处罚的行为未引发安全事故，亦未造成人员伤亡或给他人造成财产损失，未对社会造成重大不利影响。

③SCC 已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款并进行了整改；经保荐机构和发行人律师实地走访确认，SCC 已停止使用本次行政处罚所涉现场制氮装置。

④由于上海市青浦区城市建设总体规划和上海市政府关于西虹桥地区整体开发建设需要等原因,并经无锡市商务局批准,星科金朋已于2017年9月将SCC的资产及业务整体搬迁至其在江阴新设的全资子公司JSCC,SCC已停止运营。前述行政处罚所涉事项已经因工厂搬迁而消除。

经核查,保荐机构和发行人律师认为:SCC本次上海市质量技术监督局的行政处罚所涉及的违法行为发生在被发行人收购前,该等违法行为未引发安全事故,未造成人员伤亡及财产损失,SCC已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款;而且SCC已于2017年9月停止生产运营,行政处罚所涉事项已经因工厂搬迁而消除,不会对发行人生产经营产生重大不利影响,本次行政处罚所涉事项不属于发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

(2) SCC受上海浦东国际机场海关行政处罚情况

2017年1月25日,SCC因2015年6月3日向海关申报进口货物编号错误,导致漏缴税款共计16,091.24元,被上海浦东国际机场海关罚款9,700元。关于该行政处罚的情况分析如下:

①SCC该次行政处罚的违法事实发生于2015年6月3日,发行人于2015年8月5日收购星科金朋,SCC系星科金朋全资子公司,违法事实发生于发行人收购星科金朋前。

②SCC本次行政处罚罚款金额较小,为9,700元,SCC已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款。

③2017年10月10日,上海海关出具《企业信用状况证明》,确认SCC本次被行政处罚所涉行为非重大违反海关法律、行政法规的行为。

经核查,保荐机构和发行人律师认为:SCC本次上海浦东国际机场海关的行政处罚,违法事实发生在被发行人收购前,且罚款金额较小,被行政处罚的行为非重大违反海关法律、行政法规的行为,SCC已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款,本次行政处罚所涉事项不属于发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

2、SCC在收购日后的违法行为所导致的行政处罚情况

(1) SCC 受上海市青浦区市场监督管理局行政处罚情况

2015 年 11 月 9 日，SCC 因 2015 年 7 月开始使用检验不合格的电梯，被上海市青浦区市场监督管理局责令停止使用检验不合格的特种设备并罚款 15 万元。关于该行政处罚的情况分析如下：

①SCC 使用检验不合格的电梯未造成人员伤亡，未对社会造成重大不利影响。

②SCC 已按照行政处罚决定书的要求缴纳了罚款并采取了如下整改措施：经后续按照特种设备相关规定进行检验，涉案电梯已经检验合格；组织员工学习和讨论了《中华人民共和国特种设备安全法》等法规，提高公司全员的安全生产意识，杜绝同类事件再次发生；加强安全生产现场管理，定期排查安全生产隐患；组织开展多种形式宣教活动，加强安全宣传教育和培训；加强安全生产责任制，将安全生产责任落实到具体负责人；在完成对星科金朋的收购后，长电科技安全环保职业卫生处加强了对 SCC 安全生产方面的检查与监督。

③由于上海市青浦区城市建设总体规划和上海市政府关于西虹桥地区整体开发建设需要等原因，并经无锡市商务局批准，星科金朋已于 2017 年 9 月将 SCC 的资产及业务整体搬迁至其在江阴新设的全资子公司 JSCC，SCC 已停止运营，而用于承接 SCC 搬迁资产及业务的江阴新厂 JSCC 已经正常运营。前述行政处罚所涉事项已经因工厂搬迁而消除。

④保荐机构和发行人律师访谈了当地市场监督管理主管部门工作人员，经访谈确认：SCC 本次行政处罚所涉违法行为未造成人员伤亡，未对社会造成不利影响，不属于重大违法违规，本次行政处罚属于轻微处罚，目前 SCC 本次行政处罚所涉事项已整改完毕。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：SCC 本次上海市青浦区市场监督管理局的行政处罚所涉行为未造成人员伤亡，未对社会造成重大不利影响，且 SCC 已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款并进行了整改，本次行政处罚所涉事项已因工厂搬迁而消除。本次行政处罚不属于发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

(2) SCC 受上海市环境保护局行政处罚情况

2016年1月22日，SCC因2015年10月烟尘烟气浓度超标排放、环保设施未保持正常运行被上海市环境保护局处以5万元罚款的行政处罚。关于该行政处罚的情况分析如下：

①SCC已按该行政处罚决定书的要求缴纳了罚款并进行了整改，具体整改措施如下：采取限制生产措施确保大气污染物排放达标；强化管理人员环保考核评价和责任追究制度，完善环境保护制度体系建设，将环境保护责任落实到具体负责人；强化公司内部环保操作规程和员工环保守法意识；在完成对星科金朋的收购后，长电科技安全环保职业卫生处加强了对SCC环境保护方面的检查与监督。

②根据《中华人民共和国环境保护法》第六十条规定“企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭”，SCC本次行政处罚不属于《中华人民共和国环境保护法》规定的被“责令停业、关闭”的行政处罚，不属于情节严重的行政处罚。

③由于上海市青浦区城市建设总体规划和上海市政府关于西虹桥地区整体开发建设需要等原因，并经无锡市商务局批准，星科金朋已于2017年9月将SCC的资产及业务整体搬迁至其在江阴新设的全资子公司JSCC，SCC已停止运营，而用于承接SCC搬迁资产及业务的江阴新厂JSCC已经正常运营。前述行政处罚所涉事项已经因工厂搬迁而消除。

④保荐机构和发行人律师访谈了当地环保主管部门工作人员，经访谈确认：SCC本次行政处罚所涉行为未对社会造成重大不利影响，且本次行政处罚罚款金额较小，不属于情节严重的行政处罚，目前本次行政处罚所涉事项已因工厂搬迁而消除。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：SCC本次上海市环境保护局的行政处罚所涉行为未对社会造成重大不利影响，行政处罚不属于情节严重的行政处罚，SCC已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款并进行了整改，本次行政处罚

所涉事项已因工厂搬迁而消除，本次行政处罚不属于发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

（二）JSCC 行政处罚情况

2017年5月18日，JSCC因未按规定保存、报送开具发票的数据被江阴市国家税务局处以310元罚款的行政处罚（澄国税简[2017]1336号）。关于该行政处罚的情况分析如下：

1、JSCC前述行政处罚涉及金额较小，为310元，并以简易程序作出。

2、JSCC已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款，并对被行政处罚的行为进行了整改，具体整改措施如下：加强对办税人员的培训，增强专业能力，强化税务合规意识；完善业务复核流程，从流程和制度上防范类似事项发生；严格按照规定保存、报送开具发票的数据。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：JSCC本次江阴市国家税务局的行政处罚，处罚决定以简易程序作出，罚款金额较小，不属于情节严重的行政处罚。且JSCC已针对该行政处罚进行了整改，本次行政处罚不属于发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

（三）长电先进行政处罚情况

2017年9月12日，上海浦东国际机场海关向长电先进作出“沪机关缉违字[2017]417号”《行政处罚决定书》，对长电先进科处罚款人民币67,300元。处罚的具体原因为：长电先进委托报关公司上海亚东国际货运有限公司于2015年9月28日以一般贸易方式向海关申报进口晶圆表面自动检测系统1台，结关后，经长电先进自查实际进口货物为晶圆表面自动检测系统2台，与申报不符。关于该行政处罚的情况分析如下：

1、长电先进自查发现漏报情形后，主动委托上海亚东国际货运有限公司向上海浦东国际机场海关进行了补申报，对违法行为进行了纠正。

2、长电先进已按行政处罚决定书的要求缴纳了罚款，并对被行政处罚的行为进行了整改，具体整改措施如下：自查发现后主动向海关进行补申报；建立

学习机制，组织相关线条人员对海关业务进行培训及学习；加强报关自查与复核工作。

3、针对该行政处罚，上海浦东国际机场海关已出具《说明》：2017年9月12日，本单位向江阴长电先进封装有限公司作出“沪机关缉违字[2017]417号”《行政处罚决定书》，江阴长电先进封装有限公司前述被行政处罚行为为主动自查，非主观故意，无故意偷逃海关税款，仅因为工作疏忽，造成违规申报不实行为。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：长电先进本次上海浦东国际机场海关的行政处罚，系因为工作疏忽所致，长电先进无故意偷逃海关税款的行为，且长电先进自查发现漏报后及时进行了纠正，本次行政处罚所涉行为不属于发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形。

综上，保荐机构和发行人律师认为：发行人及其子公司上述行政处罚所涉行为均不属于发行人严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，发行人不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的情形。

重点问题六

6、申请人本次非公开发行拟募集资金 45.5 亿元，投资于“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”、“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”以及偿还银行贷款。

请申请人补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入。（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在董事会前的投入。（3）募投项目与公司之前业务是否存在差异，公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应储备，募投项目实施是否面临重大不确定性风险。（4）结合在手订单或意向性合同说明新增产能的消化措施，募投项目效益的具体测算过程、测算依据和谨慎性。（5）本次募投项目的实施主体，是否存在非全资子公司实施的情况，是否直接或间

接增厚被收购主体的业绩进而影响业绩承诺的有效性。(6) 新增折旧对公司经营业绩的具体影响。

请保荐机构对上述事项进行核查，并对募集资金用途信息披露是否充分合规，相关保障措施是否有效可行，风险揭示是否充分，本次发行是否可能损害上市公司及中小股东的利益发表核查意见。

回复：

一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出及是否使用募集资金投入的说明

(一) 年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目

1、具体投资数额安排明细、资本性支出情况及拟使用募集资金投入情况

“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”总投资为 173,492 万元，其中建设投资 169,498 万元，铺底流动资金 3,994 万元。拟使用募集资金金额为 157,000 万元，全部用于购置设备，均为资本性支出。

该项目投资具体构成、各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金投入金额	是否为资本性支出
1	设备购置费	162,253	157,000	是
2	安装工程费	1,959	0	是
3	工程建设其他费用	349	0	是
4	预备费	4,937	0	否
5	铺底流动资金	3,994	0	否
	总投资	173,492	157,000	-

2、投资数额测算依据和测算过程

(1) 设备购置费

该项目共需购置主要工艺设备仪器 1,651 台（套）。其中进口设备 1,478 台（套），进口设备购置费 22,907 万美元（折合人民币 154,247 万元）；国产设备 173 台（套），国产设备购置费为 8,007 万元。

该项目设备购置费合计 162,253 万元，其中 157,000 万元拟使用本次募集资金投入，剩余部分由公司自筹解决。

该项目设备购置费明细如下：

序号	设备名称	台（套）数	总价 (人民币，万元)
进口设备			
1	全自动磨片机	4	3,501
2	全自动晶圆激光切割机	5	2,323
3	全自动晶圆切割机	36	5,333
4	全自动贴片机	16	15,959
5	全自动装片机	84	13,817
6	全自动倒装机	21	3,394
7	全自动球焊机	1,012	40,886
8	全自动后贴膜机	3	505
9	开短路测试机	6	1,010
10	全自动散热盖机	4	673
11	烤箱	7	280
12	全自动等离子清洗机	13	1,468
13	全自动包封机	15	10,403
14	全自动激光打印机	14	2,545
15	全自动油墨打印机	2	229
16	全自动植球机	2	646
17	全自动回流炉	2	135
18	全自动水洗机	2	121
19	高压水洗机	2	108
20	连续式溅镀机	1	2,626
21	全自冲切分选机	2	539
22	全自动切割分选机	26	8,579
23	全自动切割机	11	1,481
24	开短路测试机	12	566
25	全自动测试机	88	18,100
26	全自动分选机	65	6,599
27	全自动外观检测机	22	4,740
28	全自动外观检测&编带一体机	1	337
29	配套磨具	-	7,340
	合计	1,478	154,247
国产设备			
1	风冷式烤箱	28	339
2	风冷式烤箱	30	363
3	全自动测试机	21	1,837

序号	设备名称	台(套)数	总价 (人民币, 万元)
4	全自动分选机	56	3,433
5	自动编带分选机	19	1,805
6	风冷式烤箱	19	230
	合计	173	8,007

其中设备价格根据国内外供应商报价数据进行综合比较后估算,设备数量根据设计产能估算。

(2) 安装工程费

安装工程费主要为设备配套安装费、建筑安装工程费用,参考同类型安装工程费用标准并适当考虑建设当地造价水平进行估算,金额为 1,959 万元,全部由公司自筹解决。

(3) 工程建设其他费用

工程建设其他费用主要为建设单位管理费、前期工作费、咨询费(可研、环评等),金额为 349 万元,全部由公司自筹解决。

(4) 预备费

预备费用均为基本预备费。基本预备费主要为解决在施工过程中设计变更或调整增加的投资以及为解决意外事故而采取措施所增加的工程项目和费用,主要包括设计变更或调整增加的投资以及工程建设不可预见费用等。该项目预备费用按设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 3% 计算,为 4,937 万元,全部由公司自筹解决。

(5) 铺底流动资金

该项目设置铺底流动资金为 3,994 万元,全部由公司自筹解决。

(二) 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目

1、具体投资数额安排明细、资本性支出情况及拟使用募集资金投入情况

“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”总投资为 235,000 万元,其中建设投资 224,414 万元,铺底流动资金 10,586 万元。拟使用募集资金金额为

140,000 万元，全部用于购置设备，均为资本性支出。

该项目投资具体构成、各项投资构成是否属于资本性支出、是否使用募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金投入金额	是否为资本性支出
1	建筑工程费	2,945	0	是
2	设备购置费	191,413	140,000	是
3	安装工程费	14,212	0	是
4	工程建设其他费用	6,181	0	是
5	预备费	9,664	0	否
6	铺底流动资金	10,586	0	否
	总投资	235,000	140,000	-

2、投资数额测算依据和测算过程

(1) 建筑工程费

该项目建筑工程投资为无尘室装修，参考同类型建筑工程费用标准进行估算，金额为 2,945 万元，全部由公司自筹解决。

(2) 设备购置费

该项目共需购置主要工艺设备仪器 413 台（套），设备购置费金额合计 191,413 万元。其中国产工艺设备 91 台（套），国产工艺设备购置金额 43,550 万元；进口工艺设备 322 台（套），进口工艺设备购置金额 22,609 万美元（折合人民币 147,863 万元）。

该项目设备购置费中 140,000 万元拟使用本次募集资金投入，剩余部分由公司自筹解决。

该项目设备购置费明细如下：

序号	设备名称	数量 (台/套)	合计 (人民币，万元)
进口设备			
1	晶圆金属沉积设备	9	13,440
2	晶圆电镀机	7	19,228
3	外观检测设备	31	9,614
4	磨片机	5	3,270

序号	设备名称	数量 (台/套)	合计 (人民币, 万元)
5	切割设备	30	7,129
6	分选编带机	52	9,575
7	表面清洗设备	9	3,924
8	贴膜/揭膜设备	13	9,385
9	Pull test	2	589
10	烘箱	8	1,177
11	贴片机	5	1,635
12	点胶机	2	327
13	激光打印/修调设备	15	8,371
14	键合机	28	13,407
15	光刻机	6	8,633
16	植球机	2	654
17	回流机	6	4,055
18	Prober 和 Handler	33	4,742
19	测试机	38	24,133
20	工厂自动化硬件系统	1	1,308
21	自动化机器人	20	3,270
	合计	322	147,863
国产设备			
1	光刻机	3	4,316
2	涂胶机	9	4,120
3	显影机	9	4,120
4	去胶机	9	4,120
5	晶圆单片湿法腐蚀机	11	5,755
6	倒装机	13	3,401
7	预清洗设备	6	2,616
8	晶圆切割设备	7	6,017
9	自动装片下片系统	2	1,439
10	揭膜/贴膜设备	11	2,381
11	键合/拆键合设备	8	4,578
12	植球机	3	687
	合计	91	43,550

其中设备价格根据国内外供应商报价数据进行综合比较后估算，设备数量根据设计产能估算。

(3) 安装工程费

安装工程费主要为设备配套安装费、管路及配套动力设备安装等建筑安装工程费用，参考同类型安装工程费用标准并适当考虑当地造价水平进行估算，金额

为 14,212 万元，全部由公司自筹解决，具体明细如下：

单位：万元

序号	项目		投资金额
1	设备配套安装费	进口设备配套及安装费	5,915
2		国产设备运输及安装费	1,089
3	建筑安装工程费用	管路及配套动力设备安装	7,209
	合计		14,212

(4) 工程建设其他费用

工程建设其他费用主要为建设单位管理费、前期工作费、联合试运行费、设计费、其它咨询费等，参考同类型工程建设费用标准估算，金额为 6,181 万元，全部由公司自筹解决。

(5) 预备费

预备费用均为基本预备费。基本预备费主要为解决在施工过程中，设计变更或调整增加的投资以及为解决意外事故而采取措施所增加的工程项目和费用，主要包括设计变更或调整增加的投资以及工程建设不可预见费用等。该项目基本预备费用按建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 4.5% 计算，为 9,664 万元，全部由公司自筹解决。

(6) 铺底流动资金

该项目设置铺底流动资金 10,586 万元，全部由公司自筹解决。

二、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在董事会前投入的说明

(一) 年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目

1、目前进展情况

目前该项目前期准备工作已经完成，已建立通用型工艺文件及品保文件标准规范，已经开始开展厂房装修改造及水、电、气接入，SMT（表面封装生产线）、前/后线正根据项目需求施工开展中。

2、预计进度安排与资金预计使用进度

①项目建设内容

该项目建设内容主要包括厂房装修改造，水、电、气接入，设备招标、签约、采购，设备安装调试等。该募投项目包括FBGA、PBGA、SIP 模组、P-SIP 模组、通讯模块-LGA、高脚位通讯模块、倒装通讯模块 7 个封装形式产品。项目具体内容与应用领域如下：

封装产品名称	封装产品介绍	主要应用产品	应用领域
FBGA	FBGA（细间距球栅阵列）是一种在底部有焊球的面阵引脚结构，使封装所需的安装面积接近于芯片尺寸。具备良好可焊性、激光切割、集成度高等特点	处理器，控制器	智能电视，智能手机及其多媒体控制及数据传送
PBGA	PBGA（塑料焊球阵列封装）采用树脂/玻璃层压板作为基板，以塑料环氧模塑混合物作为密封材料，焊球和封装体的连接不需要另外使用焊料。具备较大的产品尺寸、高 I/O 端口、良好的散热性能等特点	处理器，控制器	电脑，智能电视以及多媒体产品
SIP 模组	SIP（系统级封装）是将多种功能芯片，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，从而实现一个基本完整的功能	功率放大器，地磁传感器	智能手机，物联网以及智能家居
P-SIP 模组	P-SIP 主要针对大功率器件的集成系统级封装	电源管理模块	健康测试和监控，汽车电子、移动通信、网络设备
通讯模块-LGA	LGA（触点阵列封装）用金属触点式封装取代了以往的针状插脚，不利用针脚固定接触，而是安装扣架固定，让芯片可以正确地压在弹性触须上，并且可以随时解开扣架更换芯片	射频开关、低噪声功率放大器（LNA），Wi-Fi 等射频产品	智能手机，智能家居
高脚位通讯模块	QFN（方形扁平无引脚封装）是一种无引脚封装，呈正方形或矩形，封装底部中央位置有一个大面积裸露焊盘用来导热，围绕大焊盘的封装外围四周有实现电气连结的导电焊盘。具有良好的机械结构、电性能和热性能、体积小、重量轻等特点	无线电通讯模块，触控模块，电源管理模块	物联网，智能手机
倒装通讯模块	FC（倒装芯片）是在 I/O pad 上沉积锡铅球，然后将芯片翻转加热利用熔融的锡铅球与基板/框架相结合，此技术替换常规打线接合，具有优良的电性能和热特性，在中等焊球间距的情况下，I/O 数可以很高，不受焊盘尺寸的限制，可大大减小尺寸和重量	无线电通讯模块，触控模块，电源管理模块	物联网，智能手机

② 预计进度安排

项目建设期根据项目实施主体的建设经验、设备采购/安装/调试工作量，并参考类似项目的建设经验，建设期拟定为3年，计划进度安排如下：

序号	工作内容	准备期	建设期																		生产期 第四年			
			第一年						第二年						第三年									
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
1	编制可行性研究报告																							
2	立项备案																							
3	编制环评报告																							
4	环评报告申报、批准																							
5	确立工艺文件、品保文件																							
6	厂房装修改造，水、电、气接入																							
7	设备考察、招标、采购																							
8	设备安装调试																							
9	员工培训																							
10	全部产能投产																							

③募集资金预计使用进度

该项目所使用募集资金将全部用于设备购置。项目设备购置将随项目建设进度安排而逐步推进，项目产能也将随项目设备购置、安装、调试而逐步增加，预计该项目募集资金使用进度如下：

单位：万元

项目	募集资金投资金额	第一年	第二年	第三年
设备购置费	157,000	40,000	79,000	38,000

3、是否存在董事会前的投入

2017年9月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关事项。该项目不存在公司本次非公开发行股票董事会决议日之前投入资金的情形。

(二) 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目

1、目前进展情况

该项目目前厂房装修、改造主体工程和水、电、气接入主要工程已经基本完成，设备招标、采购及配套安装测试已经在进行中。

2、预计进度安排及资金预计使用进度

①项目建设内容

该项目建设内容主要包括厂房装修改造，水、电、气接入，净化装修，设备考察、招标、采购，设备安装调试等。该募投项目包括 Bumping、WLCSP 等 2 个封装形式产品，项目具体内容与应用领域如下：

封装产品名称	封装产品介绍	主要应用产品	应用领域
Bumping	在晶圆上生长凸点，包括铜柱凸点、焊球凸点及金凸点等，用于高密度、大电流、高速信号、射频信号封装，是先进制程节点所需的封装技术	电源管理、蓝牙芯片、数字货币、处理器等	消费电子、物联网
WLCSP	晶圆级芯片尺寸封装，封装尺寸与芯片尺寸大小一样，具有轻、薄、短、小等封装技术优势	模拟芯片、驱动芯片、EPROM、共模芯片、CODEC、功放、电源管理等	智能手机、智能穿戴、物联网

② 预计进度安排

项目建设期根据项目实施主体的建设经验、设备采购/安装/调试工作量，并参考类似项目的建设经验，建设期拟定为 3 年，计划进度安排如下：

序号	项目	准备期	建设期																		生产期 第四年	
			第一年						第二年						第三年							
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	编制可行性研究报告	■																				
2	立项备案	■	■																			
3	编制环评报告		■	■																		
4	环评报告申报、批准		■	■	■																	
5	厂房装修改造，水、电、气接入，净化装修				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	设备考察、招标、采购				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	设备安装调试					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	员工培训									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	全部产能投产																					■

③ 募集资金预计使用进度

该项目所使用募集资金将全部用于设备购置。项目设备购置将随项目建设进度安排而逐步推进，项目产能也将随项目设备购置、安装、调试而逐步增加，预计该项目募集资金使用进度如下：

单位：万元

项目	募集资金投资金额	第一年	第二年	第三年
设备购置费	140,000	15,000	75,000	50,000

3、是否存在董事会前的投入

2017年9月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关事项。该项目存在董事会前投入，截至2017年9月30日，该项目已累计投入32,187.60万元，全部为公司自有资金投入，主要为厂房装修/改造费用、净化装修费用、设备购置费及设备配套安装费等投入。

三、募投项目与公司之前业务是否存在差异，公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应储备，募投项目实施是否面临重大不确定性风险的说明

(一) 年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目

1、募投项目与公司之前业务是否存在差异

本项目建成后将形成FBGA、PBGA、SIP模组、P-SIP模组、通讯模块-LGA、高脚位通讯模块、倒装通讯模块等通信用高密度集成电路及模块封装产品年产20亿块的生产能力。FBGA、PBGA、SIP模组、P-SIP模组、通讯模块-LGA、高脚位通讯模块、倒装通讯模块等业务均为公司现有业务或技术，本项目中的FBGA、通讯模块-LGA等产品规格、技术特性将较公司之前产品有所提升，公司已经掌握了该等产品相关工艺、技术，本项目与公司之前业务不存在重大差异。

募投项目与公司之前业务在产品应用领域、工艺流程和技术特性等方面是否存在差异的对比情况如下：

项目	FBGA	
	公司之前业务	本次募投项目
产品应用领域	智能手机	智能电视，智能手机及其多媒体控制及数据传送
工艺主要流程	无差异	
技术特性	产品尺寸较大	I/O Pin脚数量较多、集成度更高
项目	PBGA	
	公司之前业务	本次募投项目
产品应用领域	电脑，智能电视以及多媒体产品	电脑，智能电视以及多媒体产品
工艺主要流程	无差异	
技术特性	无差异	
项目	SIP 模组	
	公司之前业务	本次募投项目

产品应用领域	智能手机	智能手机
工艺主要流程	无差异	
技术特性	部分模块化封装	系统级封装，集成度、复杂度更高，可靠性更好
项目	P-SIP 模组	
	公司之前业务	本次募投项目
产品应用领域	电源管理系统	电源管理系统
工艺主要流程	无差异	
技术特性	模块化封装	堆叠模块化封装
项目	通讯模块-LGA	
	公司之前业务	本次募投项目
产品应用领域	智能手机	智能手机，智能家居
工艺主要流程	无差异	
技术特性	2G、3G、4G	4G、5G
项目	高脚位通讯模块	
	公司之前业务	本次募投项目
产品应用领域	物联网，智能手机	物联网，智能手机
工艺主要流程	无差异	
技术特性	产品技术较为成熟，其铜线、合金线都能达到技术要求	功能更多，集成度更高
项目	倒装通讯模块	
	公司之前业务	本次募投项目
产品应用领域	智能手机	物联网，智能手机
工艺主要流程	无差异	
技术特性	具有优良的电性能和热特性，在中等焊球间距的情况下 I/O 数可以很高，不受焊盘尺寸的限制	I/O 数量提升

2、公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应储备，募投项目实施是否面临重大不确定性风险

(1) 人员储备情况

本项目将由公司下属集成电路事业中心负责具体实施。公司下属集成电路事业中心设立于 2007 年，主要负责集成电路封装测试业务，拥有一批经验丰富、专业能力强的生产技术人才。截至 2017 年 11 月 30 日，公司集成电路事业中心拥有员工 5,123 人，其中管理人员 322 人，工程师/管理师 561 人，技术员/管理员 1,219 人，生产人员 3,021 人。其中主要工程师、技术员从业时间长、技术能力强，对集成电路及模块封装技术和生产工艺理解深刻。同时，公司拥有完整的

人才培养体系和人才招聘渠道，保证了人员储备和项目需求相匹配。

（2）技术储备情况

经过多年的持续研发与技术沉淀，公司形成了深厚的先进封装技术积累，为本项目的顺利实施提供有力的技术支撑。公司拥有行业领先的高端封装技术能力，能够为国际高端客户提供领先的封装服务。截至 2017 年 9 月 30 日，公司及子公司共获得有效发明专利 2,681 件，其中在美国获得的发明专利为 1,740 件，基本覆盖中高端封测领域；公司还拥有国家级企业技术中心、江苏省集成电路封装测试工程技术研究中心。

在高密度集成电路及模块封装方面，公司拥有国内唯一的高密度集成电路封装技术国家工程实验室，拥有 FBGA、PBGA 封装技术，高密度集成 P-SiP IC 模块封装技术，高脚位 QFN 封装技术，高密度 FC-BGA 封测技术等多项高密度集成电路及模块封装技术，技术储备能满足本项目需求。

（3）管理储备情况

公司高度重视生产管理，制订了覆盖采购、生产、销售各个环节的管理制度，并在日常的生产经营活动中得到有效执行。公司先后通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001：2004 环境管理体系认证、QC080000 有害物质管理体系认证、有害物质过程管理 IECQ 证书、OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证等管理认证，保证了生产管理过程严格、有效。公司 2014-2016 年连续获得江苏省质量管理优秀奖，管理能力能有效满足本次募投项目的实施。

（4）运营经验情况

公司的中高端集成电路封装测试生产能力国内领先，具备丰富的中高端集成电路封装测试量产经验。FBGA 是目前应用最为广泛的封装形式之一，公司 FBGA 业务经过多年发展已经成为中国大陆封装企业的标杆，以铜线与合金线为主导的焊线工艺的良率水准行业领先，开发并量产了多样 FBGA 的封装技术，可提供客户多种线型选择方案。公司 LGA 封测产品涵盖 3G（CDMA，TD-SCDMA，WCDMA）、4G（FDD-LTE 和 TD-LTE）和集成模块，特别是通讯模块-LGA 4G PA

产品，可全面满足多种智能手机需求，国际和国内核心射频组件主要供应商大部分与公司有封测业务联系。公司在中高端集成电路封装测试的运营经验，将能确保本项目产品的顺利生产。

综上，公司具有良好的人员、技术、管理、运营经验等方面储备，年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目的实施不存在重大不确定性风险。

(二) 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目

1、募投项目与公司之前业务是否存在差异

本项目由公司全资子公司长电先进负责实施，项目建成后将形成 Bumping、WLCSP 等通讯与物联网集成电路中道封装年产 82 万片次 Bumping、47 亿颗芯片封装的生产能力。

Bumping、WLCSP 业务为长电先进主营业务，本项目系长电先进主营业务的提产扩能，与其之前业务在主要工艺流程、产品规格等方面不存在重大差异，在应用领域等方面有所差异，具体对比如下：

项目	公司之前业务	本次募投项目
产品应用领域	消费电子	消费电子、物联网等
产品规格	8/12 英寸	8/12 英寸
工艺主要流程	无差异	
主要生产设备	晶圆电镀机、等离子清洗机、检测机、晶圆溅射机等	激光切割设备、晶圆溅射机、晶圆磨片机、晶圆电镀机等

2、公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应储备，募投项目实施是否面临重大不确定性风险

(1) 人员储备情况

长电先进自 2003 年成立即开始中道封装相关技术的研究与产业化开发，多年的研发、生产培养了技术水平成熟、生产经验丰富的研发、生产团队，为本项目成功实施奠定了人员基础。截至 2017 年 11 月 30 日，长电先进拥有员工 1,424 人，其中生产人员 753 人、技术人员 369 人、管理人员及其他人员 302 人。长电先进建立了完善的人才培养体系和人才招聘渠道，在人员方面的储备能够有效保障该项目的开展和实施。

(2) 技术储备情况

长电先进秉承“培育有自主知识产权的产品和技术”的理念，开创了中道封装相关技术多个国内封测行业的第一，拥有成熟的 Bumping、WLCSP 等先进的圆片级封装技术，并掌握了与之配套的先进工艺生产流程，是国家高新技术企业。经过 10 多年的技术积累，长电先进拥有了丰富的专利，截至 2017 年 9 月 30 日，长电先进拥有 51 项已授权的发明专利，90 项已授权的实用新型专利和 1 项 PCT 国际专利。

（3）管理储备情况

长电先进经营管理团队具有丰富的中道封装生产管理经验，制定了涵盖采购、生产、销售等方面的管理制度，并严格执行。长电先进坚持质量第一、用户至上的服务宗旨，在企业内部推行国际质量标准认证，分别于 2004 年、2008 年先后通过了 ISO9001、TS16949 质量管理体系认证，通过贯彻实施质量管理体系认证标准，使企业的质量管理方针目标得以顺利实施。

（4）运营经验情况

经过多年经营积累，长电先进拥有丰富的中道封装技术产业化运营经验，目前长电先进中道封装从技术到产能已具有较强的国际竞争能力，其中 WLCSP 产能规模已全球领先，Bumping 产能也进入全球前五。长电先进产品 90% 以上出口，全球前十大模拟 IC 供应商大部分是长电先进客户，长电先进产品已规模化、市场呈国际化。

综上，长电先进具有良好的人员、技术、管理、运营经验等方面储备，通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目的实施不存在重大不确定性风险。

四、结合在手订单或意向性合同说明新增产能的消化措施，募投项目效益的具体测算过程、测算依据和谨慎性

（一）新增产能的消化措施

本次募投项目开展的业务均属于集成电路封装测试业务，以对外承接加工为主，根据客户订单进行生产。由于该等业务生产周期短，周转快，一般不存在长期订单或意向性合同，符合行业特性。本次募投项目新增产能系综合考虑集成电路行业发展趋势、产品应用市场总体需求、公司产品布局及发展规划、现有产能

及利用率等因素确定，公司将借助集成电路行业快速发展和产品应用市场需求快速增长机遇，进一步巩固及提升规模优势、技术优势、品牌优势，利用公司全球化销售网络，深入现有客户合作，开发国内外潜在客户需求等措施消化新增产能。

1、新增产能消化的行业背景与市场基础

(1) 国家产业政策大力支持下我国集成电路产业快速发展，为产能消化提供了市场机遇

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。国家相继出台了若干产业政策，大力支持集成电路产业发展。2014年6月，国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》（简称“《纲要》”），将提升先进封装测试业发展水平列为主要任务和发展重点之一，指出要大力推动国内封装测试企业兼并重组，提高产业集中度。适应集成电路设计与制造工艺节点的演进升级需求，开展芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、硅通孔（TSV）、三维封装等先进封装和测试技术的开发及产业化。《纲要》同时提出设立国家产业投资基金，重点支持集成电路等产业发展，促进工业转型升级。2015年5月国务院印发了《中国制造2025》，提出掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。2016年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》发布，提出“大力推进先进半导体……等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点”。

在国家政策大力支持下，我国集成电路市场保持高速增长。根据中国半导体行业协会统计，自2009年至2016年，我国集成电路市场销售规模从1,109亿元增长至4,335.5亿元，期间的年均复合增长率达到21.50%，明显高于全球半导体市场增速。从产业链结构看，2016年集成电路产业链各环节均呈现增长态势。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为1,644.3亿元，同比增长24.1%；制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016年依然快速增长，同比增长25.1%，销售额1,126.9亿元；封装测试业销售额1,564.3亿元，同比增长13%。通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市场。

(2) 募投项目产品应用市场空间大，为产能消化奠定市场基础

根据集成电路封测行业技术发展路径，高密度集成电路及模块封装、晶圆级

封装等现有主流封装技术已进入成熟期，其应用市场正不断发展。本次募投项目“年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”产品主要应用市场为通信行业中智能手机、无线通讯模组、电源模块等领域，“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”主要应用市场为通讯（包括消费电子、汽车电子）与物联网领域。智能手机、无线通信模块、消费电子和物联网等募投项目产品主要应用市场空间不断扩大，为募投项目产能消化奠定了市场基础。

近年来，在全球范围内智能手机行业发展较为迅速，IDC的市场数据显示2016年全球智能手机出货量超过14.7亿台，预计2020年智能手机达18.4亿台，行业整体发展较快，市场增长空间大。同时，手机行业更新换代较快，近两年在中国智能手机“换机潮”的推动下，行业出货量增长明显。中国信息通信研究院统计数据显示，中国2016年智能手机出货量达到5.22亿台，占同期国内手机出货量的93.2%。在旺盛的需求的基础上，中国已成为全球最大的手机生产基地。根据工信部数据，2016年我国移动手机产量为21亿部，同比上涨13.6%，其中智能手机产量为15亿部，同比上涨9.9%，占全部手机产量的74.7%。

无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口，是连接物联网感知层和网络层的关键环节。目前在M2M场景下，应用更多的是蜂窝通信模块（2G/3G/4G），未来LPWAN模块（NB/IoT、LoRa）将快速应用。根据GAMA（全球移动运营商协会）的预计，2015年，全球蜂窝通信M2M的连接数为3亿左右，到2020年有望达到10亿级别，算上LPWAN，整体连接数有望达到百亿级别。目前，智能表计、移动支付、智能车载、智能电网等大颗粒市场的快速发展引领无线通讯模块的需求。中国目前是全球最大的M2M市场，2015年的连接数为1亿，到2020年这一数字有望达到3.5亿，LPWA技术将额外提供7.3亿连接，总连接数有望超过10亿，占到全球总连接的十分之一。

根据IDC报告数据，2017年全球物联网总体支出同比将增长16.7%，略高于8,000亿美元，到2021年，全球物联网支出将达到1.4万亿美元，其中包括企业对物联网硬件、软件、服务和网络连接的投资。根据Cisco预计，到2022年，全球物联网市场将达到14.4万亿美元。根据工信部的数据，2017年上半年，中国物联网市场规模接近5000亿元，已经是全球规模最大的市场。工信部提出到2020年，

国内物联网总体市场规模突破1.5万亿元，2025年中国将引领全球物联网市场。

作为物联网的核心设备，芯片处于产业链最上游。物联网芯片主要分为嵌入式芯片、通信芯片、定位芯片、安全芯片。根据IC Insights预测，到2020年，全球物联网芯片市场规模将达311亿美元，2015-2020年的年复合增长率达14.9%。

2、新增产能的具体消化措施

(1) 通过与客户共同研发更新、迭代产品，锁定重点客户

从集成电路封装测试技术演进路线图来看，集成电路封装测试的技术发展方向为：集成度越来越高、线路变短，使传导速率越来越快、晶圆级封装使散热性能更好、功耗逐渐降低、成本不断下降。募投项目产品都是行业发展的主流方向，符合客户产品更新、迭代的需求。基于募投项目的技术与产品，公司将与客户共同研发更新、迭代产品，锁定重点客户，并通过重点客户消化募投项目产能。

(2) 进一步巩固和提升公司规模优势、技术优势、品牌优势，获取更多募投项目产品订单

公司是中国内地最大、全球第三大的集成电路委外封装测试（OSAT）企业，在中国江阴、滁州、宿迁及新加坡、韩国等地设有不同特色的生产基地，业务覆盖国际、国内全部高端客户；公司拥有 Fan-out（eWLB）、SiP、WLCSP、FC 等多项高端集成电路封测技术与生产能力，技术水平已步入世界先进水平行列。

本次募投项目将主要用于发展公司通信用高密度集成电路及模块封装业务和中道封装业务相关的中高端集成电路封测技术生产能力，目前公司在中高端集成电路封装领域已经具有相当规模，是众多大中型集成电路设计企业的供应商；公司将进一步巩固和提升规模优势、技术优势、品牌优势，获取更多募投项目产品订单。

(3) 加强募投项目产品质量控制和生产管理，保持募投项目在技术、工艺和良率等方面高水准

公司已经建立了包括主要原材料、外购件、外协件、在产品、产成品可靠性试验和时效分析等方面的一系列品质保证系统，确保产品质量和良率。公司将在现有技术水平、生产能力、运营经验基础上，加强募投项目产品质量控制和生产

管理，在扩大产量的同时严格控制产品质量，提高服务水平，使募投项目在技术、工艺和良率等方面保持高水准。

(4) 利用公司全球化销售网络，深化现有客户合作，同时开发国内外潜在客户需求

收购新加坡星科金朋后，公司获得了全球同行业领先的先进封测技术和高端客户资源，并跻身全球集成电路封装测试行业第一阵营，构建了涵盖美国、欧洲和亚洲等全球主要半导体市场的销售网络，积累了国际、国内大量客户资源。公司将利用全球化销售网络，深化与现有客户合作，同时开发国内外潜在客户需求，确保本次募投项目产能得到有效消化。

通信用高密度集成电路及模块封装业务方面，公司目前与多家国内外著名 IC 设计厂商保持着良好业务往来，该项目目标客户和潜在客户较多。

中道封装业务方面，全球前十大模拟 IC 供应商大部分是长电先进客户。长电先进的封装产品已获得欧洲、北美等地区国际一流公司的认可，半导体凸块产品已应用在国际前十大手机厂商的产品中，长电先进与国际大客户保持着密切、良好的合作关系。长电先进的国际/国内大客户也将是通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目的目标客户群体。

(二) 募投项目效益的具体测算过程、测算依据和谨慎性

1、“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”效益的测算过程和测算依据

本项目实施达标达产后，预计新增年利润总额 24,181 万元，预计投资回收期（税后）约 7.52 年（含建设期），内部收益率（税后）为 10.74%。

本项目完全达产当年效益测算主要过程、测算依据如下：

(1) 销售收入测算

序号	项目	数额
1	产量（万颗）	200,000
2	平均单价（元/颗）	0.56
3	销售收入（万元）	112,000

产能规划：本项目具体包括 FBGA、PBGA、SIP 模组、P-SIP 模组、通讯模块-LGA、高脚位通讯模块、倒装通讯模块共计 7 个产品，项目建成后可达到年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装产品的生产能力。

产品单价测算依据：

2014 年、2015 年、2016 年、2017 年，该项目公司同类产品平均单价分别为 0.63、0.57、0.54、0.53 元/颗。随着终端市场产品的升级换代，本项目部分产品规格将随之提升，工艺也将相应改进，项目主要产品中 FBGA 后续单颗打线数量将多于 2014-2016 年平均打线数量，通讯模块-LGA 将由过去主要生产 2G/3G 1~3 颗叠带产品扩展为生产 4G 的 5~7 颗叠带产品，单价也将在历史平均单价上有所提升；并且，本项目产品中单价较低的高脚位通讯模块、倒装通讯模块产品新增产能占比相对较低，PBGA、SIP 模组和通讯模块-LGA 等单价较高产品新增产能占比相对较高。结合公司现有产品销售价格水平、未来产品规格和工艺改进、现有客户对产品的认可度、预计公司生产成本等因素，本项目产品预计平均单价确定为 0.56 元/颗。

（2）成本费用的测算

各项目具体测算依据如下：

①生产成本

本项目主要原材料为引线框架、导电胶、金线、塑封料、包装载带盖等。

直接材料及辅材费根据同类产品的消耗量及目前国内外市场价格进行测算，直接燃料及动力费根据消耗量和当地价格计算，直接工资及福利根据公司工资标准及人员安排计划进行计算，**直接生产成本合计 57,941 万元/年。**

制造费用系根据项目生产所需固定资产的折旧费、修理费等加总测算，固定资产折旧费按平均年限法计算，其中：工艺设备按 8 年折旧、其他固定资产按 10 年折旧，残值率 4%。**制造费用为 20,159 万元/年。**

②营业税金及附加

本项目增值税税率按 17%测算，城市维护建设税税率按 7%测算，教育费附

加税率按 5% 测算，合计 1,320 万元/年。

③管理费用、销售费用结合公司费用水平等因素预计，分别按照销售收入的 6%、1.5% 测算，分别为 6,720 万元/年、1,680 万元/年。

(3) 净利润的测算

本项目的实施主体为上市公司，上市公司为高新技术企业，企业所得税率按照 15% 测算。净利润=营业收入-营业税金及附加-总成本费用-所得税，为 20,554 万元/年。

2、“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”效益的测算过程和测算依据

本项目实施达标达产后，预计新增年平均利润总额 36,587 万元，预计投资回收期（税后）约 7.25 年（含建设期），内部收益率（税后）为 12.51%。

本项目完全达产当年效益测算主要过程、测算依据如下：

(1) 销售收入测算

序号	项目	数额
1	Bumping	
	产量（万片次）	82
	销售收入（年平均，万元）	68,563
2	WLCSP	
	产量（万颗）	470,000
	销售收入（年平均，万元）	168,249
3	合计销售收入（年平均，万元）	236,812

产能规划：本项目建成后将形成年产 82 万片次 Bumping、47 亿颗芯片封装的生产能力。

产品单价测算依据：

结合该等现有产品销售价格水平、现有客户对产品的认可度、预计生产成本等因素以及在谨慎测算的原则下估算。

（2）成本费用的测算

各项目测算依据如下：

①生产成本

本项目主要原材料为芯片、光刻胶、显影液、靶材、锡球等。

直接材料及辅材费根据长电先进目前同类产品的消耗量及国内外市场价格进行测算，直接燃料及动力费根据消耗量和当地价格计算，直接工资及福利根据公司工资标准及人员安排计划进行计算。**直接生产成本合计 157,255 万元/年。**

制造费用系根据项目生产所需固定资产的折旧费、修理费、厂房租金等加总测算，固定资产折旧费按平均年限法计算，其中：工艺设备按 8 年折旧、其他固定资产按 10 年折旧，残值率 4%，**制造费用为 25,792 万元/年。**

②营业税金及附加

本项目增值税税率按 17% 测算，城市维护建设税税率按 7% 测算，教育费附加税率按 5% 测算，**合计为 1,770 万元/年。**

③管理费用、销售费用结合长电先进相关费用水平等因素预计，分别按照销售收入的 5.5%、1% 测算，**分别为 13,040 万元/年、2,368 万元/年。**

（3）净利润的测算

本项目实施主体长电先进，为高新技术企业，企业所得税率按照 15% 测算。
净利润=营业收入-营业税金及附加-总成本费用-所得税，为 31,099 万元/年。

3、本次募投项目效益测算的谨慎性

在编制本次募投项目可行性研究报告时，公司及信息产业十一所对本次募投项目的效益测算，充分考虑了市场发展状况、产品规格/工艺变化、产品价格变化等情况，并通过盈亏平衡分析、敏感性分析确认了本次募投项目具有良好的盈利性。

公司本次募集资金投资项目均属于集成电路封测业务项目，其主要效益指标

与国内主要从事集成电路封测业务上市公司相对类似募集资金投资项目对应效益指标比较情况如下：

公司名称	项目名称	内部收益率 (税后)	投资回收期 (含建设期)
华天科技	智能移动终端集成电路封装产业化项目	17.60%	8.04
长电科技	年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	10.74%	7.52
晶方科技	年封装 36 万片晶圆的 WLCSP 封装平台	26.90%	4.79
华天科技	晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目	15.96%	8.46
长电科技	通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	12.51%	7.25

从上表与同行业上市公司募投项目的比较可以看出，公司本次募投项目内部收益率指标与同行业上市公司募投项目相比较低。本次募投项目效益的测算较为谨慎。

五、本次募投项目实施主体是否存在非全资子公司实施情况、是否直接或间接增厚被收购主体的业绩进而影响业绩承诺有效性的说明

本次募投项目的实施主体分别为公司和长电先进。长电先进系公司直接持股 96.488%、公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股 3.512%的全资子公司。本次募投项目的实施主体不存在非全资子公司实施的情况。

经公司第五届第二十八次董事会决议、第五届第二十九次董事会决议和 2015 年第三次临时股东大会决议，并经中国证监会“证监许可[2015]2401 号”文件核准，公司于 2015 年 11 月向新潮集团发行股份购买了其持有的长电先进 16.188%股权。该项收购完成后长电先进成为公司全资子公司。

该项收购过程中，公司与新潮集团签署了《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》，新潮集团承诺长电先进 2015 年度、2016 年度、2017 年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币

15,700.47 万元、17,381.30 万元和 18,704.21 万元，利润补偿期间实现的净利润之和不低于 51,785.98 万元。如标的公司利润补偿期间内截至当年度实现的净利润之和未达到截至当年度的预测净利润之和，新潮集团将按约定进行补偿。

上述长电先进业绩承诺涵盖期间为 2015 年度、2016 年度、2017 年度三年，但是本次募投项目中由长电先进负责实施的通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目尚处于建设期，2017 年度尚未产生效益，不存在通过本次募集资金投资而增厚长电先进的业绩进而影响新潮集团关于长电先进 2015-2017 年度业绩承诺有效性的情形。

六、新增折旧对公司经营业绩的具体影响

本次募投项目中“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”总投资 173,492 万元，其中建设投资 169,498 万元，形成固定资产并新增折旧；“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”总投资 235,000 万元，其中建设投资 224,414 万元，形成固定资产并新增折旧。

两个募投项目建设达标达产后预计将每年新增折旧金额情况如下：

单位：万元

项目	折旧类别	达标达产后 年折旧金额
年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	工艺设备	19,705
	其他固定资产	254
	小计	19,959
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	房屋建筑物	112
	工艺设备	24,675
	其他固定资产	1,507
	小计	26,294
合计		46,253

根据项目效益测算，“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”实施达标达产后预计新增产品年销售收入 112,000 万元，其中总成本费用为 86,499 万元（包括折旧费用），新增利润总额为 24,181 万元；“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”实施达标达产后预计新增产品年平均销售收入 236,812 万元，其中总成本费用为 200,225 万元（包括折旧费用），新增年平均利润总额 36,587 万元，预计项目达标达产后收入将有效覆盖折旧费用。

单位：万元

项目	项目	达标达产后 金额
年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	年销售收入	112,000
	年总成本费用	86,499
	其中：折旧费用	19,959
	年利润总额	24,181
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	销售收入	236,812
	总成本费用	200,225
	其中：折旧费用	26,294
	利润总额	36,587

上述募投项目投入初期，新增固定资产折旧将会对经营业绩产生一定影响。但随着募投项目逐渐达标达产，公司营业收入、净利润也会随之增长。根据项目效益测算，“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”和“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”实施达标达产后预计新增产品年销售收入分别为 112,000 万元和 236,812 万元，预计可以覆盖募投项目投入后新增的折旧摊销，扣除成本费用及新增折旧摊销后的新增利润总额分别为 24,181 万元和 36,587 万元。故本次募投项目达产后新增折旧预计不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

公司《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》对本次募投项目新增折旧对公司经营业绩的影响有关的风险进行了补充披露，具体如下：

“3、募投项目投入新增折旧风险

由于本次募集资金投资项目投资规模较大，且主要为资本性支出，项目建成后将产生相应的固定资产折旧。虽然项目已经过充分的可行性论证，但项目开始建设至达标达产并产生效益需要一定时间，项目投入初期新增固定资产折旧将会对经营业绩产生一定影响。同时，项目实施过程中还存在诸多不确定因素可能影响项目建设进度，募集资金从投入到实际产生效益的时间长短也存在一定不确定性，预计募投项目投入短时间内难以使公司经营业绩得到明显提升。”

七、保荐机构对募集资金用途信息披露是否充分合规、相关保障措施是否有效可行、风险揭示是否充分、本次发行是否可能损害上市公司及中小股东利益的核查意见

保荐机构核查了发行人《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案》及其修

订稿、募集资金投资项目可行性研究报告、项目备案、环评批复等文件，复核了发行人募集资金投资项目的投资构成及金额明细、收益测算过程及依据、预计进度安排及募集资金使用进度安排、资本性支出、新增折旧等情况，了解了发行人实施募投项目的人员、技术、管理、运营经验等方面储备情况，并与发行人相关人员、可行性研究报告编制单位经办人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目投资测算依据、测算过程及结果合理，项目投资中的资本性支出包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费及工程建设其他费用，非资本性支出包括铺底流动资金和预备费，使用募集资金投入的部分均属于资本性支出。

2、本次募投项目目前进展顺利，预计进度安排及募集资金使用进度安排合理。

3、本次募投项目与公司之前业务不存在重大差异，发行人具有实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应储备，募投项目的实施不存在重大不确定性风险。

4、发行人制订了相应的新增产能消化措施，措施合理有效。本次募投项目的效益测算，充分考虑了市场发展状况、产品规格/工艺变化、产品价格变化等情况，本次募投项目具有较好的盈利性，效益测算谨慎。

5、本次募投项目的实施主体不存在非全资子公司实施的情况，亦不存在直接或间接增厚被收购主体的业绩进而影响业绩承诺有效性的情形。

6、本次募投项目建设完成后的预期效益测算过程中已充分考虑新增折旧摊销对经营业绩的具体影响。虽然本次募投项目投产后折旧摊销将会增加，但同时公司的营业收入和利润总额也会随之增长，预期能够消化新增折旧摊销费用的影响。

7、本次募集资金用途信息披露充分合规，相关保障措施有效可行，发行人已在《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案》及其修订稿中对募投项目风险进行了披露，风险揭示充分，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

重点问题七

7、申请人拟以 13.3 亿元用于偿还银行贷款。请申请人补充说明：（1）本次偿还银行贷款的明细（借款主体、金额、借款期间及用途等），如存在提前还款的，请说明是否需要取得银行提前还款的同意函。（2）请申请人对比本次发行完成后的资产负债率水平、有息负债水平与同行业可比上市公司平均水平，说明偿还银行贷款金额是否与实际需求相符。（3）本次募投资金用于偿还短期贷款以及铺底流动资金、预备费等，视同以募集资金补充流动资金，请申请人提供补充流动资金的测算依据。

请保荐机构发表核查意见。

回复：

一、本次偿还银行贷款的明细（借款主体、金额、借款期间及用途等），及取得银行提前还款同意函情况的说明

根据公司第六届董事会第八次临时会议决议、第六届董事会第九次临时会议决议、《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本次募集资金拟偿还的银行贷款金额由 13.3 亿元下调为 10.8 亿元。

公司本次募集资金拟偿还的银行贷款明细如下表所示，该等银行贷款的借款人均为长电科技：

序号	贷款银行	借款金额 (万元)	借款日	到期日	截至 2017 年 9 月 30 日 借款余额 (万元)	借款用途
1	中国银行	15,000	2017/08/08	2020/07/31	15,000	购买电子元器件
2	工商银行	10,000	2017/09/19	2018/09/18	45,000	购货
		30,000	2017/04/28	2019/04/13		
		5,000	2017/06/14	2019/06/13		
3	民生银行	5,000	2016/02/15	2018/02/15	29,850	采购原材料
		10,000	2016/11/17	2018/11/17		补充流动资金
		15,000	2017/08/02	2019/08/02		采购原材料

序号	贷款银行	借款金额 (万元)	借款日	到期日	截至 2017 年 9 月 30 日 借款余额 (万元)	借款用途
4	江阴农商行	7,500	2016/11/9	2018/11/8	14,900	满足借款人生产、经营、消费的资金需求
		7,500	2016/11/9	2018/11/8		
5	中国银行 注	5,000	2017/08/31	2017/11/29	5,000	购买电子元器件
6	南洋银行 注	5,000	2016/10/20	2017/10/20	5,000	日常经营周转
合计		115,000	-	-	114,750	-

注：公司已分别于 2017 年 11 月 29 日和 2017 年 10 月 20 日以自有资金偿还了中国银行与南洋银行各 5,000 万元已到期贷款，待募集资金到位后予以置换。

公司拟使用本次募集资金中的 **10.8 亿元** 偿还上述银行贷款，不足部分将使用公司自有资金偿还。若在募集资金到位前贷款本金及利息到期的，公司将以自有资金于到期日先行偿付，待募集资金到位后进行置换。

除其中两笔贷款目前已到期由公司自筹资金先行偿付外，本次拟偿还的其他借款均已取得提前还款的银行同意函。

二、对比本次发行完成后的资产负债率水平、有息负债水平与同行业可比上市公司平均水平，说明偿还银行贷款金额是否与实际需求相符

近年来，受公司收购星科金朋、抓住市场机遇扩充产能等因素影响，公司资产负债率较高，公司 2014 年末、2015 年末、2016 年末和 2017 年 9 月末资产负债率分别为 63.12%、73.83%、77.55%、70.12%。

公司主营业务为集成电路封装测试，截至 2017 年 9 月 30 日，同行业上市公司资产负债率、有息负债占总负债比例情况如下表：

	资产负债率	有息负债率
通富微电 (002156.SZ)	46.94%	43.77%
华天科技 (002185.SZ)	33.49%	22.03%
晶方科技 (603005.SH)	15.13%	-
行业平均值	31.85%	21.94%
长电科技 (本次发行前)	70.12%	68.29%
长电科技 (本次发行完成并偿还银行贷款后)	60.88%	66.65%

注：上表中“长电科技（本次发行完成并偿还银行贷款后）”按照募集**40.5亿元**资金和偿还**10.8亿元**银行贷款余额的前提测算。

根据上表的统计数据，截至2017年9月30日，国内可比A股上市公司的资产负债率平均值为31.85%，有息负债（包括短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款）占总负债比例的平均值为21.94%。同期末长电科技资产负债率为70.12%，有息负债占总负债比例为68.29%，与同行业上市公司同期数据相比，公司的资产负债率明显较高，有息负债占总负债比例也明显较高，财务负担相对较重，影响公司的盈利能力。

通过本次发行募集资金并偿还银行贷款，公司的资产负债率水平能得到显著下降。根据测算结果，公司本次发行完成并偿还银行贷款后的资产负债率降至**60.88%**，虽然该数值仍然高于同行业平均水平，但相较公司发行前的负债率水平而言，已较大的降低了公司所承担的财务风险。

综合考虑公司资本结构、财务风险、利息支出、同行业可比上市公司情况等因素，公司通过本次募集资金部分用于偿还银行贷款可以优化资本结构、降低财务杠杆和财务风险、节省利息支出，缓解偿债压力，提升公司的财务稳健性，与公司实际需求相符。

三、本次募投资金用于偿还短期贷款以及铺底流动资金、预备费等，视同以募集资金补充流动资金，请申请人提供补充流动资金的测算依据

公司本次发行募集资金拟用于：1、年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目；2、通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目；3、偿还银行贷款。其中：

1、“年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”拟投资总额为173,492万元，其中预备费为4,937万元，铺底流动资金为3,994万元。本次非公开发行拟投入募集资金金额**157,000万元**，全部用于设备购置，不存在募集资金用于铺底流动资金、预备费等情况。

2、“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”拟投资总额为235,000万元，其中预备费为9,664万元，铺底流动资金为10,586万元。本次非公开发行拟投入募集资金金额**140,000万元**，全部用于设备购置，不存在募集资金用于铺

底流动资金、预备费等情况。

3、公司拟将本次非公开发行募集资金中 **108,000 万元** 用于偿还银行贷款，截至 2017 年 9 月 30 日，该等拟偿还的银行贷款中的长期贷款余额为 **94,750 万元**，短期贷款余额 20,000 万元。

公司本次补充流动资金的测算系在估算 2017-2019 年营业收入的基础上，按照销售百分比法测算未来收入增长所导致的相关经营性流动资产及经营性流动负债的变化，进而测算公司在未来三年生产经营对流动资金的需求量。由于公司于 2015 年 8 月收购星科金朋，收购之后营业收入增幅较大，出于谨慎考虑，公司 2017-2019 年营业收入增长比例参考公司 2014-2016 年剔除收购的星科金朋及新投资的 JSCK 后的营业收入增长率比例及同行业可比上市公司 2014-2016 年营业收入增长率比例测算。

根据公司剔除收购的星科金朋及新投资的 JSCK 口径的营业收入计算，公司 2014-2016 年营业收入的平均增长率为 **21.11%**，具体如下：

项目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
营业收入(万元)	510,206.01	642,827.33	757,565.18	905,172.13
同比增长率	-	25.99%	17.85%	19.48%
平均同比增长率	21.11%			

同行业可比上市公司 2014-2016 年营业收入的平均增长率为 26.66%，具体如下：

证券简称	2014 年营业收入同比增长率	2015 年营业收入同比增长率	2016 年营业收入同比增长率	平均值
通富微电(002156.SZ)	18.30%	11.06%	97.75%	42.37%
晶方科技(603005.SH)	36.72%	-6.51%	-11.00%	6.40%
华天科技(002185.SZ)	35.07%	17.20%	41.33%	31.20%
同行业平均水平				26.66%

谨慎考虑，采用公司近三年剔除收购的星科金朋及新投资的 JSCK 后的营业收入增长率平均值 **21.11%**，作为 2017-2019 年营业收入增长比例，该增长率低于公司近三年营业收入平均增长率，亦低于可比上市公司近三年营业收入平均增长率。

以 2016 年为基期，2017-2019 年为预测期，在其他经营要素不变的情况下，对公司未来三年因经营性资产及负债的变动需增加流动资金规模的测算如下：

单位：万元

项目	2016 年末 实际数	占营业收入 比重	2017 年 (e)	2018 年(e)	2019 年 (e)
营业收入	1,915,452.77	100.00%	2,319,804.85	2,809,515.65	3,402,604.41
应收账款	272,179.98	14.21%	329,637.17	399,223.58	483,499.68
存货	185,131.21	9.67%	224,212.41	271,543.65	328,866.51
应收票据	17,592.70	0.92%	21,306.52	25,804.33	31,251.62
预付账款	17,026.47	0.89%	20,620.76	24,973.80	30,245.77
经营性流动资产合计	491,930.36	25.68%	595,776.86	721,545.35	873,863.58
应付账款	377,483.27	19.71%	457,169.99	553,678.57	670,560.12
应付票据	57,361.58	2.99%	69,470.61	84,135.86	101,896.93
预收账款	3,133.40	0.16%	3,794.86	4,595.96	5,566.16
经营性流动负债合计	437,978.25	22.87%	530,435.46	642,410.38	778,023.22
流动资金占用额（经营资产-经营负债）	53,952.11	2.82%	65,341.40	79,134.97	95,840.36
当年新增流动资金需求	-	-	11,389.29	13,793.57	16,705.39
2017-2019 年新增流动资金缺口	-	-	-	-	41,888.25

根据上述测算结果，公司 2017-2019 年的流动资金缺口为 **41,888.25 万元**，本次募集资金拟用于偿还短期贷款金额为 20,000 万元，不存在募集资金用于铺底流动资金、预备费等情况，低于上述测算的流动资金缺口规模；且本次募集资金总金额为 **40.5 亿元**，偿还银行贷款的金额未超过募集资金总额的 30%。

此外，2016 年度，公司财务费用为 96,429.98 万元；2017 年 1-9 月，公司财务费用为 77,651.26 万元。随着公司经营规模的不断扩大，高额财务费用已经给公司造成较大负担，直接影响到公司经营业绩及整体盈利水平。因此，利用本次非公开发行股票所募集资金部分用于偿还银行贷款，能够降低公司银行贷款规模，减少公司的利息费用支出，提升公司盈利能力，有利于公司可持续发展。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了发行人公开披露的《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案》及其修订稿、最近三年的审计报告及最近一期的财务报表，并通过公开渠道了解同行业可比上市公司的财务情况；获取了发行人相关借款合同及银行出具的同意提前偿还贷款的承诺函等相关文件，并访谈了公司资金运营处负责人了解公司授信情况等；取得并核查了《2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》及其修订稿、补充流动资金的测算依据及测算过程。

经核查，保荐机构认为：除其中两笔贷款目前已到期由公司以自筹资金先行偿付外，本次拟偿还的借款均已取得提前还款的银行同意函。与同行业上市公司同期数据相比，公司的资产负债率较高，有息负债占总负债比例较高，财务负担相对较重。公司通过本次募集资金偿还银行贷款可以优化资本结构、降低财务杠杆和财务风险、节省利息支出，缓解偿债压力，提升公司的财务稳健性。本次发行拟使用募集资金偿还银行贷款与公司的实际需求相符。

本次非公开发行募投项目不存在募集资金用于铺底流动资金、预备费的情形。公司流动资金需求测算过程合理、假设条件依据充分、参数选取审慎。本次非公开发行募集资金中用于短期借款（视同补充流动资金）的金额不超过流动资金需求额，与公司现有资产、业务规模相匹配，具备合理性和必要性。

重点问题八

8、公司报告期内多次发行股份募集资金或购买资产，包括 2014 年非公开发行股票募集资金投资于“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”以及收购新加坡星科金朋股权，2015 年非公开发行股票收购长电先进 16.19% 股权并募集配套资金投资于“年加工 48 万片半导体中道封装测试项目”，2017 年非公开发行股份购买长电新科及长电新朋少数股权并配套募集资金投资于“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”，长电新科及长电新朋持有主要资产为星科金朋 100% 股权。另外，2017 年非公开发行股份实施完毕后，公司控制权变更为无实际控制人。

请申请人补充说明：（1）2014 年度收购星科金朋股权的资产运行情况，是否曾披露盈利预测或业绩承诺，是否达到，该次收购星科金朋定价及评估情况，

是否公允合理，收购的资金来源、投入方式及偿付计划。(2) 2014 年度募集资金用途变更比例较高，说明其原因及合理性，公司募集资金决策是否谨慎合理，是否存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形。(3) 2015 年度收购长电先进少数股权的意图，定价依据及评估情况，收购后的资产运行情况，是否曾披露盈利预测或业绩承诺，是否达到。(4) 星科金朋营业利润为负的情况下于 2017 年进一步收购少数股权的合理性，收购相关定价依据及评估情况，定价是否公允合理，是否存在利益安排。(5) 分多次收购星科金朋股权的考虑，是否存在一揽子协议，是否存在利益安排，上述资产购买是否构成借壳上市，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。(7) 历次募投项目的业绩实现情况，是否存在未达业绩承诺的情形。(8) 2017 年非公开发行募投项目目前实施进展、预计完工时间，是否存在募投项目进度延缓的情形，是否与相关信息披露文件一致。(9) 公司控制权变更是否影响公司经营的稳定性，是否影响本次募投项目效益的实现。(10) 前次募投项目与本次募投项目的联系与区别，前募项目未实施完毕的情况下进行本次募投项目的必要性合理性。

请保荐机构发表核查意见。

回复：

一、2014 年度收购星科金朋股权的资产运行情况，是否曾披露盈利预测或业绩承诺，是否达到，该次收购星科金朋定价及评估情况，是否公允合理，收购的资金来源、投入方式及偿付计划

(一) 2014 年度收购星科金朋股权的资产运行情况

1、资产权属变更情况

长电科技与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司 JCET-SC，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购了新加坡证券交易所上市的星科金朋的全部股份，资产权属变更的主要过程如下：

2015 年 8 月 2 日，星科金朋原控股股东 STSPL（持股 83.8%）接受要约；

2015 年 8 月 5 日，要约收购在各方面宣告为无条件；同时有效接受要约的股份，占总股本比例不低于 90%；根据新加坡公司法第 215 条规定，要约人

JCET-SC 有权执行法定强制挤出程序，强制收购剩余股权；

2015 年 8 月 27 日，要约收购期截止，接受要约的股份比例为 97.36%；

2015 年 9 月 9 日，要约人 JCET-SC 根据新加坡公司法的规定，发出强制收购剩余异议股东股份的通知；

2015 年 10 月 12 日，要约人 JCET-SC 行使强制收购权利，并于 2015 年 10 月 15 日完成强制收购程序，要约人合计持有星科金朋 100% 的股份；

2015 年 10 月 15 日，星科金朋出具退市公告；

2015 年 10 月 19 日，星科金朋完成新加坡交易所退市。

2、资产账面价值变化情况

星科金朋在收购前后账面价值变化情况如下：

单位：千美元

项目	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31
资产总额	2,613,834	2,132,122	2,099,985
负债总额	1,671,391	1,317,769	1,373,771
净资产	942,443	814,353	726,214

注：以上财务数据经审计。

3、生产经营情况

星科金朋的主营业务是集成电路封装与测试，向集成电路设计与制造企业提供涵盖封装设计、焊锡凸块、针探、组装、测试、配送等一整套半导体封装测试解决方案。星科金朋拥有 eWLB（嵌入式晶圆级球栅阵列）、TSV（硅通孔封装技术）、3D 封装、SiP（系统级封装）、PiP（堆叠组装）、PoP（堆叠封装）等先进封装技术，特别是在半导体封测行业未来发展的两大主流方向，即晶圆级扇出型封装和系统级封装两个领域，星科金朋所拥有的 eWLB 技术和高阶 SiP 技术处于国际领先水平。依托现有的在倒装、晶圆级封装、3D 封装等先进技术方面的优势，星科金朋为客户提供创新与高效率的半导体解决方案。

截至本反馈回复出具日，星科金朋各项业务生产经营正常。

4、效益情况

关于星科金朋于收购后的效益实现情况，请参见本反馈回复本题“七、历次募投项目的业绩实现情况，是否存在未达业绩承诺的情形”之“(一) 历次募集资金投资项目的业绩实现情况”之“1、历次募集资金投资项目实现效益情况对照表”之“(1) 2014 年非公开发行普通股”。

受工厂搬迁、个别大客户订单下滑等因素影响，收购完成后星科金朋经营业绩尚不理想。公司已经对星科金朋实施了全面整合措施和改善经营状况的针对性措施，影响星科金朋经营业绩的不利因素正逐步消除。关于影响星科金朋经营业绩主要因素及消除情况，请参见本反馈回复“重点问题九”之“一、关于公司是否能够对子公司星科金朋进行有效整合的说明”。

(二) 是否曾披露盈利预测或业绩承诺，是否达到

公司收购星科金朋系通过新加坡交易所二级市场要约收购方式进行，公司及星科金朋均未披露星科金朋任何盈利预测，交易对方也未就星科金朋业绩进行任何承诺或约定。

(三) 该次收购星科金朋定价及评估情况，是否公允合理

1、该次收购星科金朋定价及评估情况

星科金朋为新加坡证券交易所上市公司，该次收购的定价主要参考星科金朋二级市场股价、每股净资产、品牌、技术和渠道价值等因素的基础上确定的。该次要约的总交易对价为 7.80 亿美元，约合 10.26 亿新加坡元（按照 2014 年 12 月 19 日美元对新元汇率中间价：1 美元折合 1.31505 新元计算）。

该次收购为要约收购，未对星科金朋进行资产评估。

该次收购中，长电科技聘请的独立财务顾问中国国际金融有限公司出具了《中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告》，从独立估值机构的角度分析了本次收购价格是否公允。

2、该次收购星科金朋定价公允合理

该次收购的价格是长电科技在综合考虑并全面评估星科金朋的二级市场股价、每股净资产、品牌、技术和渠道价值等因素的基础上确定的。

该次收购中，长电科技的独立财务顾问中国国际金融有限公司出具了《中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告》。考虑到该次收购为公开市场收购及可获得的财务预测数据有限，该估值报告主要采用可比公司法对收购报价的合理性进行分析，并且比较了星科金朋市场股价走势。

具体估值情况如下：

(1) 可比公司法估值分析

估值报告选取日月光、安靠、矽品及力成科技等海外半导体委外封装测试公司作为星科金朋可比公司。考虑到半导体委外封装测试行业对资本投入的依赖程度及资本支出相对较高，而星科金朋资产中包括大量无形资产，采用 P/TBV（即扣除无形资产的市净率）估值具有可比性与可参考性。另外，由于缺少星科金朋最近十二个月剔除台湾子公司的历史备考 EBITDA（息税折旧摊销前利润）数据且星科金朋净利润为负，无法使用历史 P/E 与 EV/EBITDA 指标进行估值分析。行业内可比公司的 P/TBV 估值倍数如下：

公司	上市地	P/TBV
		基于 2014 年 9 月末 扣除无形资产的净资产
日月光	台湾、美国 (ADR)	2.43x
矽品	台湾、美国 (ADR)	2.23x
Amkor	美国	1.50x
力成科技	台湾	1.47x
均值		1.91x

数据来源：Bloomberg，公司公告，股价数据截至 2014 年 12 月 29 日。

该次交易中，星科金朋（剔除台湾子公司）100% 股权收购方案约定的交易价格为 7.8 亿美元（注：由于美元对新元汇率变动，最终实际收购对价约 7.45 亿美元，下同）。根据星科金朋管理层提供的备考财务数据，星科金朋（剔除台湾子公司）2014 年 9 月末扣除无形资产后的净资产为 39,562.1 万美元，因此，星科金朋（剔除台湾子公司）100% 股权相对估值水平（P/TBV）为 1.97 倍，具体计算过程如下：

项目	2014.9.30
扣除无形资产后的净资产（剔除台湾子公司，万美元）	39,562.1

项目	2014.9.30
交易对价（万美元）	78,000.0
交易对价对应市净率（P/TBV）	1.97x

为了进一步分析可比公司及该次收购星科金朋的差异，对相关公司的关键财务指标比较如下：

单位：百万美元

财务指标 (2013 年度) 注1	星科金朋	日月光 ^{注3}	矽品	Amkor	力成科技
收入	1,599	7,371	2,325	2,956	1,262
毛利润	218	1,436	484	545	177
毛利润率	13.6%	19.5%	20.8%	18.4%	14.1%
归属母公司股东净利润	-47	516	196	109	-134
净利润率	-3.0%	7.1%	8.5%	3.7%	-10.7%
总资产	2,378	9,612	3,413	3,427	2,414
净资产	971	4,215	2,074	965	1,243
杠杆率 ^{注2}	48%	45%	25%	63%	37%
总资产周转率	0.67	0.77	0.68	0.86	0.52
2012-2013 年 收入增长率	-6.1%	13.3%	7.3%	7.1%	-9.6%

注 1、以美元为单位的财务指标基于星科金朋、Amkor、日月光和矽品相关年报披露的数据计算。力成科技相关年报披露的财务数据以新台币为单位，以美元为单位的财务指标根据 2013 年 12 月 31 日的汇率（1 美元=29.807 新台币）换算；

2、杠杆率根据总负债除以总资产计算；

3、日月光财务数据包括了其封装测试业务（ATM）及模组代工业务（EMS）。模组代工业务与星科金朋经营的业务不具有可比性。

数据来源：公司年报

尽管上述公司属于同一个行业，但其经营模式、产品结构、公司特点、财务状况等都有一定的差异，因此，没有与星科金朋在各方面都完全可比的公司，相关可比公司估值水平仅能提供一定的示意性参考。

综合比较上述估值指标，该次收购定价处在可比公司估值倍数参考区间内，相对公允地反映了星科金朋的价值。

（2）基于星科金朋股价走势的定价合理性分析

截至 2014 年 12 月 29 日前的三年，星科金朋每股价格最高 0.750 新元，最低 0.290 新元，成交量加权平均价格 0.518 新元，该次交易对价约为 0.466 新元/股，综合考虑台湾子公司的价值（约合 0.053 新元/股）后，星科金朋股东获得的对价总计约为 0.519 新元，略高于过去三年交易均价，较截至 2014 年 12 月 29

日前一年交易均价折价 9.1%，较截至 2014 年 5 月 14 日（2014 年 5 月 14 日新加坡证券交易所首次就星科金朋被收购的可能进行查询，星科金朋之后应要求做出公告，因此 2014 年 5 月 24 日为星科金朋股价未受收购影响的最后一个交易日）前 12 个月期间的均价存在 45.1% 的溢价。

综上，该次收购定价考虑了星科金朋的新加坡市场股价走势情况，具有合理性。

单位：新元

项目	最高价	最低价	成交量加权平均价格	相对均价的溢价/（折价）
截至 2014 年 12 月 29 日 （包括）前一年	0.750	0.300	0.571	-9.1%
截至 2014 年 12 月 29 日 （包括）前三年	0.750	0.290	0.518	0.3%
截至 2014 年 5 月 14 日 （包括）前一个月 ^注	0.410	0.335	0.374	38.7%
截至 2014 年 5 月 14 日 （包括）前三个月 ^注	0.410	0.310	0.365	42.2%
截至 2014 年 5 月 14 日 （包括）前六个月 ^注	0.410	0.300	0.353	47.1%
截至 2014 年 5 月 14 日 （包括）前十二个月 ^注	0.420	0.300	0.358	45.1%

注：2014 年 5 月 24 日为星科金朋股价未受收购影响的最后一个交易日。

资料来源：Bloomberg

（3）关于收购星科金朋定价公允性的相关审议程序

2015 年 1 月 12 日，公司召开第五届第二十四次临时董事会，审议并通过《关于确认中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案》，公司于 2015 年 2 月 12 日召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过上述议案，认为估值机构具有独立性，估值假设前提具有合理性，估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致，长电科技是综合考虑并全面评估了星科金朋的市值、净资产、品牌、技术和渠道价值等因素，最终确定了收购价格。

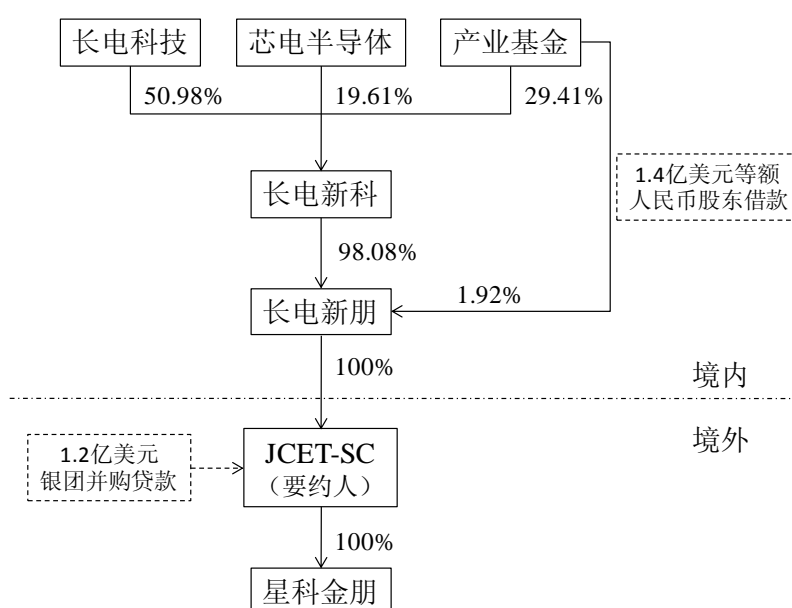
公司独立董事亦关于该次收购定价公允性发表了如下独立意见：“本次交易价格乃基于公平合理的原则，通过谈判确定，并已综合考虑了多方面的影响因素，交易价格合理公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

综上，该次收购星科金朋定价是长电科技在综合考虑并全面评估星科金朋的二级市场股价、净资产、品牌、技术和渠道价值等因素的基础上确定的，与星科金朋可比公司估值水平、星科金朋在新加坡二级市场股价走势相比具有合理性，能够反映星科金朋（不含台湾子公司）的公允价值，定价公允合理。

（四）收购的资金来源、投入方式及偿付计划

1、收购的资金来源、投入方式

该次要约收购星科金朋的融资方案具体如下图所示：



长电科技为该次收购在苏州工业园区成立了一家特殊目的公司长电新科，产业基金和芯电半导体根据《共同投资协议》的约定对其进行增资。长电新科为该次收购在苏州工业园区设立了长电新朋，产业基金根据《共同投资协议》的约定对其进行增资和提供股东借款。长电新朋为该次收购在新加坡设立 JCET-SC 为本次收购的实施主体，即要约人，JCET-SC 申请了并购贷款融资 1.2 亿美元。收购完成后，JCET-SC 持有星科金朋 100% 的股权。

该次收购中，长电科技、产业基金及芯电半导体具体资金来源及投入方式如下：

（1）长电科技出资 161,498.41 万元（2.6 亿美元等额人民币），均为现金出资，其中 59,000 万元为 2014 年非公开发行部分募集资金变更用途，其余

102,498.41 万元为自有资金；其中部分募集资金变更用途经长电科技董事会、股东大会审议通过，独立董事、保荐机构、监事会发表了明确同意意见，履行程序完整。

(2) 产业基金出资及借款合计 186,344.31 万元，均为自有资金。

产业基金根据《共同投资协议》的约定对长电新科现金增资 93,172.16 万元（1.5 亿美元等额人民币），对长电新朋现金增资 6,211.48 万元人民币（0.1 亿美元等额人民币）。此外，产业基金向长电新朋提供股东借款 86,960.68 万元人民币（1.4 亿美元等额人民币），该部分股东借款可根据双方约定进行转股。

(3) 芯电半导体出资 62,114.77 万元，为自有资金。

芯电半导体根据《共同投资协议》的约定对长电新科以现金增资方式投入 62,114.77 万元人民币（1 亿美元等额人民币）。

(4) 银团并购贷款 1.2 亿美元由中国银行牵头的银团提供，长电科技通过内保外贷形式为 JCET-SC 该项并购贷款提供了融资担保。

2、偿付计划

2015 年 11 月，产业基金将向长电新朋提供的可转换为股权的股东借款 1.4 亿美元等值人民币全部转为长电新朋股权。债转股完成后，长电新科持有长电新朋 77.27% 的股权，产业基金持有长电新朋 22.73% 的股权。

2017 年 6 月，长电科技以发行股份方式购买了产业基金持有的长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权以及芯电半导体持有的长电新科 19.61% 股权。该次交易完成后，长电科技持有长电新科 100% 的股权及长电新朋 100% 的股权，从而间接持有星科金朋 100% 股权。

2017 年 7 月，长电科技偿还了 1.2 亿美元银团并购贷款。

二、2014 年度募集资金用途变更比例较高的原因及合理性，公司募集资金决策是否谨慎合理、是否存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形的说明

(一) 2014 年度募集资金用途变更比例较高的原因及合理性

1、2014 年度变更募集资金用途的情况

经公司 2013 年 11 月 27 日召开的第五届第十次临时董事会、2013 年 12 月 6 日召开的第五届第十一次临时董事会和 2013 年 12 月 24 日召开的 2013 年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司该次非公开发行募集资金总额不超过 125,000 万元，扣除发行费用后本次非公开发行募集资金净额不超过 120,000 万元，按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投入金额
年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目	84,080	84,080
补充流动资金	-	35,920
合计	-	120,000

2014 年 8 月 25 日，经中国证监会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]874 号）核准，公司以非公开发行股票的方式募集资金总额人民币 1,249,960,068.90 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,186,332,625.62 元。2014 年 9 月 24 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“苏公 W[2014]B103 号”《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 30 日，公司使用募集资金共计 47,813.39 万元，尚未使用募集资金项目余额为 71,205.32 万元（包含利息），具体如下：

单位：万元

项目名称	已使用募集资金金额	剩余募集资金金额
年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目	13,146.98	71,205.32
补充流动资金	34,666.41	-
合计	47,813.39	71,205.32

公司于 2014 年 12 月 26 日召开第五届第二十三次临时董事会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，于 2015 年 2 月 12 日召开 2015 年度第一次临时股东大会审议通过上述议案，变更“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”中的 5.9 亿元募集资金用于收购星科金朋股权。

2、2014 年度变更募集资金用途的原因及合理性

2014 年底公司拟对星科金朋进行要约收购，鉴于星科金朋已在韩国和中国建有较大规模的 FC（倒装）集成电路封装测试产品生产线，且截至 2013 年底，

星科金朋 FC（倒装）集成电路封装测试产品的总产能利用率约为 63%，产能利用率不高。同时截至 2014 年底“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”仅投入了募集资金 13,146.98 万元，尚有 71,205.32 万元未投资，相对较大规模的 FC 产能尚未开始建设。为收购完成后充分利用星科金朋现有 FC 相关产能，避免重复建设导致产能过剩，经研究分析 FC 市场需求及发展情况、公司 FC 产能布局及产能利率状况，公司出于谨慎考虑，决定降低“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”投资规模，变更部分募集资金用途用于收购星科金朋。公司变更该项募集资金用途是合理的。

（二）公司募集资金决策是否谨慎合理

1、公司制订 2013 年非公开发行方案时计划将募集资金投向“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”具备合理性、谨慎性

公司 2013 年度非公开发行募集资金扣除发行费用后计划用于“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”和补充流动资金。其中“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”预计投资 84,080 万元，拟使用募集资金 84,080 万元。公司该次募集资金用途决策具有合理性和谨慎性，具体分析如下：

（1）该次募投项目受国家产业政策支持，市场前景广阔

集成电路行业作为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性新兴产业，我国始终大力支持集成电路行业的发展，并制定了一系列行业支持政策。我国集成电路封装测试行业一直保持稳定增长，虽然 2008 年全球金融危机导致全球及国内集成电路封装测试行业有所下滑。但 2010 年以后，随着全球经济的逐步回暖，全球半导体行业复苏及国内经济的持续增长推动我国集成电路封装测试行业持续增长，销售额由 2006 年 511.6 亿元增长至 2012 年 1,035.67 亿元。随着集成电路技术 I/O 密度的不断提升、芯片集成度的持续增加和工作频率的加快，下游市场对集成电路封装测试行业技术提出了更高的要求。而随着铜柱凸块技术的成功推广应用，FC 封装在缩减节省空间、高 I/O 密度、高性能、低电阻、高散热等方面的优势得以充分发挥，能够满足下游电子整机产品日益微型化及多功能系统集成发展趋势的需求。因此，FC 封装相比于传统的引线键合技术优势明显，越来越多的芯片产品选择 FC 封装，FC 封装正逐步成为集成电路封装

测试行业的主流技术。

(2) 该次募投项目有公司技术积累提供支撑

公司一直重视技术研发，已形成雄厚的技术积累，为募投项目的顺利实施提供强有力的技术支撑。截至 2012 年底，公司及子公司已累计获得授权的专利共 546 项，其中发明专利 68 项，实用新型专利 471 项。公司已掌握多项国际前沿技术，形成了以 TSV、射频 SiP、圆片级三维再布线封装工艺、铜凸点互连（Cu Pillar Bumping）、高密度 FCBGA、50 μ m 以下超薄芯片三维立体堆叠、MEMS 多芯片封装等技术为核心的先进集成电路封装测试技术体系。尤其是在 FC 封装方面，公司拥有铜凸点 FC 封装技术相关的全套专利，这将能够充分满足本项目的技术需求。此外，公司拥有国内唯一的“高密度集成电路封装技术国家工程实验室”。

(3) 该次募投项目有公司先进生产经验提供产品品质保证

公司的高端集成电路封装测试生产能力位居国内领先，具备丰富的高端集成电路封装测试量产经验，为募投项目成功达产奠定坚实基础。公司已形 Bumping（8"~12"）、WLCSP 产品 3P3M、以封装移动基带芯片为主的 BGA 12" 40nm low-k 芯片 BGA 等高端集成电路封装测试产品的规模化量产。尤其是在 FC 封装测试方面，公司 Flip Chip on L/F、FCLGA 和 FCBGA 产品均已达到规模化量产，形成了 Bumping 到 Flip Chip 一条龙封装和服务能力。公司在高端集成电路封装测试的生产能力，尤其是在 FC 封装测试方面的量产经验将能确保募集资金投资项目产品的顺利生产。

(4) 该次募投项目有优质客户资源确保产品销售市场

现有优质客户资源将为该次募集资金投资项目的顺利实施打下扎实的市场基础。在长期经营发展过程中，公司凭借先进成熟的生产技术、良好产品品质及优质的客户服务积累了大量优质客户资源。公司与国内的主要 FC 客户及部分国际大客户有着良好密切的合作关系。

(5) 该次募投项目预测效益良好

该次募投项目原计划建成后将形成年封装 FCBGA 系列、Flip Chip on L/F 系

列以及 FCLGA 系列等 FC（倒装）封装测试产品 9.5 亿块的生产能力。经谨慎测算，预计项目达标达产后将新增年利润总额 12,828 万元，预计投资回收期（税后）约 7.91 年（含建设期 2 年），内部收益率（税后）为 13.59%，预测效益良好。

综上，公司 2013 年制定非公开发行方案时计划将募集资金投向年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目的募集资金投资决策是谨慎性的、合理的。

2、2014 年募集资金用途变更具有谨慎性、合理性

(1) 降低“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”投资规模具有谨慎性、合理性

2014 年底，公司变更部分募集资金用途，主要是由于当时公司拟收购星科金朋，而星科金朋已在韩国和中国建有较大规模的 FC（倒装）集成电路封装测试产品生产线，且产能利用率不高，截至 2013 年底星科金朋该产品总产能利用率约 63%。同时截至 2014 年底年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目仅投入了募集资金 13,146.98 万元，尚有 71,205.32 万元未投资，相对较大规模的 FC 产能尚未开始建设。

为收购完成后充分利用星科金朋现有 FC 相关产能，避免重复建设导致产能过剩，经研究分析 FC 市场需求及发展情况、公司 FC 产能布局及产能利率状况，公司出于谨慎考虑，决定降低“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”投资规模，变更部分募集资金用途。

从 2015 年 8 月收购完成后实际情况来看，星科金朋 FC（倒装）产能利用率也不高，直到 2017 年第四季度产能使用才比较充分。

若当时继续投资年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目，公司整体 FC（倒装）相关产能将出现过剩，产能利用率更加不足。

因此，公司降低原募集资金投资项目投资规模具有谨慎性、合理性。

(2) 部分募集资金变更用于收购星科金朋具有谨慎性、合理性

①公司收购星科金朋系出于自身发展考虑，属于长期性、战略性的决策

星科金朋主要从事半导体封装及测试业务，是世界排名前列的半导体封装

测试公司，拥有行业领先的高端封装技术、持续的研发能力及丰富的专利技术、优质蓝筹国际客户群体、领先的行业地位等优势。

公司收购星科金朋系出于自身发展考虑，收购的主要目的是解决公司进一步发展的技术瓶颈和客户资源瓶颈，快速把公司封测技术提升到国际一流水平，并进入国际顶尖客户供应链，从而使公司具有国际一流竞争力，该项收购属于长期性、战略性的决策，具体如下：

I、收购星科金朋加速提升公司行业地位及国际影响力

星科金朋在被收购前已在新加坡、中国、韩国等国家和地区设立分支机构，拥有超 20 年的行业经验，在先进封装技术领域处于领先地位。按 2014 年度销售额计算，星科金朋是全球半导体委外封装测行业（OSAT）第四大经营者，而长电科技是第六大经营者。

通过收购星科金朋，公司行业地位及国际影响力快速提升。根据 IC Insights 报告，长电科技销售收入在 2016 年全球前 10 大委外封测厂排名上升至第三位，超过矽品（SPIL）。

II、收购星科金朋大幅提升公司先进封装技术水平

星科金朋拥有 eWLB（嵌入式晶圆级球栅阵列）、TSV（硅通孔封装技术）、3D 封装、SiP（系统级封装）、PiP（堆叠组装）、PoP（堆叠封装）等国际先进封装技术。特别是在半导体封测行业未来发展的两大主流方向，即晶圆级扇出型封装和系统级封装两个领域，星科金朋所拥有的 eWLB 技术和高阶 SiP 技术作为最新一代封装技术，处于国际领先水平。此外，星科金朋持续的技术开发形成了丰富的专利，截至 2017 年 9 月 30 日，星科金朋共拥有 2,527 项专利，其中美国专利商标局（PTO）授予或批准的为 1,731 项。

通过收购星科金朋，公司打通了进一步发展的技术瓶颈，先进封装技术水平大幅提升，中高端封装技术、产能明显增强。特别是 eWLB 与 SiP 两项技术，公司经论证认为其为国际半导体领域前沿封装技术，分别为其筹措资金进行投资，并设立了重点项目专项管理，已经分别通过 SGS 和 JSCK 实施，形成新的利润增长点。

III、收购星科金朋使公司直接进入国际知名客户供应链

星科金朋在全球拥有庞大而又多元化的客户群，全球前 15 大半导体公司绝大部分为其客户，涵盖集成电路制造商、无晶圆厂公司及晶圆代工厂，并且许多客户都是各自领域的市场领导者。

收购星科金朋使公司直接进入国际知名客户供应链，业务覆盖国际、国内主要高端客户，提升了公司国际竞争能力。

IV、收购星科金朋之后整合协同

通过收购后整合星科金朋产能资源，公司得以快速组建 JCAP+JSCC 的从芯片凸块 (Bumping) 到倒装 (FC) 一站式服务生产基地，为国内高端客户原在境外的封测业务转移至国内提供了产能和技术支撑，实现了进口替代。

②变更用于收购的募集资金占整体收购资金比例较低

2014 年公司出于自身发展考虑决定对星科金朋进行收购。其中公司的部分出资由募集资金变更用途而来，金额为 59,000 万元人民币，占收购星科金朋实际支付对价约 74,520.49 万美元（折合人民币 455,961.10 万元）的比例仅 12.94%，占比较低。

③星科金朋 2017 年第四季度经营状况已明显改善

1、营业收入及毛利率大幅增长，2017 年第四季度实现盈利

2017 年第四季度，星科金朋实现营业收入约 3.39 亿美元（未经审计，下同），较第三季度上升 13.18%；综合毛利率上升至 8.58%，星科金朋于 2017 年第四季度实现了单季度盈利。

II、主要客户订单量企稳，产品结构和客户结构逐步优化

随着影响星科金朋经营的因素逐步消除，主要客户订单量企稳，2017 年各季度前五大客户对星科金朋的订单量如下：

单位：万美元

项目	2017 年 第四季度	2017 年 第三季度	2017 年 第二季度	2017 年 第一季度	合计

项目	2017年 第四季度	2017年 第三季度	2017年 第二季度	2017年 第一季度	合计
前五大客户 订单量合计	19,679.34	16,488.12	13,364.55	13,467.30	62,999.30

注：本反馈回复所指订单量均包括客户直接下达的订单，以及该客户通过外包给晶圆代工企业而间接下的订单。

由此可见，2017年前五大客户对星科金朋的订单在逐步回升。2017年第四季度，星科金朋前五大客户对星科金朋的订单金额达到19,679万美元，较2017年前三个季度和2016年同期均有上升。

同时，公司在收购星科金朋后对星科金朋产品结构的调整已初见成效，2017年星科金朋通信业务占比逐步降低，非通信业务占比提升。2017年各季度星科金朋非通信业务占营收比重如下：

项目	2017年 第四季度	2017年 第三季度	2017年 第二季度	2017年 第一季度
非通信业务收入占比	44.40%	34.60%	34.70%	29.20%

2017年第四季度，星科金朋非通信业务占比提升至44.40%，较2016年同期上升20.70%。

此外，收购完成后，公司利用在中国市场优势与影响力，积极帮助其导入新客户，星科金朋在收购完成后新增客户2017年各季度订单量如下：

单位：万美元

项目	2017年 第四季度	2017年 第三季度	2017年 第二季度	2017年 第一季度	合计
星科金朋于被收购 后新增客户订单量	6,580.99	2,726.05	1,248.87	1,062.49	11,618.40

其中，2017年第四季度新增客户订单量约占当季度营业收入19.44%。在大力拓展新客户的基础上，星科金朋也在与原有客户大力开展合作，导入其新产品。

综上，随着产品结构和客户结构调整、工厂搬迁完成，星科金朋经营业绩已开始明显改善，2017年第四季度已经实现盈利，星科金朋正逐步恢复盈利能力。

④中长期看星科金朋能达到收购效果，具备良好的发展前景和盈利能力

星科金朋作为全球封测行业第一梯队企业，其领先封装技术、高端客户资源、国际化经营管理、信息化管理系统等竞争优势依然突出，2017 年第四季度经营状况已明显改善，公司对星科金朋的整合已初见成效，中长期看能达到收购效果，依然具备良好的发展前景和盈利能力：

I、半导体行业市场前景广阔，国内半导体行业发展强劲

随着云计算、大数据的持续崛起，全球信息产业开始从以前的数字化向智能化提升，物联网时代将掀起全球第三次信息化浪潮，集成电路的驱动力也将逐步由智能手机向物联网终端/云端转移，半导体行业将迎来新的发展契机。Gartner 预测，在未来几年全球半导体行业营业收入会有稳定成长，2017 年全球半导体行业总营收将达到 4,014 亿美元。这将是全球半导体营收首度突破 4,000 亿美元大关。

在国家政策的大力支持下，国内半导体行业正处于高速发展期。根据中国半导体行业协会统计，自 2009 年以来，我国集成电路市场保持高速增长，至 2014 年，我国集成电路市场销售规模从 1,109 亿元增长至 3,015 亿元，增幅超过一倍，期间的年均复合增长率达到 22.14%，明显高于全球市场增速。受到国内“中国 2025 制造”、“互联网+”等发展战略带动，以及外资企业加大在境内投资影响，2015 年中国集成电路产业保持高速增长，销售额为 3,610 亿元，同比增长 19.73%，2016 年上半年中国集成电路产业销售额同比增长 16.1%。按照 2017 年至 2020 年，年增长率稳定在 20%的趋势计算，到 2020 年，中国集成电路营业收入将达到 8,990 亿元。

II、SCC 搬迁至 JSCC 已经完成，国内市场将成为星科金朋未来盈利的重要支撑

借助国内半导体市场高速发展、技术水平不断升级，星科金朋正积极利用自身技术优势和本公司在中国市场的影响力，加大力度导入国内重点客户，服务国内高端客户需求，获取更多国内订单及市场份额，与其当前美国/欧洲为主的客户结构互补。目前 SCC 搬迁已经完成，JSCC 已经投入运营，正进行产能爬坡，随着国内半导体市场规模的不断扩大，以及星科金朋国内客户数量、规模及占比的提升，未来国内市场将成为星科金朋盈利的重要支撑。

III、主要客户对星科金朋的订单量已经企稳，新产品不断恢复导入

目前欧美半导体市场规模依然大幅领先，星科金朋结合自身技术、专利和产能储备等方面优势，制定了欧美客户拓展计划，要求每个 BU（生产子公司）与销售人员进行每家主要客户的产品特点和需求提供针对性的技术开发、产品导入、质量测试、信息服务、价格磋商等全面服务，维持有竞争力价格，通过驱动技术对标、维持技术先进性，支持客户技术图谱，发展和维护重点客户关系，成为行业顶级客户供应链中的优质供应商，提升市场占有率。

2015 年第三季度以来订单大幅下滑的大客户目前对星科金朋的订单量已经企稳，原有客户的新产品订单和收购后新客户的订单已经成为星科金朋重要订单来源。

IV、重大项目投资为星科金朋及长电科技培育了新的利润增长点

在半导体封测行业未来发展的两大主流方向，即晶圆级扇外型封装和系统级封装两个领域，星科金朋所拥有的 eWLB 和 SiP 两项技术已国际领先。公司经论证认为其为国际半导体领域前沿封装技术，分别为其筹措资金进行投资，并设立了重点项目专项管理，已经分别通过 SCS 和 JSCK 成功实施，形成新的利润增长点。

V、公司加大力度帮助星科金朋进一步优化财务结构

目前星科金朋资产负债率较高，且债务平均利率明显偏高。2017 年公司帮助星科金朋偿还了 7,500 万美元优先票据。在产业基金、芯电半导体等主要股东的支持下，公司加大力度帮助星科金朋进一步优化财务结构，降低财务费用。

综上，公司出于长期性、战略性考虑实际出资 7.45 亿美元（折合人民币约 45.60 亿元）收购了星科金朋。由于星科金朋已建有较大规模的 FC（倒装）产能且利用率不高，为了避免重复建设导致产能过剩，2014 年公司将原计划投资“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”的 5.9 亿元人民币募集资金变更用于参与收购，该次募集资金用途变更决策具备合理性、谨慎性。目前星科金朋经营业绩已开始明显改善，中长期看能达到收购效果，具备良好的盈利和发展前景。

(3) 募集资金用途变更决策程序谨慎、合理

公司上述变更募集资金用途事项已按照《公司章程》、《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规章制度履行了完整的内部决策程序：2014年12月26日，公司召开第五届第二十三次临时董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于同日召开第五届第十四次临时监事会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同时，公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，时任保荐机构华英证券有限责任公司亦就该事项出具了专项核查意见。2015年2月12日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司变更该项募集资金用途事项的决策是谨慎的、合理的。

综上，公司募集资金决策是谨慎的、合理的。

(三) 是否存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形

1、公司收购星科金朋主要系出于自身发展考虑

公司收购星科金朋系出于自身发展考虑，收购的主要目的是解决公司进一步发展的技术瓶颈和客户资源瓶颈，快速把公司封测技术提升到国际一流水平，并进入国际顶尖客户供应链，从而使公司具有国际一流竞争力。详细说明请参见本反馈回复本题之“二、2014年度募集资金用途变更比例较高的原因及合理性，公司募集资金决策是否谨慎合理、是否存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形的说明”之“（二）公司募集资金决策是否谨慎合理”之“2、2014年募集资金用途变更具有谨慎性、合理性”之“（2）募集资金变更后用于收购星科金朋用途谨慎、合理，标的资产中长期具备盈利性”之“①公司变更募集资金用于收购星科金朋系出于自身发展考虑，属于长期性、战略性的决策”。

2、公司筹划收购星科金朋时间晚于制定非公开发行股票方案时点

公司于2013年11月27日召开第五届第十次临时董事会，2013年12月6日召开第五届第十一次临时董事会，并于2013年12月24日召开2013年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，拟非公

开发行股份募集资金总额不超过 125,000 万元，扣除发行费用后拟投入 84,080 万元用于“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”。

2014 年 7-8 月，公司开始就收购星科金朋事项进行初步接洽、探讨，之后才筹划具体收购事宜。2014 年 11 月 5 日，公司召开了第五届第二十次临时董事会，审议通过了《关于向星科金朋做出不具有法律约束力的收购提议的议案》等相关议案，系公司收购星科金朋事宜的首次董事会决策。

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2014]E1321 号），截至 2014 年 10 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”的实际投资金额为人民币 78,017,595.50 元，公司拟以募集资金 78,017,595.50 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。2014 年 11 月 14 日，公司召开第五届第二十一次董事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 78,017,595.50 元。公司在筹划收购星科金朋前，“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”建设正有序实施，不存在刻意放缓情形。

根据上述时间先后顺序，公司制定 2013 年非公开发行股票募集资金方案时点，早于公司筹划收购星科金朋的时点。且在公司筹划收购星科金朋前，“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”建设有序实施，无刻意放缓情形。因此，从时间上也可以看出，公司不存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形。

3、公司已完整履行了募集资金投向变更决策程序

公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》，规范公司募集资金管理、使用，并严格执行。

公司 2014 年募集资金用途变更事项公司已按照上述法律法规及公司规章制度履行了完整的募集资金投向变更决策程序。2014 年 12 月 26 日，公司第五届

第二十三次临时董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同日公司第五届第十四次临时监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，时任保荐机构华英证券有限责任公司亦出具了专项核查意见。2014年12月30日，公司发布了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。2015年2月12日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司2014年募集资金用途变更事项履行了完整的募集资金投向变更决策程序。

综上，公司不存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形。

三、2015年度收购长电先进少数股权的意图、定价依据及评估情况，收购后的资产运行情况，是否曾披露盈利预测或业绩承诺及是否达到的说明

（一）2015年度收购长电先进少数股权的意图

1、2015年度收购长电先进少数股权基本情况

2015年11月，经中国证监会《关于核准江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2401号）核准，公司向江苏新潮科技集团有限公司发行28,076,710股新股，购买其持有的江阴长电先进封装有限公司16.188%股权，并向新潮集团非公开发行股份募集配套资金。该次交易完成后，长电先进成为公司直接和间接持股100%的子公司。

2、2015年度收购长电先进少数股权意图

长电先进是具有领先技术的晶圆凸块与晶圆级芯片尺寸封装的先进封测企业，是国家级高新技术企业，拥有晶圆凸块（Bumping）、晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）、硅通孔技术封装（TSV）等先进芯片封装技术，其封装产品可广泛应用于移动便携式装置、可穿戴电子产品、物联网基础单元、大型服务器计算与存储、LED照明与显示等诸多领域。

2015年公司收购长电先进少数股权之前，长电先进系公司控股子公司，其经营情况好，盈利能力强，是公司盈利的重要来源。该次收购前的两年一期长电先进经审计的利润表主要数据如下：

单位：万元

项目	2015年1-4月	2014年度	2013年度
营业收入	53,007.94	143,655.27	91,842.23
营业利润	8,448.83	19,006.11	8,257.00
利润总额	8,830.61	20,278.62	9,965.79
净利润	7,504.41	17,229.40	8,500.44
扣除非经常性损益后的净利润	7,179.89	16,147.77	7,047.97

公司 2015 年度收购长电先进少数股权的主要意图如下：

(1) 提升上市公司盈利能力

2013 年、2014 年，长电先进营业收入分别为 91,842.23 万元、143,655.27 万元，实现净利润分别为 8,500.44 万元、17,229.40 万元。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上市公司审计报告及备考财务报表审阅报告，该次收购前，上市公司 2014 年度每股收益为 0.18 元/股，该次收购后，上市公司 2014 年度每股收益为 0.20 元/股。收购完成后将增厚归属于上市公司股东的每股收益，提升股东回报水平。

(2) 强化新潮集团当时的控股地位

收购长电先进少数股权前，新潮集团持有上市公司 14.11% 的股份；收购（含配套融资）完成后，新潮集团持股比例增加到 18.37%，有利于强化新潮集团当时的控股地位，保持上市公司经营管理稳定性，给上市公司治理结构带来积极影响。

(二) 定价依据及评估情况，收购后的资产运行情况

1、2015 年度收购长电先进少数股权的定价依据

公司 2015 年度收购长电先进少数股权的交易价格以独立资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估结果为准，北京天健兴业资产评估有限公司具有执行证券期货业务资格。

此次收购评估基准日为 2015 年 4 月 30 日，评估机构采用了资产基础法和收益法对长电先进全部股东权益价值进行评估，最终选择了收益法的评估值作为评估结果。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2015）第 0409 号），长电先进全部股东权益的评估价值为 203,100 万元，

标的资产长电先进 16.188% 股权对应价值为 328,778,280 元。经交易双方协商，标的资产的交易价格确定为 328,778,280 元。

2、2015 年度收购长电先进少数股权的评估情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司对长电先进的股东全部权益价值以 2015 年 4 月 30 日为评估基准日出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2015）第 0409 号），北京天健兴业资产评估有限公司对长电先进全部股东权益价值进行了评估，并以收益法为最终评估方法。收益法评估结果如下：

截至评估基准日 2015 年 4 月 30 日，长电先进的股东全部权益价值为 203,100.00 万元，较账面净资产 71,949.41 万元，增值 131,150.59 万元，增值率 182.28%。长电先进 16.188% 股权对应价值为 328,778,280 元。

3、收购后的资产运行情况

（1）资产权属变更情况

截至 2015 年 11 月 6 日，江阴市市场监督管理局核准了长电先进的股东变更，标的资产长电先进 16.188% 股权由新潮集团名下变更为上市公司名下，双方完成了长电先进 16.188% 股权的过户事宜，长电先进成为上市公司直接和间接持股 100% 的子公司。

（2）资产账面价值变化情况

长电先进在收购前后账面价值变化情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 4 月 30 日 (评估基准日)	2015 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2017 年 9 月 30 日
资产总额	154,633.00	217,284.20	260,370.14	291,409.22
负债总额	82,683.58	132,165.65	140,601.04	148,274.36
净资产	71,949.42	85,118.55	119,769.10	143,134.86

注：2015 年 4 月 30 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日财务数据经审计；2017 年 9 月 30 日财务数据未经审计。

（3）生产经营情况

长电先进主营业务为集成电路的封装测试业务，是具有领先技术的晶圆凸块

与晶圆级芯片尺寸封装的半导体先进封测企业，是国家级高新技术企业。拥有晶圆凸块（Bumping）、晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）、硅通孔技术封装（TSV）等先进芯片封装技术。长电先进封装产品可广泛应用于移动便携式装置、可穿戴电子产品、物联网基础单元、大型服务器计算与存储、LED 照明与显示等诸多领域。

截至本反馈回复出具日，长电先进各项业务生产经营正常。

（4）效益情况

收购完成后，2015 年，长电先进实现营业收入 191,484.98 万元，较 2014 年增长 33.29%；实现净利润 20,673.54 万元。2016 年，长电先进实现营业收入 219,729.42 万元，同比增长 14.75%，实现净利润 18,211.64 万元。

（三）是否曾披露盈利预测或业绩承诺及是否达到的说明

根据收购过程中长电科技与新潮集团于 2015 年 6 月 1 日签署的《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》，新潮集团承诺长电先进 2015 年度、2016 年度、2017 年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币 15,700.47 万元、17,381.30 万元和 18,704.21 万元，利润补偿期间实现的净利润之和不低于 51,785.98 万元。如长电先进利润补偿期间内截至当年度实现的净利润之和未达到截至当年度的预测净利润之和，新潮集团将按约定进行补偿。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2016）专字第 61121126_B08 号”《专项审核报告》，长电先进 2015 年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 19,343.29 万元，高于承诺净利润。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2017）专字第 61121126_B08 号”《专项审核报告》，长电先进 2016 年度扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 13,951.21 万元，完成 2016 年利润预测数的 80.27%，而 2015-2016 年度累计实现盈利数（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）之和为 33,294.50 万元，高于累计承诺净利润，按照《盈利补

偿协议》约定新潮集团无需对承诺利润进行补偿。

2016 年度长电先进扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于利润预测数的主要原因为：

1、2016 年全球半导体市场小幅周期性下滑，而长电先进产品绝大部分为出口，受波动的直接影响；

2、个别重点客户需求由对外采购改为自给，导致长电先进订单订单减少，而新导入客户毛利相对较低；

3、新厂投入后运营成本有所增加。

2017 年 1-9 月，长电先进扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 14,988.96 万元（未经审计），达到本年度承诺净利润的 80.14%，长电先进经营情况良好。

四、星科金朋营业利润为负的情况下于 2017 年进一步收购少数股权的合理性，收购相关定价依据及评估情况，定价是否公允合理，是否存在利益安排

（一）收购星科金朋少数股权的合理性

为共同投资收购星科金朋，公司与产业基金、芯电半导体于 2014 年 12 月签署了《共同投资协议》、《售股权协议》、《投资退出协议》等协议，协议约定了三方共同投资收购星科金朋基本方案及相关安排，以及产业基金、芯电半导体的投资退出方式等内容，并且约定了三方应积极配合尽快通过发行证券方式使标的股权在收购星科金朋股份交割完毕后转换为长电科技股份。

上述《共同投资协议》、《售股权协议》、《投资退出协议》等协议经公司于 2015 年 2 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司也披露了其条款。

星科金朋主要从事集成电路封装测试外包业务，是全球半导体封装及测试行业的主要经营者之一。通过收购少数股权，星科金朋成为上市公司全资子公司，从而增强公司对星科金朋的控制能力，促进公司对星科金朋的深度整合。

星科金朋在报告期内的亏损主要是由多项暂时性、阶段性因素导致。星科金

朋在被公司要约收购前即由 2013 年的盈利状态变成 2014 年的亏损状态，2015 年要约收购完成后由于受工厂搬迁、个别大客户订单下滑等因素影响，星科金朋在要约收购后营业收入出现了一定程度下降，加上要约收购相关费用、债务重组等一次性费用，导致其出现较大亏损；但是该等因素以及一次性费用因素都是暂时性、阶段性因素，随着公司对其进行全面、深入整合，相关因素的影响正逐渐消除。

同时，通过该次交易，产业基金及芯电半导体（最终控股股东为中芯国际）由共同投资收购星科金朋的投资人成为全面支持长电科技发展的主要股东。产业基金是以促进我国集成电路产业发展为目的、经国务院批准设立的专业投资基金，芯电半导体最终控股股东中芯国际系中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，长电科技则是中国内地最大、全球第三大的集成电路委外封装测试企业；通过该次交易，充分发挥了产业基金对集成电路产业发展的引导作用，构建了中国内地最大、世界一流的集成电路制造产业链联盟，将带动中国内地集成电路制造整体水平和国际竞争力的提升。

综上，公司于 2017 年进一步收购星科金朋少数股权，即是公司履行与产业基金、芯电半导体在 2014 年底共同投资收购星科金朋时签署的相关协议的约定，也是公司在收购后进一步深度整合星科金朋的客观需要，而且，通过该项收购交易构建了长电科技作为国内集成电路封测龙头与中芯国际作为国内集成电路制造龙头之间的产业链联盟。因此，公司收购星科金朋少数股权具备合理性。

（二）收购相关定价依据、评估情况

根据公司与该次收购交易对方产业基金、芯电半导体签署的《发行股份购买资产协议》，标的资产的交易价格以中联资产评估集团有限公司（简称“中联评估”）出具的基准日 2015 年 12 月 31 日的资产评估报告中所载标的资产的评估值为基础，由交易双方协商确定。

根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 536 号）、《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 537 号）的评估结果，以 2015 年 12 月 31 日为基准日，长电新科采用资产基础法评估，全部权益评估价值为 339,989.15 万元，长电新朋采用市场法和收益法两种方法评估，并选取了市场法评估结果，全部权

益评估价值为 448,305.51 万元。标的资产长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权及长电新科 19.61% 股权对应价值分别为 99,990.81 万元、100,143.30 万元及 66,671.87 万元。经交易双方协商，标的资产长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权的交易价格确定为 199,100 万元，长电新科 19.61% 股权交易价格确定为 66,400 万元。

由于上述评估报告基准日为 2015 年 12 月 31 日，评估报告一年有效期已到，而交易尚未完成，因此公司聘请中联评估以 2016 年 6 月 30 日为基准日对长电新科、长电新朋全部股东权益再次进行了评估。根据中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2017]第 35 号）、《资产评估报告》（中联评报字[2017]第 36 号），以 2016 年 6 月 30 日为基准日，长电新科全部权益评估价值为 326,116.06 万元，长电新朋全部权益评估价值为 422,623.68 万元。根据以 2016 年 6 月 30 日为基准日的评估结果，长电新科、长电新朋全部股东权益评估值较以 2015 年 12 月 31 日为基准日评估值略有下降，但下降幅度较小（约 4%），不属于评估值的重大变化，不影响以基准日 2015 年 12 月 31 日的评估值为基础协商确定的交易作价的合理性；同时，由于 2016 年 1-6 月长电新科、长电新朋亏损，公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》约定，交易基准日（2015 年 12 月 31 日）至交割日期间标的公司的亏损将由交易对方按约定向上市公司以现金形式补足。因此，经交易双方协商，并经公司第六届董事会第九次会议审议通过，标的资产交易价格不变。

（三）定价公允合理性

1、标的资产估值符合集成电路行业发展状况

（1）集成电路市场前景广阔

近年来，受益于计算机、通信和消费电子以及节能环保、物联网、新能源汽车等新兴领域的发展，我国集成电路产业增长快速。未来，随着云计算、大数据、移动智能终端、物联网、汽车电子、安防、信息安全等领域的需求增长，集成电路产业将继续保持快速发展。集成电路产业的持续增长和巨大的市场需求带动了集成电路封装测试产业的快速发展。

（2）国家产业政策鼓励半导体封装测试行业发展

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。为了促进我国集成电路产业的持续发展，突破和掌握核心技术，增强信息产业创新能力和竞争力，推进国民经济和社会信息化，国家推出一系列鼓励性政策，为集成电路产业的发展提供了良好的产业政策环境。

2014年6月颁布的《国家集成电路产业发展推进纲要》将提升先进封装测试业发展水平列为主要任务和发展重点之一，指出要大力推动国内封装测试企业兼并重组，提高产业集中度。适应集成电路设计与制造工艺节点的演进升级需求，开展芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、硅通孔（TSV）、三维封装等先进封装和测试技术的开发及产业化。这些政策的出台都是国内封装测试行业发展的驱动力。2015年5月颁布的《中国制造2025》提出，着力提升集成电路设计水平，不断丰富知识产权（IP）和设计工具，突破关系国家信息与网络安全及电子整机产业发展的核心通用芯片，提升国产芯片的应用适配能力。掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。形成关键制造装备供货能力。

（3）行业技术水平日益提高

为了适应下游终端电子产品多元化、智能化、轻薄化、便携性等需要，新的封装技术不断涌现。封装技术的更新换代推动了整个半导体封装行业的发展。半导体封装厂商通过加大技术投入，引进先进的生产设备，不断提高产品的技术含量，开发新型产品，取得了较高的利润率水平，获得优势地位；同时，随着产品技术含量的提升，提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，保障了行业的健康发展。

2、标的资产的核心竞争力及预期协调效益对其估值形成有效支撑

（1）拥有半导体封装测试领先技术

星科金朋拥有行业领先的高端封装技术能力（如 eWLB、TSV、3D 封装、SiP 等）和资源优势，不仅能够跟随技术进步的步伐，而且随着集成电路相关业务继续向亚洲地区迁移，此次交易完成后，星科金朋还能够分享亚洲地区，特别是中国大陆集成电路封测行业增长机会。

(2) 优质蓝筹客户群体

星科金朋在全球拥有庞大而又多元化的客户群，涵盖集成电路制造商、无晶圆厂公司及晶圆代工厂，并且许多客户都是各自领域的市场领导者。

星科金朋的客户主要来自通信、计算机、电子消费品三个终端市场。因为其拥有高级阵列和堆叠封装技术专长及强大的混合信号/射频集成电路测试能力，销售收入主要来自通信终端市场。

星科金朋还拥有广泛的地区覆盖，客户遍布世界主要地区。2015年，美国、亚洲、欧洲客户占比分别为 60.95%、28.79%、10.26%。星科金朋在战略性半导体市场所在国家建立了成熟的业务，并且接近主要的晶圆制造枢纽，能够为客户提供全集成、多工位（multi-site）、端到端封测服务。

(3) 与长电科技预期协同效应

由于长电科技与星科金朋同为封装测试行业重要企业，且封装技术、客户群体各具优势，长电科技对星科金朋整合完成后预期可以实现收入和成本协同效应。其中，收入协同效应来自产品交叉销售、地区分布多元化、产能利用率提高。长电科技将为星科金朋带来广大的亚洲客户群，特别是中国内地市场正快速增长，星科金朋上海厂 SCC 搬迁至 JSCC 完成后中国市场对其业务贡献预计将提升，并与星科金朋原有欧洲或美洲为主的客户结构互补。星科金朋还能更高效地配置其制造产能，与长电科技产生业务协同。星科金朋与长电科技还将实现联合采购、一般及行政管理费用等成本协同效应。

3、交易定价相对估值水平合理

该次交易标的公司长电新科截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日的全部股东权益的评估值为 339,989.15 万元，而其 2015 年 12 月 31 日净资产（净资产等于归属母公司所有者权益）为 287,294.66 万元，2015 年长电新科全部股东权益的相对估值水平如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日
净资产	287,294.66
整体评估价值	339,989.15

项目	2015年12月31日
市净率 (P/B)	1.18

该次交易标的公司长电新朋截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日的全部股东权益的评估值为 440,577.63 万元，而其 2015 年 12 月 31 日净资产（因长电新朋合并报表层面无少数股东权益，净资产等于所有者权益）为 372,805.29 万元，2015 年长电新朋全部股东权益的相对估值水平如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日
净资产	372,805.29
整体评估价值	440,577.63
市净率 (P/B)	1.18

截至基准日 2015 年 12 月 31 日，国内 A 股市场主要从事集成电路封装测试业务的上市公司有华天科技、通富微电、太极实业。与同行业可比上市公司相比，分析如下：

股票代码	公司名称	市净率
		2015年12月31日
002185.SZ	华天科技	3.18
600667.SH	太极实业	4.13
002156.SZ	通富微电	3.84
中位数		3.84
平均数		3.72
长电新科		1.18
长电新朋		1.18

注：1、数据来源于 Wind 资讯；

2、上表中上市公司及同行业可比上市公司的市净率均为 2015 年 12 月 31 日市净率。

标的公司长电新科、长电新朋截至 2015 年 12 月 31 日净资产计算的市净率分别为 1.18 倍、1.18 倍，而同期国内同行业上市公司的市净率平均值为 3.72，标的公司股权定价的市净率低于国内同行业上市公司平均水平。

标的公司相对估值水平低于国内同行业上市公司，主要系国内 A 股上市公司具有一定的估值溢价。

综上，从星科金朋所处行业、自身核心竞争力、与上市公司预期协调效益，以及综合比较该次交易标的定价与国内同行业上市公司的相对估值情况，该次交

易定价公允、合理。

（五）是否存在利益安排

如前文所述，公司于 2017 年进一步收购星科金朋少数股权，既是公司履行与产业基金、芯电半导体在 2014 年底共同投资收购星科金朋时签署的相关协议的约定，也是公司在收购后进一步深度整合星科金朋的客观需要，而且，通过该项收购交易构建了长电科技作为国内集成电路封测龙头与中芯国际作为国内集成电路制造龙头之间的产业链联盟，该项收购具备合理性。

该次交易前，产业基金、芯电半导体均为上市公司原控股股东新潮集团、实际控制人王新潮先生及其控制的企业之外的第三方，该次交易价格以具有证券从业资格的评估机构中联资产评估集团有限公司出具的评估结果为参考，由交易双方协商确定，并经上市公司董事会、股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见，交易也经中国证监会核准。

除该次交易过程中上市公司与产业基金、芯电半导体分别签署了补充协议约定了过渡期损益安排和关于业绩的补偿安排外，该次交易不存在其他利益安排。

五、分多次收购星科金朋股权的考虑，是否存在一揽子协议，是否存在利益安排，上述资产购买是否构成借壳上市，是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

（一）分多次收购星科金朋股权的考虑

2015 年 10 月，公司联合产业基金、芯电半导体，通过设置三层持股公司（长电新科、长电新朋和 JCET-SC）的融资方案，完成要约收购星科金朋 100% 股份。

2017 年 6 月，公司完成发行股份购买产业基金持有的长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权以及芯电半导体持有的长电新科 19.61% 股权，从而持有长电新科 100% 的股权以及长电新朋 100% 的股权，从而间接持有星科金朋 100% 股权。

因此，公司前后通过两次收购，持有了星科金朋 100% 股权，分次收购的主要考虑及过程如下：

2014 年下半年长电科技出于自身发展考虑决定对星科金朋进行收购。由于要约收购方案确定的现金对价约为 7.8 亿美元等额人民币，长电科技当时可动用

现金约 2.6 亿美元等额人民币，资金缺口约 5.2 亿美元。

由于通过资本市场融资需要一定时间，且审批结果具有不确定性，为确保跨境收购成功，长电科技需要申请银行贷款或者引进投资人提供资金支持，帮助完成跨境收购。如果仅采用银行贷款方式解决收购约 5.2 亿美元资金缺口，收购完成后公司资产负债率大幅提升，财务风险较高，因此引进投资人系更为可行的方式。

产业基金是以促进我国集成电路产业发展为目的、经国务院批准设立的专业投资基金，中芯国际系国内集成电路产业重要企业，为支持长电科技发展，经沟通、协商，产业基金、中芯国际（以芯电半导体为实际出资主体）同意共同出资，以完成对星科金朋 100% 股权的收购。

同时，为了解决产业基金、芯电半导体共同出资收购星科金朋之后的退出问题，三方在约定共同出资收购星科金朋的同时，也约定了其投资退出方式及相关内容。

2014 年 12 月，公司与产业基金、芯电半导体签署了《共同投资协议》、《售股权协议》、《投资退出协议》和《债转股协议》等四项协议，协议约定了三方共同投资收购星科金朋基本方案及相关安排，以及产业基金、芯电半导体的投资退出方式等内容。同时，公司董事会审议通过了《关于公司收购 STATS ChipPAC Ltd. 暨实施重大资产重组的议案》及相关议案，同意公司与产业基金、芯电半导体通过共同设立的子公司 JCET-SC 为要约人，以自愿有条件全面要约收购的方式，收购于当时新加坡证券交易所上市的星科金朋发行在外的全部股份。

2015 年 10 月，公司联合产业基金、芯电半导体收购星科金朋 100% 股份全部完成。

由于前述协议同时约定了三方应积极配合尽快通过发行证券方式使标的股权在收购星科金朋股份交割完毕后转换为长电科技股份，2015 年 11 月底，公司开始筹划以发行股份方式购买产业基金、芯电半导体持有的长电新科、长电新朋少数股权事项。该事项于 2017 年 6 月交割完成。

（二）分多次收购星科金朋存在一揽子协议，不存在其他利益安排

2014 年 12 月，公司与产业基金、芯电半导体签署了《共同投资协议》、《售

股权协议》、《投资退出协议》和《债转股协议》等四项协议，约定了三方共同投资收购星科金朋基本方案及产业基金、芯电半导体的投资退出方式等内容，并且约定三方应积极配合尽快通过上市公司发行证券方式使产业基金、芯电半导体所持标的公司股权在收购星科金朋股份交割完毕后转换为上市公司股份。

1、《共同投资协议》的主要条款及内容

《共同投资协议》协议签署方：长电科技、芯电半导体、产业基金（芯电半导体、产业基金单独或合称为“投资方”）。

《共同投资协议》主要条款如下：

(1) 各方拟通过共同设立的公司收购星科金朋部分或者全部股份。根据各方协商一致，由长电科技、芯电半导体、产业基金共同出资在境内设立公司长电新科，长电新科与产业基金在中国境内设立 100%持股的长电新朋（长电新科以下简称“HoldCo A”，长电新朋以下简称“HoldCo B”，两者合称“HoldCo”），再由长电新朋于新加坡设立全资子公司 JCET-SC，作为未来拟实施本次收购的主体。

(2) 长电科技以 26,000 万美元等值人民币认购长电新科 50.98%的股权，芯电半导体以 10,000 万美元等值人民币认购长电新科 19.61%的股权，产业基金以 15,000 万美元等值人民币认购长电新科 29.41%的股权。

(3) 长电新朋的认缴出资结构为：长电新科认购出资 51,000 万美元等值人民币，产业基金认购出资 1,000 万美元等值人民币。产业基金还将向长电新朋提供股东贷款 14,000 万美元等值人民币，并享有将贷款转为对长电新朋股本的权利。

(4) 该次收购所需的全部款项由 JCET-SC 利用长电新朋的出资款及向金融机构贷款的方式取得。若相关金融机构要求对 JCET-SC 贷款提供担保，则由本公司向其提供。

(5) 在该次要约收购实施完毕满 5 年后，如果产业基金未选择行使《共同投资协议》规定的转股权利，长电新朋应支付从产业基金提供该股东贷款之日起至本次收购实施满 5 年期间的利息，年利率 10%（按每年 365 天计算），于本次

收购实施满 5 年后的 60 日内支付。该等利息在本次收购实施满 5 年后一次性计提，之后，长电新朋应按季度支付利息，并应在本次收购实施完毕 7 年届满之日前偿还全部本息，还款日由产业基金指定。虽有前述规定，在该 5 年期限未届满时，如果本公司违反其与产业基金签署的《售股权协议》，前述股东贷款的利息支付时间应提前至《售股权协议》约定的时间，且前述利率将调整为 15%。如果长电新朋未能还本付息，本公司将承担连带保证责任。

(6) 在该次要约收购实施完毕之日（以 JCET-SG 成为目标公司的股东之日为准）起 24 个月内（以下简称“锁定期”），任何一方向任何第三方转让其持有的长电新科、长电新朋的股权应获得其他各方的事先书面同意。

(7) 受限于《共同投资协议》对长电科技出售和股权的限制，在上述锁定期届满后，芯电半导体和产业基金有权向任何第三方转让其持有的长电新科的部分或全部股权，但在同等条件下，长电新科的其他股东有优先受让权。

(8) 受限于《共同投资协议》对长电科技出售股权的限制，在上述锁定期届满后，若芯电半导体或产业基金拟向第三方转让其持有的长电新科的股权的，且长电新科的其他股东不行使优先受让权的，则长电新科的其他股东有权要求按照同等条件一同向第三方转让其持有的长电新科的股权。

(9) 各方进一步同意，在投资方仍持有长电新科的股权的情形下，长电科技不得转让其持有的长电新科的股权。

当投资方根据本协议、《投资退出协议》或《售股权协议》的约定向长电科技转让长电新科及/或长电新朋的股份并成为长电科技股东的情况下，投资方承诺其对于持有的长电科技的股权将遵守适用法律及中国证券监督管理委员会监管规则所确定的限售期的相关规定。

2、《投资退出协议》的主要条款

《投资退出协议》协议签署方：长电科技、芯电半导体、新潮集团。

《投资退出协议》主要条款如下：

(1) 投资方退出指本次收购实施完毕后，长电科技收购芯电半导体持有的苏州长电新科投资有限公司 19.61% 的股权。

投资方退出方式如下：

①经长电科技及芯电半导体协商一致同意进行投资退出的，长电科技收购标的股权的方式由长电科技及芯电半导体协商后通过发行证券方式、支付现金方式或中国证券监管部门认可的其他方式进行，长电科技收购标的股权的价格将在综合考虑境内外同行业上市公司估值水平的基础上，反映相关股权的公允价值，且不考虑《共同投资协议》中产业基金向长电新朋提供的股东贷款的利息，由长电科技及芯电半导体协商确定。

②芯电半导体出售权

(i) 若长电科技及芯电半导体按照本协议约定经过友好协商后未能就长电科技收购标的股权的价格达成一致的，芯电半导体有权决定将持有的全部标的股权向长电科技出售，且有权在中国证券监管部门许可的范围内选择长电科技收购对价的支付方式，长电科技不得拒绝，长电科技收购价格按照下列公式确定，且应当自收到芯电半导体发出出售通知之日起 6 个月内与其签订相关的股权转让协议；

(ii) 出售价格=出资额* (1+Rp) n;

(iii) 其中：Rp 不低于 10%，不高于 12%；

③长电科技及芯电半导体应积极配合尽快通过发行证券方式使标的股权在星科金朋股份交割完毕后转换为长电科技股份。

(2) 若在长电科技收购标的股权事项公告后 18 个月内长电科技未能取得股东大会或中国证券监管部门就上述事项的批准的，则芯电半导体有权不经长电科技同意向任何其他方转让其所持股份，或要求新潮集团以支付现金的方式协议收购芯电半导体持有的全部标的股权，长电科技及新潮集团不得拒绝。协议收购的对价按本协议约定的公式计算，如果由于长电科技或新潮集团原因导致长电科技未能取得股东大会或中国证券监管部门就上述事项的批准的，Rp 应调整为 15%。

(3) 若长电科技的股东大会最终未批准根据本协议发生的投资退出交易，则芯电半导体除了有权不经长电科技同意向任何其他方（包括长电科技的竞争

对手) 转让其所持股份, 或要求新潮集团依上述规定以支付现金的方式协议收购全部标的股权以外, 还有权要求长电科技向其支付出资额的 5%作为赔偿金, 长电科技不得拒绝。

(4) 在芯电半导体行使本协议约定的出售权后 18 个月内, 如长电科技(或其关联方) 转让目标公司股权的作价高于长电科技收购标的股权的收购对价, 则长电科技收购标的股权的收购对价应自动上调至该较高的作价(按照同期银行贷款利率计算的时间成本导致的价格提高除外)。

(5) 在本协议的同时或之后, 芯电半导体之外的任何第三方如以优于本协议项下的收购收益率予以投资的, 芯电半导体应比照相应年化收益率条件自动享受同等待遇。

3、《售股权协议》主要条款

《售股权协议》协议签署方: 长电科技、产业基金、新潮集团。

《售股权协议》主要条款如下:

(1) 售股权

产业基金应享有选择权(“售股权”), 要求长电科技按本协议条款规定, 向产业基金收购其持有的长电新科和长电新朋的股权(产业基金持有的长电新科的股权称为“标的股权 A”, 产业基金持有的长电新朋的股权称为“标的股权 B”, 两者单独或合计称为“标的股权”), 长电科技有义务按本协议条款规定收购标的股权, 如长电科技未按照约定收购标的股权, 产业基金有权要求长电科技承担赔偿责任。

(2) 售股权行使时间

①本次要约收购股份交割满一年后, 产业基金有权行使关于标的股权 A 的售股权。

②如果要约收购股份交割满一年之前出现下述情况, 产业基金有权在出现下述情况时行使关于标的股权 A 的售股权:

(i) 芯电半导体根据投资协议要求长电科技回购芯电半导体持有长电新科

的全部或部分股权；

(ii) 星科金朋在收购股份交割后，在财务、融资、知识产权、重大合同的延续等方面出现或预期出现重大不利变化。

③本次要约收购股份交割满三年后，产业基金有权行使关于标的股权 B 的售股权。

④如果要约收购股份交割满三年之前出现下述情况，产业基金有权在出现下述情况时行使关于标的股权 B 的售股权：

(i) 长电科技第一大股东或实际控制人发生变化；

(ii) 星科金朋在收购股份交割后，在财务、融资、知识产权、重大合同的延续等方面出现或预期出现重大不利变化；

(iii) 星科金朋 2017 年度的经营状况未达到董事会届时要求的合理目标。

⑤长电科技及产业基金应积极配合尽快通过发行证券方式使标的股权在星科金朋股份交割完毕后转换为长电科技股份，如条件允许，星科金朋股份交割完毕后可早于本协议约定时间转换为长电科技股份。

(3) 售股权收购对价支付方式

产业基金在行使售股权时有权要求长电科技以向产业基金发行股份或其他证券方式支付标的股权收购对价（“发行证券方式收购”），也有权直接要求长电科技以现金方式支付标的股权收购对价（“支付现金方式收购”）。

(4) 发行证券方式收购标的股权

如产业基金要求发行证券方式收购，则各方应按照如下要求操作：

(i) 各方确定的长电科技的收购对价及收购方式应符合届时有效的中国法律法规的规定、中国证券监管部门的监管要求，各方应本着有利于实施长电科技收购的原则，友好协商，对相关事项进行调整。

(ii) 长电科技和产业基金应就收购对价进行协商，并在综合考虑境内外同行业上市公司估值水平的基础上达成一致，反映标的股权公允价值。长电科

技和产业基金应在对标的股权公允价值（该等公允价值应考虑产业基金已分担的中介费用）达成一致后 90 日内签订股权转让协议。

(5) 支付现金方式收购标的股权

如产业基金要求支付现金方式收购，则各方应按照如下要求操作：

(i) 长电科技和产业基金按协议规定确定标的股权公允价值（该等公允价值应考虑产业基金已分担的中介费用）。

(ii) 长电科技和产业基金应在对标的股权公允价值达成一致后 90 日内签订股权转让协议。

(iii) 长电科技应尽最大努力履行支付现金方式收购必要的内部议事程序及审批手续，包括但不限于获得长电科技董事会、股东大会（如需）批准。

(6) 约定回报价格收购标的股权

①在如下情形发生时，产业基金有权要求长电科技按照约定的回报价格以现金方式收购标的股权（“约定回报价格收购”）：

(i) 产业基金要求发行证券方式收购后 18 个月内，发行证券方式收购未能获得长电科技股东大会批准、中国证券监管部门核准或者由于其他原因未能完成，且产业基金不同意延长时间；

(ii) 产业基金要求支付现金方式收购或发行证券方式收购后 90 日内，产业基金与长电科技未能就收购对价达成一致或未能在收购对价达成一致后 90 日内签署股权转让协议。

②回报价格为如下价格中的较高者

(i) 按照出资额* $(1+R)^n$ 计算的固定价格

其中： $R=10\%$ ；

n 表示产业基金将出资额汇入 HoldCo 账户之日（含当日）至股权转让交割日（含当日）之间的天数除以 365 天。

(ii) 如果芯电半导体要求长电科技回购芯电半导体持有长电新科股权的

回报价格年化收益率超过本协议约定的回报价格（就该回报价格对应的 HoldCo 整体公允价值而言），该较高的回报价格自动适用于产业基金。

(7) 18 个月内收购对价调整机制

①在长电科技以支付现金方式收购标的股权的股权受让交割日后 18 个月内，如长电科技（或其关联方）转让 HoldCo 股权（或以资产出售、转让 HoldCo 下属公司股权等方式达到前述类似效果）的作价高于长电科技收购标的股权的收购对价（但时间成本造成价格差异除外），则长电科技收购标的股权的收购对价应自动上调至该较高的作价。

②如长电科技已经按照协议约定的回报价格支付收购对价的，应将上述回报价格与按照前款自动调整后的价格的差额部分按照产业基金要求的时间以现金方式支付给产业基金，产业基金应给予长电科技合理的准备时间。

4、《债转股协议》主要条款

《债转股协议》签署方：产业基金、长电新朋（HoldCo B）、长电新科（HoldCo A）。

《债转股协议》主要条款如下：

(1) 债转股选择权行使时间

本次收购股份交割满三年后，产业基金有权行使债转股选择权。

(2) 未行使债转股选择权时的股东贷款偿还

①产业基金未在本次要约收购股份交割五年内行使债转股选择权的，HoldCo B 应按照如下约定计算并向产业基金偿还和支付股东贷款本息，本协议另有约定的除外：

(i) 自产业基金提供股东贷款之日起至本次收购股份交割满五年之日期间，股东贷款利息按照年利率 10%（按每年 365 天计算）以及前述期间的实际天数计算。HoldCo B 应于收购股份交割满五年之日起 60 日内支付该等利息；

(ii) 本次收购股份交割满五年后，HoldCo B 应按季度支付利息。其中，本次收购股份交割满五年之日起每三个月届满为一个季度；股东贷款利息按照

年利率 10%（按每年 365 天计算）以及每个季度的实际天数计算。HoldCo B 应在前述每个季度届满后 10 日内支付该季度利息；

(iii) 股东贷款本金应在本次收购股份交割满 7 年之日还本付息。

(3) 股东贷款的提前偿还

要约收购股份交割满五年之前，若出现《售股权协议》约定的情形（即产业基金要求发行证券方式收购标的股权 A 后 18 个月内，发行证券方式收购由于长电科技或新潮集团原因未能获得长电科技股东大会批准、中国证券监管部门核准或者由于其他原因未能完成，且产业基金不同意延长时间的情形），HoldCo B 应立即偿还股东贷款本息，并且股东贷款利息及支付时间按照下述方式相应调整：

(i) 计息期间自产业基金提供股东贷款之日起至股东贷款利息实际支付完毕日期间的实际天数计算；

(ii) 股东贷款利息按照年利率 15%（按每年 365 天）计算。

(4) 股东贷款的担保

长电科技、新潮集团为 HoldCo B 在本协议项下股东贷款本息的偿还责任提供连带责任担保。HoldCo B 应在本协议签署同时向产业基金提供长电科技关于上述担保的担保函。

上述一揽子协议系为帮助长电科技完成对星科金朋收购，按照市场化原则及商业惯例作出的安排，分别经公司董事会、股东大会审议通过，公司于 2014 年 12 月 22 日公开披露了该等协议主要条款，不存在其他利益安排。随着 2017 年发行股份购买资产交易的完成，上述协议已履行完毕。

(三) 上述资产购买不构成借壳上市

1、2015 年收购星科金朋不构成借壳上市

该次交易为现金收购，不涉及公司股权变动。该次收购完成后，新潮集团仍为长电科技第一大股东，王新潮先生仍为长电科技实际控制人，该次交易不会导致公司控制权发生变化。该次收购不构成该次交易时适用的《上市公司重大资产

重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。

2、2017 年发行股份购买资产交易不构成借壳上市

(1) 根据重组方案制定时适用的《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)，该次交易不构成借壳上市

2016 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案及相关议案。根据该次重组方案审议时适用的《上市公司重大资产重组管理办法》(2014 年修订)第十三条规定，“自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 100%以上的，构成借壳上市”。

该次交易完成后，公司变更为无实际控制人状态，控制权发生变更。

该次交易中，按照资产总额与成交金额孰高原则，长电新科 29.41% 股权对应资产总额为 430,372.31 万元，长电新科 19.61% 股权对应资产总额为 286,963.65 万元，长电新朋 22.73% 股权对应资产总额为 332,619.13 万元，拟注入资产总额合计为 1,049,955.10 万元，占长电科技 2015 年度经审计资产总额 2,555,855.01 万元的 41.08%，未达到《重组办法》第十三条规定的条件。

综上所述，该次交易不构成借壳上市。

(2) 按照《上市公司重大资产重组管理办法》(2016 年修订)计算借壳上市相关指标，该次发行股份购买资产交易亦不构成借壳上市

①2015 年现金收购星科金朋与 2017 年发行股份购买资产交易计算是否构成借壳上市相关指标时不需要累计计算

2015 年 2 月 12 日，公司拟以 JCET-SC 为要约人向星科金朋当时的全体股东要约收购新加坡上市公司星科金朋，召开了 2015 年第一次临时股东大会进行审议，并获得会议有效表决权股份总数的 2/3 以上票数审议通过《关于公司收购 STATS ChipPAC Ltd.暨实施重大资产重组的议案》、《关于<江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案。JCET-SC 要约收购星科金朋过程中，公司分别于 2014 年 12 月 31 日、2015 年 1 月 14 日，根

据《上市公司重大资产管理办法》的规定编制并披露了《江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要，财务顾问中国国际金融有限公司出具了《关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》。

根据《上市公司重大资产管理办法》（2016年修订）第十四条第（四）款“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围”的规定，公司2015年现金收购星科金朋已按照《上市公司重大资产管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》第一条第（一）项的规定，“（一）执行累计首次原则，即上市公司控制权发生变更之日起60个月内（含上市公司控制权发生变更的同时），向收购人及其关联人购买的资产所对应的资产总额、资产净额、营业收入或净利润，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告的相应指标的比例累计首次达到100%以上的，或者所对应的发行股份的数量，占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份比例累计首次达到100%以上的，合并视为一次重大资产重组，应当按规定申报核准。”

公司2015年现金收购星科金朋的交易对方是星科金朋原控股股东新加坡STSP以及其其他股东，而2017年发行股份购买资产交易的交易对方是芯电半导体、产业基金，前后两次交易的交易对方不同，且无关联关系，因此无须按前述规定累计数分别计算相应指标数额。

②按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）计算借壳上市相关指标，2017年发行股份购买资产交易亦不构成借壳上市

根据2016年9月8日中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定计算，2017年发行股份购买资产交易拟购买的资产为产业基金持有的长电新科29.41%股权、长电新朋22.73%股权和芯电半导体持有的长电新科19.41%股

权，根据长电科技 2015 年度审计报告、长电新科及长电新朋 2015 年度审计报告以及该次交易价格情况，该次交易购买的资产相关指标数额计算如下：

单位：万元

项目	长电新科 29.41% 股权对应	长电新科 19.61% 股权对应	长电新朋 22.73% 股权对应	标的资产 指标合计	长电科技	比例
资产总额与成交金额孰高	430,372.31	286,963.65	332,619.13	1,049,955.10	2,555,855.01	41.08%
购买的资产 2015 年度所产生的营业收入	95,034.65	63,367.20	73,449.09	231,850.94	1,080,702.38	21.45%
购买的资产 2015 年度所产生的净利润	-13,158.72	-8,773.97	-10,068.72	-32,001.41	5,199.75	-615.44%
资产净额与成交金额孰高	99,600.00	66,400.00	99,500.00	265,500.00	430,822.21	61.63%

按照该次交易发行股份购买资产的标的资产作价及每股发行价格计算，长电科技向产业基金发行的股份数量为 129,706,840 股，向芯电半导体发行的股份数量为 43,257,328 股，为购买资产发行的股份数合计 172,964,168 股，占长电科技审议该次交易的董事会决议前一个交易日的股份总数 1,035,914,811 股的比例约为 16.70%，未达到 100%。

该次交易结束后，新潮集团、产业基金及芯电半导体三个主要股东均没有对公司日常经营业务进行重大调整的计划，长电科技仍将专注于集成电路的封装与测试业务，主营业务及发展方向不变。该次交易也不会导致长电科技的主营业务发生根本变化。

结合上述指标情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）第十三条规定，2017 年发行股份购买资产交易亦不构成借壳上市。

③以上市公司扣除标的资产相关财务指标的财务数据为基数进行计算，2017 年发行股份购买资产交易仍不构成借壳上市

鉴于上市公司 2015 年末已将标的公司纳入合并报告范围，为进一步说明 2017 年发行股份购买资产交易不存在《上市公司重大资产重组管理办法》（2016 年修订）第十三条所规定的借壳上市情形，以长电科技扣除标的资产相关财务指标外的财务数据为基数，相关指标计算结果如下：

单位：万元

项目	标的资产 指标合计	长电科技	长电科技 (扣除标的资产指标)	比例
资产总额与成交金额孰高	1,049,955.10	2,555,855.01	1,505,899.91	69.72%
购买的资产 2015 年度所产生的 营业收入	231,850.94	1,080,702.38	848,851.44	27.31%
购买的资产 2015 年度所产生的 净利润	-32,001.41	5,199.75	5,199.75	-615.44%
资产净额与成交金额孰高	265,500.00	430,822.21	430,822.21	61.63%

注：上表中计算长电科技扣除标的资产指标时：

1、长电科技资产总额按“长电科技 2015 年末合并报表总资产-标的资产 2015 年末合计资产总额与成交金额孰高”计算；

2、长电科技营业收入按“长电科技 2015 年度合并报表营业收入-标的资产 2015 年度合计合并报表营业收入”计算；

3、长电科技净利润为长电科技 2015 年度归属于母公司所有者的净利润，因为其中不含标的资产对应的少数股东损益，因此扣除前后金额一致；

4、长电科技资产净额为长电科技 2015 年末归属于母公司所有者权益，因为其中不含标的资产对应的少数股东权益，因此扣除前后金额一致。

从上表可见，即使以上市公司扣除标的资产相关财务指标的口径下计算，该次交易亦未达到《重组管理办法》第十三条规定条件。

综上，2017 年发行股份购买资产交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的情形，不构成借壳上市。

（四）上述资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定

1、2015 年收购星科金朋符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定

（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

工业和信息化部发布的《集成电路行业“十二五”发展规划》中提出集成电路产业是全球主要国家或地区抢占的战略制高点；将推进资源整合，培育具有国际竞争力大企业作为政策措施，按照战略协调、资源配置有效的原则，规范推进与各类所有制企业的并购重组；鼓励企业扩大国际合作，整合并购国际资源，设立海外研发中心，积极拓展国际市场。该次收购有利于公司与标的公司星科金朋之间的技术、市场、产品优势互补，发挥规模经济优势，进一步提高公司的综合

竞争力，有利于公司的长远发展。该次收购符合公司发展战略，符合公司和全体股东的整体利益。同时，该次交易符合国家产业政策，依据中国、新加坡等地的相关法律法规进行，不涉及违反有关中国环境保护、土地管理等法律和行政法规的情况。

根据《反垄断法》、《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律法规的规定，经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：（一）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；（二）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。该次交易达到了经营者集中的申报标准，并已通过相关部门批准。

综上所述，该次交易符合《重组办法》第十一条第（一）项之规定。

（2）不会导致上市公司不符合股票上市条件

该次交易不涉及发行股份，不影响公司的股本总额和股权结构，不会导致公司的股权结构和股权分布不符合股票上市条件。公司在交易发生时的三年内无重大违法行为，财务报告无虚假记载。

综上所述，该次交易符合《重组办法》第十一条第（二）项之规定。

（3）该次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

该次交易对价的确定因素包括但不限于：（1）标的公司净资产规模，（2）标的公司的品牌和渠道对于公司的战略价值，（3）收购完成后的协同效应，（4）标的公司市值。该次交易所涉及标的公司的定价方式采用市场化原则，交易价格公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

该次交易依法履行相关程序，公司董事会已聘请具有资质的相关中介机构出具法律意见书和独立财务顾问报告，并根据法律法规的相关监管要求履行了监管报批等相关程序，在交易过程中不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

综上所述，该次交易符合《重组办法》第十一条第（三）项之规定。

（4）该次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

该次交易标的为星科金朋股权。根据新加坡律师尽职调查情况，标的公司为依据新加坡法律合法设立、有效存续的公司，且标的公司章程中未包含任何可能会阻碍该次交易正常进行的条款。该次交易涉及的资产权属清晰，该次交易通过要约收购进行，股权过户不存在法律障碍。

（5）有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

标的公司星科金朋主营业务明确，根据 Gartner 公司报告，标的公司 2013 年为全球第四大半导体封装测试公司（以收入排名），与公司所处行业、主营业务一致，该次交易不会导致公司主营业务发生变化。

标的公司星科金朋业务覆盖欧美及亚洲多个地区，该次交易的实现对公司境外业务开展带来一定的协同效应，双方能够实现全方位的优势互补，拓展现有客户及市场，有利于公司增强持续经营能力。该次交易不会导致公司重组后存在主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

综上所述，该次交易符合《重组办法》第十一条第（五）项之规定。

（6）有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

公司经营管理体系完善、人员机构配置完整，具有独立自主的经营能力。该次交易前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其关联人。该次要约收购不构成关联交易，标的公司星科金朋在业务、资产、财务、人员、机构等方面与公司的控股股东、实际控制人及其关联人保持独立。该次交易亦不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更，上市公司继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东、实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

综上所述，该次交易符合《重组办法》第十一条第（六）项之规定。

(7) 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

该次交易前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律法规的要求，建立了比较规范、稳健的企业法人治理结构，并建立了比较完善的内部控制制度，从制度上保证股东大会、董事会和监事会的规范运作和相应职权的行使。

该次交易完成后，公司继续保持了健全有效的法人治理结构，并依据相关法律、法规和《公司章程》等的要求不断进行完善。

综上所述，该次交易符合《重组办法》第十一条第（七）项之规定。

2、2017年发行股份购买资产交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定

公司主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售以及分立器件的芯片设计、制造，星科金朋主营业务集成电路封装与测试；该次交易配套募集资金投资项目 eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目为境外实施项目，不涉及新增土地及厂房建设，根据当地法律法规无需当地备案和环评批复。涉及境内发改委、商务厅备案程序已经办理完成。该次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。

(2) 不会导致上市公司不符合股票上市条件

根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司股权分布发生变化导致不再具备上市条件是指“社会公众持有的股份低于公司股份总数的 25%，公司股本总额超过人民币 4 亿元的，社会公众持股的比例低于 10%”。

该次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司总股本为 1,359,844,003 股，其中社会公众股 984,570,000 股，比例超过 10%，该次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。

(3) 该次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形

该次交易标的资产作价以独立的具有证券资格的评估机构中联评估出具的《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 536 号）、《资产评估报告》（中联评报字[2016]第 567 号）的评估结果为依据，由交易双方协商后确定最终转让价格。

该次发行股份定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日。该次发行股份购买资产的发行价格在除息前为 15.36 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%；同时根据公司 2015 年度利润分配方案实施情况进行除息计算后，该次发行的发行价格调整为 15.35 元/股，根据公司 2016 年度利润分配方案实施情况进行除息计算后，该次发行的发行价格调整为 15.34 元/股，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。

该次交易双方约定标的资产的交易价格以截至评估基准日标的资产的评估值为参考，经双方协商确定。该次交易涉及到的发行股份价格确定方式反映了市场定价原则，维护了公司股东利益，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

(4) 该次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法

该次交易所涉及的长电新科及长电新朋的股权由交易对方产业基金及芯电半导体合法拥有，权属清晰。交易时产业基金持有的长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权以及芯电半导体持有的长电新科 19.61% 股权不存在委托持股、信托持股等情形，不存在纠纷或潜在纠纷，也不存在质押、冻结或法律、法规、规范性文件或章程所禁止或限制转让的情形。该次交易不存在债权债务处理情形。

(5) 有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形

该次交易完成后，公司归属于母公司股东的所有者权益有较大幅度提升，根据《根据本次重大资产重组完成后的架构编制的江苏长电科技股份有限公司 2015 年度及 2016 年 1-10 月备考审阅报告》，公司 2015 年末每股净资产由 4.16

元增加至 6.78 元，2016 年 10 月末每股净资产由 4.37 元增加至 6.71 元，同时公司资产负债率将有一定幅度下降，2015 年末资产负债率由 73.83% 降低至 66.88%，2016 年 10 月末资产负债率由 77.86% 降低至 71.50%，该次交易有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况，增强公司抗风险能力和持续经营能力。

该次交易完成后，虽然公司当期每股收益较该次交易前有所摊薄，主要系由于标的资产实际经营主体星科金朋尚处于收购后的整合过程中。但从中长期看，星科金朋拥有 eWLB、TSV、PiP、PoP、eWLCSP、SiP 等多项代表行业未来发展趋势的先进封装技术，在全球拥有庞大而多元化的优质客户群体，是集成电路封测外包行业技术和规模国际领先的企业；通过该次交易，星科金朋将成为公司间接持股 100% 的子公司，公司可以加强对星科金朋的控制力，继续深入推进业务整合，发挥星科金朋与公司之间涵盖市场及客户资源整合与开发、交叉销售、供应链管理、产能分配等方面的协同效应，提升公司先进封装技术水平和研发实力、提高公司行业地位和国际市场竞争力、拓展海外市场并扩大客户基础，提升盈利能力；同时，国内半导体市场仍处于高速发展阶段，星科金朋在国内具有较大发展空间，利用公司在中国市场的优势和影响力，星科金朋将加大力度开发国内市场，获取更多的订单及市场份额，提升公司未来整体盈利能力。通过该次交易亦加强了与产业基金和中芯国际的合作，在其支持下星科金朋可以顺利将其具备的先进封装技术产业化，形成新的利润增长点，有利于增强公司持续经营能力。

该次交易前，公司主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售以及分立器件的芯片设计、制造。该次交易完成之后，上市公司直接和间接持有星科金朋 100% 股权，公司主营业务未发生变化，该次交易不会导致上市公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

(6) 有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定

该次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。该次发行股份购买资产并募集配套资金完成后公司的实际控制人发生变化，交易对方产业基金及芯电半导体与新潮集团一并作为长电科技主要股东，产业基

金及芯电半导体分别出具了《保持上市公司独立性承诺》：“在本次交易完成后，本公司将继续保持长电科技的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循独立原则，遵守中国证监会有关规定，不利用长电科技违规提供担保，不占用长电科技资金，不与长电科技形成同业竞争”。该次交易完成后，公司继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与主要股东新潮集团、产业基金、芯电半导体及其各主要股东之关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定。

(7) 有利于上市公司形成或者保持健全有效的法人治理结构

该次交易前，公司已建立了较为完善的法人治理结构，该次交易不会导致公司的法人治理结构发生重大变化。该次交易完成后，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步完善公司各项制度的建设和执行，保持健全有效的法人治理结构。

3、2017年发行股份购买资产交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定

(1) 该次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性

该次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司归属于母公司股东的所有者权益大幅增加，资产负债率降低，有利于增强公司抗风险能力，有利于提高公司资产质量、改善财务状况、增强持续经营能力。

该次交易完成后，公司当期每股收益较该次交易前有所摊薄，主要系星科金朋于交易时仍处于收购后整合过渡期，工厂搬迁、个别大客户订单下滑等因素导致收入出现一定下滑，进而出现亏损。但是，星科金朋作为全球封测行业第一梯队企业，其领先封装技术、高端客户资源、国际化经营管理、信息化管理系统等核心竞争优势依然突出，业绩影响因素都是暂时性、阶段性的，随着整合措施起效，影响因素已经在逐步消除，中长期看星科金朋依然具备持续盈利能力，将增强上市公司未来持续盈利能力（关于公司对星科金朋整合的具体情况，请参见本反馈回复“重点问题九”之“一、关于公司是否能够对子公司星科金朋进行有效整合的说明”）。

该次交易前，上市公司与控股股东、实际控制人及其关联企业之间发生的关联交易均已按规定履行程序并公告；除该次交易本身系关联交易外，上市公司与交易对方及其关联方也不会因该次交易而新增关联交易，交易对方产业基金及芯电半导体也分别出具了《减少和规范关联交易的承诺》。该次交易完成后，上市公司与主要股东之间不存在同业竞争，交易对方产业基金已出具《同业竞争的说明和承诺》，交易对方芯电半导体及其最终控股股东中芯国际已分别出具《避免同业竞争承诺函》。该次交易完成后，上市公司继续在业务、资产、财务、人员、机构等方面与主要股东及其关联企业保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性相关规定；该次交易对方产业基金及芯电半导体亦分别出具了《保持上市公司独立性承诺》。

(2) 上市公司最近一年一期财务会计报告被注册会计师出具标准无保留意见审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（安永华明（2016）审字第 61121126_B01 号）；安永华明对上市公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（安永华明（2017）审字第 61121126_B01 号）。

(3) 上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形

上市公司及时任董事、高级管理人员不存在交易前最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、或者交易前最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪于交易时正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规于交易时正被中国证监会立案调查的情形。

(4) 上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续

该交易所涉及的长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权以及长电新科 19.61% 股权由交易对方产业基金及芯电半导体分别合法拥有，权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍。

根据该交易中公司与产业基金及芯电半导体签署的《发行股份购买资产协议》，在该协议生效之日起 45 日内，交易对方应当完成标的资产过户至上市公司名下的工商变更登记手续。自交割日起，标的资产的一切股东权利义务由上市公司享有和承担。

2017 年 6 月，该交易中涉及的标的资产已完成交割。

4、2017 年发行股份购买资产交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》及相关解答的规定

根据该交易时适用的《上市公司重大资产重组管理办法》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》，“上市公司发行股份购买资产的，可以同时募集部分配套资金。募集配套资金还可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用；标的资产在建项目建设等。募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金的 50%；并购重组方案构成借壳上市的，比例不超过 30%。上市公司发行股份购买资产同时募集的部分配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格 100%的，一并由并购重组审核委员会予以审核；超过 100%的，一并由发行审核委员会予以审核。”

该次交易同时募集配套资金比例不超过拟购买资产交易价格的 100%，因此一并由并购重组审核委员会审核。其中募集配套资金用于补充公司流动资金的比例不超过募集配套资金的 50%。因此，该次交易符合《重组办法》、《适用意见第 12 号》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的相关规定。

综上所述，公司 2015 年收购星科金朋、2017 年发行股份购买资产交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

七、历次募投项目的业绩实现情况，是否存在未达业绩承诺的情形

（一）历次募集资金投资项目的业绩实现情况

1、历次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 8 月 31 日，公司历次募集资金投资项目的业绩实现情况如下：

(1) 2014 年非公开发行普通股

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-8 月		
1	年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目	100%	预计新增年利润总额 12,828 万元	不适用	不适用	3,849	8,472	12,321	不适用 ^{注 1}
2	收购新加坡星科金朋股权 ^{注 2}	不适用	不适用	不适用	见下表		不适用	不适用	
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：1、“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”承诺效益为原计划募集资金投资 84,080.00 万元对应的效益，由于实际投资时变更了部分募集资金的用途，导致实际实现效益与承诺效益不具可比性；

2、公司收购星科金朋股权时未承诺效益，关于“收购星科金朋股权项目”效益情况请参见下文。

公司于 2014 年变更部分募集资金用于收购星科金朋股权，2015 年以来星科金朋具体效益情况如下：

单位：万美元

项目	2015 年	2016 年	2017 年 1-9 月
营业收入	133,852.8	116,316.1	82,207.3
营业毛利	11,700.2	7,820.1	768.1
净利润	-19,944.7	-8,675.0	-9,242.0
经营活动产生的现金流量净额	38,598.3	22,829.1	6,401.6

注：2015 年及 2016 年财务数据经新加坡安永审计；2017 年 1-9 月财务数据未经审计。

其中，星科金朋于 2015 年由于要约收购、债务重组等事项产生较大的一次性费用，其中要约收购费用（“Tender offer expenses”）为 1,285 万美元，债务发行费用 3,013 万美元，同时因计提最低采购承诺产生支出 8,592 万美元，上述一次性支出合计 12,889 万美元。若扣除该等一次性事项的影响，星科金朋 2015 年调整后净利润为-7,056 万美元。

星科金朋收购后处于整合过渡期，受个别大客户订单大幅下滑、工厂搬迁等因素影响报告期盈利状况尚不理想。随着产品结构调整、工厂搬迁完成、新客户及订单的导入，星科金朋经营业绩已开始明显改善，2017年第四季度已经实现单季度盈利，中长期看具备良好的发展前景和盈利能力。关于公司2014年变更部分募集资金用于收购星科金朋股权的原因、谨慎性与合理性，星科金朋经营改善情况，以及星科金朋中长期盈利能力，请参见本反馈回复本题之“二、2014年度募集资金用途变更比例较高的原因及合理性，公司募集资金决策是否谨慎合理、是否存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形”的说明”。

(2) 2015年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015年	2016年	2017年1-8月		
1	年加工48万片半导体中道封装测试项目	75%	项目达产后年均利润总额预计为6,778万元	不适用	7,083	7,244	14,327	达标
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

(3) 2017年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年	2017年1-8月		
1	eWLB先进封装产能扩张及配套测试服务项目	不适用	项目达产后每年营业收入预计约1亿美元	14,095	8,778	22,873	不适用 ^注
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：该项目仍在建设过程中，尚未完全投产。

2、前次募集资金投资的部分项目无法单独核算效益的原因

前次募集资金中2014年非公开发行投资项目中补充流动资金、2015年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中补充流动资金和2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中偿还银行贷款和补充流动资金与公司整体效益

有关，缓解了公司资金压力，降低了资产负债率，无法单独核算效益。

前次募集资金中 2014 年非公开发行募集资金用于“收购新加坡星科金朋股权项目”系用于收购星科金朋股权，该次股权收购未承诺业绩。

（二）是否存在未达业绩承诺的情形

1、2014 年非公开发行募投项目的业绩承诺达成情况

根据公司《二〇一三年度非公开发行 A 股股票预案》，“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”计划募集资金投资 84,080.00 万元，实施达产后，预计新增年利润总额 12,828 万元，预计投资回收期（税后）约 7.91 年（含建设期 2 年），内部收益率（税后）为 13.59%。

该项目承诺效益（年利润总额 12,828 万元）为原计划募集资金投资 84,080.00 万元对应的效益。由于 2014 年公司变更了该项目部分募集资金用途，该项目实际投资金额为 25,757.98 万元（占原计划募集资金投资 84,080.00 万元的 30.64%），项目于 2016 年建设完成。2017 年 1-8 月该项目实现利润总额 8,472 万元，若进行年化处理则基本接近原计划投资的预计效益，即在实际投入仅占原计划投入的 30.64% 的情况下即基本接近实现预计效益，项目效益良好，不存在未达业绩承诺的情形。

2、2015 年发行股份购买资产募集配套资金投资项目的业绩承诺达成情况

根据 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金交易的重组报告书，“年加工 48 万片半导体中道封装测试项目”达产后预计新增年均利润总额为 6,778 万元，内部收益率为 15.01%（所得税后），项目投资回收期为 5.99 年（所得税后，不含建设期）。

该项目于 2016 年建成投产，2017 年 1-8 月实现利润总额 7,244 万元，超过了预测的年均利润总额 6,778 万元，业绩承诺完成。

3、2017 年发行股份购买资产募集配套资金投资项目的业绩承诺达成情况

根据 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金交易的重组报告书，“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”达产后预计新增年营业收入约 1 亿美

元，毛利率 30%左右，预计税前内部收益率为 10.90%，项目投资回收期为 5.4 年（不含建设期）。

截至目前该项目截至仍在建设过程中，尚未完全投产，效益也尚未充分显现，实际实现效益与承诺效益尚不具可比性。

综上，公司历次募投项目不存在未达业绩承诺的情形。

八、2017 年非公开发行募投项目目前实施进展、预计完工时间，是否存在募投项目进度延缓的情形，是否与相关信息披露文件一致

公司 2017 年非公开发行股份募集配套资金投资项目包括 eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目、偿还银行贷款和补充流动资金。

（一）目前实施进展、预计完工时间

“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”实施主体为星科金朋，项目主要建设内容系将 eWLB 产能由 4,000 片/周扩张至 9,000 片/周，并建设配套测试服务。项目计划总投资 3.04 亿美元，其中使用募集资金投入人民币 13.275 亿元（约 2 亿美元）。

截至目前，eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目的基础设施建设已经基本完成，产能已经建成 8,000 片/周，配套测试服务也在同步建设中。该项目截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金投入人民币 10.98 亿元，约占计划募集资金投资总额的 82.71%。

对于尚未使用完毕的前次募集资金，公司将继续用于该募投项目的建设。项目预计将于 2018 年 9 月建设完成。

该次募集资金中的偿还银行贷款和补充流动资金均已实施完成。

（二）是否存在募投项目进度延缓的情形，是否与相关信息披露文件一致

eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目目前建设进度晚于计划进度，存在建设进度延缓的情形。具体原因如下：

1、星科金朋因债务重组完成后资产负债率较高，资金压力较大，放缓了自筹资金投入该项目的建设进度

公司于 2016 年 4 月召开的第六届董事会第二次会议审议通过了募集配套资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于 eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目、偿还银行贷款和补充上市公司流动资金。之后，星科金朋开始以自筹资金进行项目建设。

由于公司要约收购导致星科金朋控制权发生变更，2015 年 8 月至 2016 年 4 月星科金朋实施了债务重组，主要过程为：根据其原有银行贷款及发行在外债券的相关条款约定发出回购要约，通过星展银行提供的过桥贷款用于原有债务回购，然后通过退出贷款及其他债务融资方式偿还过桥贷款，完成债务替换。

债务重组完成后星科金朋资产负债率较高，资金压力较大，为了控制财务风险，星科金朋放缓了自筹资金投资该项目的进度。

2017 年 6 月，公司募集配套资金到位；在此之前该项目前期投入主要由星科金朋以自筹资金进行投资。截至 2017 年 6 月 30 日，星科金朋以自筹资金预先投入 eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目金额为人民币 84,586.85 万元。

2、客户需求波动

eWLB 是一种典型的扇外型晶圆级封装（FO-WLP）技术，是目前半导体封装行业中最新一代技术之一，其应用市场和客户需求正处于不断发展过程中。2017 年市场变化导致客户需求出现波动，公司分析和评估了市场发展趋势、客户需求变化情况，本着谨慎性的原则，相应地放缓了项目建设进度。

公司已于 2018 年 2 月 1 日披露了《关于前次募集资金投资项目实施进展情况的公告》，对前次募集资金投资项目建设进度情况进行了公开披露。

九、公司控制权变更是否影响公司经营稳定性，是否影响本次募投项目效益的实现

（一）公司控制权变更是否影响公司经营稳定性

1、公司控制权变更情况

经公司第六届董事会第二次会议、2015 年年度股东大会审议通过，并经中

国证监会核准，公司向产业基金发行 129,791,394 股股份收购其持有的长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权，向芯电半导体发行 43,285,527 股股份收购其持有的长电新科 19.61% 股权，同时，公司向芯电半导体发行 150,852,271 股股份募集配套资金。该发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项于 2017 年 6 月实施完成。

上述重组实施完成前，公司控股股东为新潮集团，实际控制人为王新潮先生。

上述重组实施完成后，芯电半导体持有公司 14.28% 的股权，成为公司第一大股东，新潮集团持股 13.99%，产业基金持股 9.54%，三家主要股东的股权比例较为接近，且互相之间不存在一致行动关系或安排。同时，公司 6 名非独立董事中，新潮集团、产业基金及芯电半导体各提名 2 名。因此，新潮集团、产业基金及芯电半导体任何一方均不能单独控制上市公司，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司从有控股股东、实际控制人变更为无控股股东、无实际控制人。

2、公司控制权变更不影响公司经营稳定性

(1) 控制权变更不改变公司的主营业务

公司主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售以及分立器件的芯片设计、制造。控制权变更前后，公司未改变业务或新增业务，不存在从事新业务的情况。控制权发生变更后，公司仍继续专注于集成电路的封装与测试业务，主营业务及发展方向不变。

(2) 控制权变更不改变公司管理层组成

控制权变更后，公司组织架构、治理结构、内控体系、管理制度仍按照长电科技内部治理文件及证券监管部门关于治理结构的规范要求保持不变。公司现任高级管理人员 8 名，分别为王新潮、赖志明、朱正义、罗宏伟、SHIM IL KWON（沈一权）、BEH Sui Lip（马思立）、田镇英、徐良辉，上述高级管理人员均由董事会选举，公司聘任，任期到 2019 年 4 月 20 日。

(3) 控制权变更不会对上市公司治理规范及运行产生不利影响

长电科技自 2003 年上市以来，在公司治理、信息披露、合规方面均保持规范运行。

公司控制权变更后，持股 5% 以上主要股东均有浓厚的合规意识，且无不良记录。自长电科技 2003 年上市以来的 13 年中，新潮集团作为控股股东、王新潮先生作为实际控制人，无不良记录。中芯国际作为香港上市公司，严格遵守公司治理制度，亦无不良记录。产业基金作为国家级行业基金，合规意识浓厚。

从上市公司和主要股东的良好记录，以及主要股东相互协商的机制来看，控制权变更后，公司治理、信息披露、合规运营等方面不会产生变化；主要股东也会承担起各自的股东义务和被监管义务。

在上述重组中，产业基金、芯电半导体分别出具《保持上市公司独立性承诺》：“在本次交易完成后，将继续保持长电科技的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循独立原则，遵守中国证监会有关规定，不利用长电科技违规提供担保，不占用长电科技资金。”

自 2017 年 6 月公司控制权变更以来，公司经营情况保持稳定，没有发生重大不利变化。

因此，虽然公司控制权发生变更，但上市公司主营业务不发生改变，管理层稳定，公司治理规范，经营情况稳定，公司控制权变更不会影响公司经营的稳定性。

（二）公司控制权变更是否影响本次募投项目效益的实现

公司控制权变更不改变公司主营业务、公司管理层组成，且不会对上市公司治理规范及运营产生不利影响，公司经营具有稳定性。

本次募投项目投资方案已经公司董事会、股东大会审议通过，已取得公司目前主要股东以及中小投资者的认可。本次募投项目实施主体具有独立性。“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”由公司下属集成电路事业中心负责实施，“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”由公司全资子公司长电先进负责实施，两个项目实施主体均有专门的经营管理团队负责日常管理，公司控制权的变更不会影响上述募投项目的实施。

本次募投项目均为国家规划发展的重点方向，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）之鼓励类行业：“信息产业：集成电路设计，线宽 0.8 微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）等先进封装与测试”，本次募投项目列在鼓励投资产业目录内，是国家鼓励类产业。本次募投项目实施主体经营管理团队稳定，且具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相应储备。本次募投项目效益的实现有有效的保障。

因此，公司控制权变更不会影响本次募投项目效益的实现。

十、前次募投项目与本次募投项目的联系与区别，前募项目未实施完毕的情况下进行本次募投项目的必要性及合理性分析

（一）前次募投项目与本次募投项目的联系与区别

1、概述

（1）前次募投项目基本情况

①2014 年公司非公开发行股份募集资金，募集资金净额为 118,633.26 万元，其中计划投资 84,080.00 万元用于“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”。经 2015 年 2 月 12 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司变更了募投项目“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”中的 5.9 亿元募集资金用于收购星科金朋股权。

②2015 年公司发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金用于长电先进“年加工 48 万片半导体芯片中道封装测试项目”和补充上市公司流动资金，其中 164,389,140 元用于“年加工 48 万片半导体芯片中道封装测试项目”，本项目主要是在新厂房内建立新型生产线，同时扩大产能，项目建成后可达年加工 48 万片半导体芯片中道封装生产能力。

③2017 年公司发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金用于“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”，该项目建设主要是将星科金朋 eWLB 先进封装项目产能由 4000 片/周扩张至 9,000 片/周，并建设配套测试服务项目，项目建成后星科金朋将具备 9,000 片/周的 eWLB 先进封装及配套测试

的一站式服务能力。

(2) 本次募投项目基本情况

公司本次募投项目为“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”和“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”，前者建成后将形成封装 FBGA、PBGA、SIP 模组、P-SIP 模组、通讯模块-LGA、高脚位通讯模块、倒装通讯模块等通信用高密度集成电路及模块封装产品年产 20 亿块的生产能力；后者建成后将形成 Bumping、WLCSP 等通讯与物联网集成电路中道封装年产 82 万片次 Bumping、47 亿颗芯片封装的生产能力。

2、前次募投项目与本次募投项目的联系与区别

由上可见，本次与前次募投项目均属于公司集成电路封装测试业务范畴，围绕公司主营业务展开，在现有业务优势的基础上进行项目建设以实现产能扩充，与现有业务紧密相连。

本次募投项目之“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”与 2015 年公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目之“年加工 48 万片半导体中道封装测试项目”均由长电先进实施，采用相似的工艺技术，但是产品规格和应用领域上存在差异；此外，本次募投项目之“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”中“倒装通讯模块”部分与 2014 年公司非公开发行股份募集资金募投项目之“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”在工艺技术、生产设备、产品应用领域等方面存在相似之处，但本次募投项目封装产品更为丰富。其他各募投项目在工艺技术、应用领域和生产设备等方面与本次募投项目存在较大的区别。具体对比情况如下：

项目	前次募投项目			本次募投项目	
	年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目	年加工 48 万片半导体中道封装测试项目	eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目	年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目
实施主体	长电科技本部	长电先进	星科金朋	长电科技本部	长电先进
产品应用领域	智能手机、电源模块	消费电子	无人驾驶、智能手机、健康检测、5G 通讯等	智能手机、无线通讯模组、电源模块、智能电视等	通讯（消费电子、汽车电子）、物联网

项目	前次募投项目			本次募投项目	
	年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目	年加工 48 万片半导体中道封装测试项目	eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目	年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目	通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目
生产工艺技术	FCBGA、Flip Chip on L/F 和 FCLGA	Bumping、WLCSP	eWLB	FBGA、PBGA、SIP、LGA、Flip Chip on L/F 等	Bumping、WLCSP
技术先进度	中高端	中高端	半导体封装行业中最前沿技术之一，未来半导体封装行业的发展方向之一	中高端	中高端
主要生产设备	磨划倒装机、包封测试机、切割机、分选机等	晶圆电镀机、等离子清洗机、检测机、晶圆溅射机等	Sabre 3D System、UltraFlex HD System、JetStep Stepper、Laser Saw 等	磨划打线机、倒装机、SMT、包封测试机、切割机、分选机等	激光切割设备、晶圆溅射机、晶圆磨片机、真空贴膜压膜设备、晶圆电镀机等

根据总体发展战略，公司已经在中国江阴、滁州、宿迁及新加坡、韩国等地设立了 7 个不同特色的生产基地，构建各自细分行业竞争优势。其中星科金朋新加坡厂定位于 eWLB 扇外型晶圆级封装（Fan-out WLP）的研发和生产基地；长电先进聚焦 Bumping 和 WLCSP；公司本部定位于高阶 Wirebond+SIP 模块+FC/QFN/RF/COL。各次募投项目的实施主体在公司战略布局中的定位差异体现了该募投项目的产品存在的差异。“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”定位于高端客户与行业最前沿技术，其他募投项目均定位于行业主流技术与应用市场。各次募投项目涵盖了公司高中端产品线，系巩固和提升公司战略布局的重要举措，进一步凸显公司产能布局优势。

（二）前募项目未实施完毕的情况下进行本次募投项目的必要性及合理性

1、前次募投项目资金使用进度及对本次募投项目的影响

截至 2017 年 8 月 31 日，公司前次募投项目中仅 2017 年发行股份购买资产配套募集资金投资项目“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”尚未实施完毕，其他募投项目均已实施完毕。该项目截至 2017 年 12 月 31 日已使用募集资金投入人民币约 10.98 亿元，占该项目计划募集资金投资总额的 82.71%。

前次未实施完毕募投项目“eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目”由星科金朋独立实施，本次募投项目“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模

块封装项目”、“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”分别由长电科技、长电先进独立实施，前次未实施完毕募投项目与本次募投项目分别在不同的工厂予以建设、生产，分属不同的实施主体，均能够独立地进行会计核算，故本次募投项目的实施并不受前次募投项目实施进度的影响。

2、本次募投项目的必要性

(1) 我国集成电路行业快速发展

我国是半导体终端需求的主要市场之一，在《国家集成电路产业发展推进纲要》进一步落实和国家集成电路产业投资基金的推动下，我国半导体市场销售收入增长速度远高于全球增速，保持着快速发展。根据中国半导体行业协会统计，自 2009 年以来我国集成电路市场保持高速的增长，至 2016 年，我国集成电路市场销售规模从 1,109 亿元增长至 4,335.5 亿元，期间的年均复合增长率达到 21.50%。通信和消费电子是我国集成电路最主要的应用市场。

从产业链结构看，2016 年我国集成电路产业链各环节均呈现增长态势。其中，设计业继续保持高速增长，销售额为 1,644.3 亿元，同比增长 24.1%；制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动，2016 年依然快速增长，同比增长 25.1%，销售额 1,126.9 亿元；封装测试业销售额 1,564.3 亿元，同比增长 13%。2017 年 1-6 月，我国集成电路产业销售额为 2,201.3 亿元，同比增长 19.1%。其中，设计业同比增长 21.1%，销售额为 830.1 亿元；制造业增速达到 25.6%，销售额为 571.2 亿元；封装测试业销售额 800.1 亿元，同比增长 13.2%（数据来源：中国半导体行业协会）。IC 设计业的快速发展带动了国内芯片代工与封装测试需求快速增长。

(2) 国家产业政策大力支持

集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，国家大力支持集成电路行业发展，并制定了一系列行业支持政策，本次募集资金投资项目属国家政策大力支持的产业领域，具体情况如下：

国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》提出：“提升先进封装测

试业发展水平。大力推动国内封装测试企业兼并重组，提高产业集中度。适应集成电路设计与制造工艺节点的演进升级需求，开展芯片级封装（CSP）、圆片级封装（WLP）、硅通孔（TSV）、三维封装等先进封装和测试技术的开发及产业化。”国务院印发的《中国制造 2025》提出：“掌握高密度封装及三维（3D）微组装技术，提升封装产业和测试的自主发展能力。”《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：“大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点”。

（3）本次募投项目封测产品应用于行业主流市场，市场前景广阔

集成电路封装测试行业系集成电路支柱产业之一，也是集成电路行业中规模最大的子行业之一，我国集成电路行业中封装测试行业对于产业市场的贡献一直较高，占比稳定在 40% 以上。2010 年以来，我国集成电路封装测试行业每年的增长率均高于 6%，2014 年以来每年增长率更是超过 10%。根据中国半导体行业协会统计，从 2012 年起，我国集成电路封装测试行业营业收入已超过 1,000 亿元，到 2016 年，已经达到 1,564.3 亿元。

根据目前全球封装行业的发展趋势，以 eWLB 为代表的 FO-WLP 技术正成为未来半导体封装行业的主流发展方向之一，是目前封装行业最顶尖的技术之一，市场前景广阔。公司投入 eWLB 的建设，扩充产能以满足高端市场需求，以期在高端芯片封装市场上占得先机，符合公司建设成为全球领先的集成电路封测企业的总体战略方针。但与此同时，以 WLCSP、Bumping、FBGA、PBGA 等封装技术为代表的主流市场仍然是公司营收与利润的保障，2016 年，公司除 eWLB 外的集成电路封装业务收入占公司营业收入比例为 80.33%，上述业务同时也贡献了公司大部分盈利。半导体行业的整体发展带动了封装行业的持续增长，主流市场规模也随之不断扩大，长电科技本部与长电先进的产能得到释放，这要求公司保持对主流产品的持续投入与供给。

高密度集成电路封装具有良好的电和热性能、体积小、重量轻，其应用正在快速增长。主要的封装形式包括 FC/QFN、球状栅格阵列封装（BGA）、LGA 等，是集成电路封装行业成熟的主流技术，市场需求量广泛。

与传统封装不同，先进封装要求在晶圆划片前融入封装工艺步骤，包括晶圆

研磨薄化、重布线、凸点制作及 3D-TSV 等制程，晶圆制造与封测前后道制程出现中道交叉区域，使得晶圆厂的技术布局逐渐向封测技术延伸，由此衍生出中道封装技术。上述技术区别与传统打线技术，使得晶圆制造及封装测试结合更加紧密，从而满足芯片小型化和多功能化的发展趋势，中道封装技术已应用在手机等通讯器材行业龙头的核心芯片中，并成为封装测试龙头企业下一步投资布局的重点领域。

本次募投项目产品主要应用于智能手机、平板电脑、TV、智能电视、云计算、汽车电子等行业主流市场。4G 智能手机的普及、物联网产业快速发展及银行卡“换芯潮”，将为集成电路封装测试市场提供广阔前景。

（4）本次募投项目将进一步提升公司中高端集成电路封测技术生产能力

公司作为国内集成电路封装测试行业龙头，收购新加坡星科金朋后，公司获得了全球同行业领先的先进封测技术和高端客户资源，并跻身全球集成电路封装测试行业第一阵营。本次募投项目将主要用于发展通信用高密度集成电路及模块封装业务和中道封装业务，夯实主流产品供给能力，为进一步提升公司中高端集成电路封测技术生产能力打下重要基础。

根据集成电路封测行业技术发展路径，高密度集成电路及模块封装、晶圆级封装等现有主流封装技术已进入成熟期，正扩大规模生产，进一步提高效率、降低成本，并逐渐提升技术水平，向 SiP、3D 封装等系统级封装发展，以适应工业自动化、物联网、智能机器人等新兴产业发展进程。高密度集成电路封装具有良好的电和热性能、体积小、重量轻，开发成本低，其应用正在快速增长；公司全资子公司长电先进开创了多个国内封测行业的第一，其中道封装从技术到产能已具有较强的国际竞争能力，中道封装产品已应用在国际前十大手机厂商的产品中，市场客户端需求旺盛，产能利用率较高，通过募投项目提产扩能，满足客户需求。

3、本次募投项目的合理性

（1）“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”合理性

①先进封装技术积累提供有力的技术支撑

经过多年的持续研发与技术沉淀，公司形成了深厚的先进封装技术积累，为本项目的顺利实施提供有力的技术支撑。公司拥有行业领先的高端封装技术能力（如 Fan-out eWLB、WLCSP、SiP、BUMP、PoP 等），能够为国际顶级客户和高端客户提供领先的封装服务。截至 2017 年 9 月 30 日，公司及子公司共获得有效发明专利 2,681 件，其中在美国获得的发明专利为 1,740 件，基本覆盖中高端封测领域；公司拥有国家级企业技术中心、江苏省集成电路封装测试工程技术研究中心。

在高密度封装方面，公司拥有国内唯一的高密度集成电路封装技术国家工程实验室，拥有 FBGA、PBGA 封装技术，高密度集成 P-SiP IC 模块封装技术，高脚位 QFN 封装，高密度 FC-BGA 封测技术等多项高密度集成电路及模块封装技术，能充分满足本项目的技术需求。

②先进生产经验提供产品品质保证

公司的高端集成电路封装测试生产能力国内领先，具备丰富的高端集成电路封装测试量产经验，为本项目成功达产奠定坚实基础。公司本部近两年来已配合数十家国内外知名设计公司完成了基带模块、射频模块、MEMS 信号模块等上千款系统级封装产品的设计、研发、量产，其中 FBGA 封测能力已达国际领先水平。公司近年来基础管理进一步得到加强，连续三年获得江苏省质量管理优秀奖。公司在高端集成电路封装测试的生产能力、经验，将能确保本项目产品的顺利生产。

③优质客户资源确保产品销售市场

现有优质客户资源将为本次募集资金投资项目的顺利实施打下扎实的市场基础。在长期经营发展过程中，公司凭借先进成熟的生产技术、良好产品品质及优质的客户服务积累了大量优质客户资源。目前，多家国内外著名 IC 设计厂商与公司保持着良好密切的合作关系，公司在收购星科金朋后交叉销售效果已经逐步显现。优质客户资源的长期积累确保了产品销售市场的稳定增长。

(2) “通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”合理性

①本项目系现有技术、产能的扩充，将进一步增加中道封装产能，增强市场

竞争力

长电先进在其成立（2003 年）伊始即展开了中道封装相关技术的研发与产业化，开创了多个国内封测行业的领先技术，是国家级高新技术企业，拥有成熟的晶圆凸块（Bumping）、晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）等国际领先的圆片级封装技术，其中 WLCSP 产能规模已领先全球；Bumping 产能也进入全球前五，2016 年全年 Bumping 出货量达 136 万片次。

目前长电先进中道封装从技术到产能已具有较强的国际竞争能力，市场客户端需求旺盛，产能利用率高。本项目系长电先进对现有技术、产能的扩充，项目建成并完成达产后，将进一步增加长电先进中道封装产能，增强国际竞争力。

②丰富的中道封装研发、生产、管理经验确保产品顺利生产

长电先进在集成电路中道封装领域多年研发、生产和多次技术改造中积累了丰富的中道封装研发、生产、管理经验，培养了技术水平成熟、经验丰富的研发、生产、管理团队，为本项目成功达产奠定了坚实基础。长电先进拥有先进的工艺生产流程、成熟的中道封装测试生产能力，和丰富的中道封装研发、生产、管理经验将能确保本项目产品的顺利生产。

③丰富的客户资源确保产品销售市场

长电先进产品已规模化、市场国际化，产品 90% 以上出口，全球前十大模拟 IC 供应商几乎均是长电先进客户。长电先进的封装产品已获得欧洲、北美等地区国际一流公司的认可，半导体凸块产品已应用在国际 TOP10 手机厂商的产品中，长电先进与国际大客户保持着良好密切的合作关系。丰富的客户资源为本项目的顺利实施打下扎实的市场基础，确保了产品销售市场。

综上，本次募投项目投产后，公司的产品结构将得到优化，公司的市场地位及核心竞争力将得到进一步提升，将增强公司的整体盈利能力，公司在前募项目未实施完毕的情况下进行本次募投项目具备必要性、合理性。

十一、保荐机构的核查意见

保荐机构核查了收购星科金朋的相关协议、决议及文件，查阅了相关各次交易的方案、决议、协议、审计报告、评估报告及发行人定期报告、历次募投项目

可行性分析报告等文件，并与发行人相关人员进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：

1、2014 年度收购星科金朋资产运行状况良好，未曾披露盈利预测或业绩承诺。该次收购星科金朋定价公允合理。

2、发行人募集资金决策谨慎合理，不存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形。

3、2015 年度收购长电先进少数股权资产运行情况良好，2015 年和 2015-2016 年累计均达到了业绩承诺。

4、发行人 2017 年收购星科金朋少数股权既是发行人履行与产业基金、芯电半导体在 2014 年底共同投资收购星科金朋时签署的相关协议的约定，也是发行人在收购后进一步深度整合星科金朋的客观需要，具有合理性。该次资产收购定价公允合理，不存在其他利益安排。

5、发行人分多次收购星科金朋系处于市场机制及商业惯例做出的安排，存在一揽子协议，不存在其他利益安排。上述资产购买不构成借壳上市，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

6、发行人历次募投项目不存在未达业绩承诺的情形。

7、2017 年非公开发行募投项目存在进度延缓情形，主要系星科金朋前期投入时自筹资金压力及客户需求波动两方面原因所致，发行人已进行了信息披露。

8、发行人控制权变更不影响经营的稳定性，不影响本次募投项目效益的实现。

9、前次募投项目与本次募投项目均围绕发行人主业展开，但在工艺技术、生产设备、产品应用等领域存在一定差别。前募项目未实施完毕的情况下进行本次募投项目具有必要性与合理性。

重点问题九

9、申请人最近一期末商誉金额为 26.03 亿元，系收购新加坡星科金朋产生。请申请人结合星科金朋持续亏损的情况，说明公司是否能够对子公司进行有效整合，公司商誉减值测试是否有效，减值准备计提是否充分合理。

请申请人会计师补充说明公司商誉确认及减值测试是否符合企业会计准则要求，减值测试是否有效；标的资产的公允价值较账面值的增值部分，是否直接归集到对应的具体资产项目。

请保荐机构发表核查意见。

回复：

一、关于公司是否能够对子公司星科金朋进行有效整合的说明

（一）星科金朋亏损情况

集成电路封装测试行业属于资金密集型、技术密集型行业，特别是先进封装技术，对应的机器设备等固定资产账面价值较高。星科金朋最近三年一期固定资产占总资产比例均超过 50%，与之相应的，其机器设备折旧费用、厂房和设备租赁费用等固定成本占主营业务成本的比例也较大。要约收购前的 2014 年星科金朋即处于盈亏平衡附近，2015 年特别是 2015 年第三季度开始，订单量及营业收入的下降直接导致毛利大幅下滑，再加上财务费用较高，导致星科金朋出现持续亏损。

其中订单量及营业收入下降的主要原因包括个别大客户订单大幅下滑、工厂搬迁等因素，具体如下：

1、第一大客户的订单量下降

2015 年第三季度开始，星科金朋原第一大客户订单量大幅下滑，其下滑原因主要包括两方面：一是因为该客户的上游客户需求有所下降；二是星科金朋韩国厂 SCK 于 2014-2015 年上半年搬迁、上海厂 SCC 于 2015 年下半年确定计划搬迁，导致该客户转单，2014 年至 2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月，星科金朋从该客户取得的销售收入绝对金额大幅下降，其销售收入占星科金朋营业收入比重也由 25.87% 下降至 18.74%、17.13% 和 15.89%，其中韩国厂 SCK 订单受影响最大。

2、韩国厂 SCK、上海厂 SCC 先后搬迁

(1) SCK 搬迁原因

由于原厂房承租协议到期，厂房被收回，SCK 于 2014-2015 年上半年进行搬迁，SCK 搬迁后目前主要生产地位于韩国仁川，主要在位于韩国仁川的 3 幅土地上开展。

(2) SCC 搬迁原因

由于上海市青浦区城市建设总体规划和上海市政府关于西虹桥地区整体开发建设需要等原因，上海市青浦区土地储备中心整体征收了星科金朋上海工厂 SCC 位于上海市青浦区徐泾镇华徐公路 188 号的国有出让土地。

2014 年 12 月和 2015 年 1 月，SCC 分别与上海市青浦区土地储备中心及上海青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室、上海青浦区徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室签署了搬迁相关协议。根据协议约定，SCC 需于 2017 年第三季度底之前搬迁。

(3) 搬迁造成的影响

工厂搬迁一方面导致搬迁过程中客户订单中断，出现客户转单；另一方面新工厂需完成客户产品导入、认证、测试等过程后方可逐步恢复生产；并且，搬迁过程中工厂两地运营、新工厂的新员工培训等也导致成本费用大幅增加。

针对上述情况，公司在对星科金朋实施全面整合的同时，采取了针对性措施改善其订单量及收入状况，该等影响因素正逐渐消除：

1、新加坡厂 SCS 抓住晶圆级扇外型封装 eWLB 的全球技术领先优势，扩产上量，原第一大客户订单量通过 eWLB 项目部分回升，同时 eWLB 项目正导入客户新产品，提升产量，提升盈利能力。

2、韩国厂 SCK 搬迁完成后的主要生产活动在位于韩国仁川的 3 幅土地上开展，其中 1 幅 (37,946 m²) 土地所有权归 SCK 所有，持有期限为永久，另外 2 幅 (100,117 m² 和 127,010 m²) 均为向 Incheon International Airport Corporation 长期租赁，租赁到期时间分别为 2063 年 5 月和 2045 年 8 月，租赁

期限长，韩国厂 SCK 在可预见的未来能够保持稳定生产经营。同时，韩国厂 SCK 搬迁完成后积极营销原有大客户新产品导入，同时加大了本地客户的开发和导入，通过倒装（FC）相关业务订单逐步恢复。

3、上海厂 SCC 于 2015 年下半年-2017 年 9 月搬迁，目前 SCC 搬迁已经完成。JSCC 所用厂房为向公司租赁，双方已签署租赁合同，租赁期限 20 年，同时公司拥有该厂房所在地的国有土地使用证，因此未来 JSCC 的生产经营也能够保持稳定。江阴新厂 JSCC 客户订单恢复良好，新客户导入顺利，特别是倒装（FC）相关业务订单饱满。JSCC 正加快对新员工的培训，加紧产能爬坡，提升生产效率，应对正在恢复和新增的客户订单。

由于客户新产品认证、试样到导入需要一定时间，成功导入到订单量明显提升也需要一定过程，星科金朋订单量及收入状况逐渐在改善，2017 年第四季度以来改善情况明显。

2017 年第四季度，星科金朋实现营业收入约 3.39 亿美元，较第三季度上升 13.20%；综合毛利率上升至 8.58%，星科金朋于 2017 年第四季度实现了单季度盈利。同时，原有大客户订单量企稳，产品结构逐步优化；收购后新增客户及产品订单量贡献明显提升。

关于星科金朋 2017 年第四季度业绩改善的具体情况，请参见本反馈回复之“重点问题八”之“二、2014 年度募集资金用途变更比例较高的原因及合理性，公司募集资金决策是否谨慎合理、是否存在以募投项目名义变相用于资产收购的情形的说明”之“（二）公司募集资金决策是否谨慎合理”之“2、2014 年募集资金用途变更具有谨慎性、合理性”之“（2）募集资金变更后用于收购星科金朋用途谨慎、合理，标的资产中长期具备盈利性”之“②星科金朋 2017 年第四季度经营状况已明显改善”。

（二）公司对星科金朋整合情况

2015 年下半年收购完成后，公司在保持星科金朋资产、业务及人员相对独立和稳定的基础上，对其管理、销售、采购、人力资源等方面进行了全面整合。其中主要整合工作如下：

1、改变经营机制

公司保持了星科金朋各重要子公司资产及机构独立运营的模式，通过派出董事、高级管理人员等方式，履行母公司对子公司的管理职能，并且将各经营实体（BU）SCK、SCS、JSCC 从单纯生产基地转变成为权责利相结合的利润中心，由公司总部制定绩效考核指标（KPI），各 BU 总经理对经营绩效负责，并赋予与责任对等的决策权。

2、交叉销售，导入中国重点客户

长电科技与星科金朋客户重叠度小，互补性高，通过交叉销售可以拓展国内外市场，形成客户资源共享、销售收入增长的协同效应。星科金朋在先进封装技术方面处于全球领先地位，但在中国市场的业务占比较低，长电科技利用在中国市场的影响力和优势地位帮助星科金朋拓展中国市场。各 BU 在具体交叉销售执行过程中互补互助，并由长电科技总部进行协调、支持。

3、投资重大项目

星科金朋具备 eWLB、SiP 等全球领先的封测技术，并已完成产业化前期开发，收购完成后公司经论证认为该两项技术为国际半导体领域前沿封装技术，分别为其筹措资金进行投资，并设立了重点项目专项管理，为星科金朋及长电科技培育了新的利润增长点。

4、调整战略布局，构建各 BU 细分行业竞争优势

根据公司总体发展战略，对星科金朋下属三个利润中心进行了产品发展规划和战略定位。通过设备调配、资源整合、业务划分，形成不同产品类型、各具竞争优势、相互配套协同的战略布局。

其中韩国厂 SCK 定位于以 FCCSP+POP+SiP 为主；新加坡厂 SCS 定位于全球领先的 eWLB 扇外型晶圆级封装（Fan-Out WLP）的研发和生产基地；江阴厂 JSCC 将与同位于江阴城东厂区的长电先进的芯片凸块 Bumping 配套，形成一站式 FC 服务产业链，并保留高端焊线 Wirebond 产品特色。

5、通过直接融资，降低星科金朋资产负债率和财务费用

星科金朋被长电科技要约收购后进行了债务重组，资产负债率较高，财务费用较大，且已经从新加坡交易所退市，直接融资渠道不畅。公司将利用国内融资平台，加强直接融资，降低星科金朋资产负债率和财务费用。同时，产业基金、芯电半导体（最终股东为中芯国际）已经成为公司主要股东，将支持优化星科金朋财务状况。

截至目前，上述整合措施已经取得的主要效果如下：

1、建立了国际化的管理团队

公司围绕收购星科金朋之后的跨国业务布局，打造了国际化、专业化的管理团队。目前公司管理层中总裁兼星科金朋 CEO 赖志明（中国台湾籍）、首席技术长兼星科金朋首席技术长 SHIM IL KWON（沈一权，韩国籍）、首席财务长兼星科金朋联席 CFO 马思立（马来西亚籍）、首席法务长兼星科金朋法务长徐良辉（中国台湾籍）均具有丰富的跨国企业工作、管理经验。目前星科金朋管理层包括赖志明任 CEO，马思立、Woo Kwek Kiong 任联席 CFO、徐良辉任法务长、Hal Lasky 任执行副总裁兼销售总监、SHIM IL KWON 任首席技术官、Kim Won Gyou 任高级副总裁兼 SCK 总经理、Soh Lip Leong 高级副总裁兼 JSCC 总经理、Cindy Palar 任高级副总裁兼 SCS 总经理。

上述管理人员的安排一方面保持了星科金朋经营管理的独立性，另一方面加强了长电科技总部各业务条线对星科金朋对应业务的监督、管理。

2、经营机制得到有效改善

目前星科金朋三个工厂均已形成独立的利润中心，具备相对独立的技术研发、生产、采购、销售、售后服务等经营自主权，以满足国际、国内各层级客户业务需求。同时，通过在工厂实施阿米巴管理模式，公司重新梳理了总部和各个子公司管理制度和管理流程，完善内控体系并控制成本。在销售层面，将各子公司产品线的销售业绩与个人激励挂钩，提高员工积极性，进而刺激销售业绩提升。

3、产品结构不断调整

星科金朋业务主要集中于手机等通信业务，目前已经引入了包括存储器、汽

车电子、区块链等非通信业务，非通信业务占比提升，产品结构不断调整优化。

4、SCC 工厂搬迁完成，客户订单逐渐恢复

2017 年 9 月底，SCC 已搬迁至江阴新厂 JSCC 并停止运营，JSCC 已经正常运营，客户订单恢复良好，特别是倒装（FC）业务订单饱满，JSCC 目前正加快对新员工的培训，加紧产能爬坡，提升生产效率，应对正在恢复和新增的客户订单，截至 2017 年第四季度，JSCC 营业收入大幅增长：

单位：万美元

项目	2017 年 第四季度	2017 年 第三季度	2017 年 第二季度	2017 年 第一季度
JSCC 营业收入	9,462.16	4,939.71	1,701.31	580.89

同时，相较搬迁前收入水平，2017 年第四季度，JSCC 单季度营业收入较 2016 年第四季度 JSCC 与 SCC 合并营业收入增长 35.60%。由于工厂搬迁带来的影响正逐步消除。

5、加强文化融合，形成公司凝聚力

收购星科金朋后，公司始终倡导“同一个企业、同一个团队、同一个梦想”的企业文化，弘扬和睦卓越的大家庭式企业文化，持续推进和谐文化和执行力文化。目前，公司围绕长电科技集团的凝聚力已经形成，企业文化、价值观和发展目标得到认同。

6、通过直接融资帮助星科金朋偿还了部分债务

2017 年公司利用直接融资偿还了 1.2 亿美元并购贷款，并帮助星科金朋偿还了 7,500 万美元优先票据。

综上，公司已经建立了国际化的管理团队，对星科金朋的整合措施已有效实施，星科金朋经营业绩已开始明显改善并于 2017 年第四季度实现单季度盈利，体现了良好的整合效果。公司具备对子公司星科金朋进行有效整合的能力。

二、关于公司商誉减值测试是否有效，减值准备计提是否充分合理的说明

公司的商誉为 2015 年 8 月 5 日（购买日）收购星科金朋 100% 股权产生，公司聘请了第三方评估机构新加坡 Duff & Phelps Corporation 对收购标的星科金朋

购买日可辨认净资产公允价值进行了评估，依照企业会计准则对星科金朋各项可辨认资产、负债及或有负债均逐项单独予以确认，购买日各项可辨认资产公允价值较账面值的增值部分直接归集到对应的具体资产项目。新加坡 Duff & Phelps Corporation 作为全球领先的评估与公司财务顾问，主要向客户提供评估、交易咨询、财务重组等领域的专业服务。

在公司编制 2015 年度合并财务报表时，由于对上述收购交易相关可辨认资产及负债的评估工作尚未完全完成，合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值只能暂时确定。公司依据《企业会计准则第 20 号—企业合并》，对合并中取得的星科金朋的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以所确定的暂时价值为基础进行确认和记录，将自购买日（2015 年 8 月 5 日）算起 12 个月内对可辨认资产、负债及或有负债的暂时性价值进行调整。截至 2015 年 12 月 31 日，星科金朋可辨认净资产于购买日的暂定公允价值为 36,613.31 万美元（折合人民币 224,022.21 万元），与实际支付的投资成本 74,520.49 万美元（折合人民币 455,961.10 万元）之间差额 37,907.18 万美元（折合人民币 231,938.88 万元）为购买产生的暂定商誉。

公司在编制 2016 年度合并财务报表时，已完成了对上述收购交易相关可辨认资产及负债的评估工作，依照《企业会计准则第 20 号—企业合并》对合并中取得的星科金朋的各项可辨认资产、负债及或有负债按评估工作完成后确定的公允价值进行确认和记录，并相应对上述可辨认资产、负债及或有负债的暂时性价值进行了调整。调整后，截至 2016 年 12 月 31 日，星科金朋可辨认净资产于购买日的公允价值为 36,097.02 万美元（折合人民币 220,863.20 万元），与公司实际支付的投资成本 74,520.49 万美元（折合人民币 455,961.10 万元）之间差额确认为购买产生的商誉 38,423.48 万美元（折合人民币 235,097.90 万元）。

综上，于购买日，星科金朋各项可辨认资产、负债的公允价值与账面价值如下：

单位：人民币万元

星科金朋可辨认资产、负债	2015 年 8 月 5 日 公允价值	2015 年 8 月 5 日 账面价值
货币资金	60,742.47	60,742.47
持有待售资产	12,195.97	8,382.84

星科金朋可辨认资产、负债	2015年8月5日 公允价值	2015年8月5日 账面价值
固定资产	836,182.35	797,032.35
无形资产-专利权	39,281.41	20,494.72
其他可辨认资产	214,152.13	214,152.13
短期借款	45,744.62	45,744.62
衍生金融负债	52,619.96	52,619.96
一年内到期的非流动负债	496,311.46	496,311.46
长期借款	109,424.20	109,424.20
递延所得税负债	17,436.76	6,638.73
其他可辨认负债	220,154.14	220,154.14
合计	220,863.20	169,911.41
收购产生的商誉	235,097.90	
收购对价	455,961.10	

根据企业会计准则规定，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

资产组的可收回金额是根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司在5年的时间范围内对资产剩余使用寿命内整个经济状况进行最佳估计，根据公司批准的财务预算为基础，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额确定资产预计未来现金流量的现值。

在对上述商誉于2016年12月31日进行减值测试时，公司聘请了中联资产评估集团有限公司进行减值测试，星科金朋资产组的可收回金额是以管理层批准的财务预算预测的未来现金流量的现值所确定。公司认为该等财务预算及未来现金流量系公司管理层于2016年12月31日之最佳估计，考虑了该资产负债表日资产组历史财务数据、行业发展状况和资产组未来业务发展趋势。公司管理层对资产组2016年12月31日未来五年（自2017至2021年）的营业收入、各类成本、费用等进行了预测，自第六年后各年的收益假定保持与第五年（即2021年）

相同，具体预测数据如下：

单位：千美元

项目/年度	2017年E	2018年E	2019年E	2020年E	2021年E	2022年及以后E
收入	1,403,000.00	1,551,805.62	1,681,151.88	1,743,753.22	1,791,366.14	1,791,366.14
成本	1,233,651.86	1,331,055.90	1,418,140.28	1,449,433.45	1,472,588.51	1,472,588.51
营业税金及附加	261.39	289.12	313.21	324.88	333.75	333.75
营业费用	26,721.30	27,255.73	27,800.84	28,356.86	28,924.00	28,924.00
管理费用	72,102.59	73,544.64	75,015.53	76,515.84	78,046.16	78,046.16
财务费用	71,425.69	70,977.63	70,981.95	70,977.08	70,977.08	70,977.08
营业利润	-1,162.83	48,682.61	88,900.06	118,145.11	140,496.65	140,496.65
加：营业外收入	18,564.56	14,200.63	14,200.63	14,000.00	14,000.00	14,000.00
减：营业外支出	-	-	-	-	-	-
利润总额	17,401.73	62,883.24	103,100.68	132,145.11	154,496.65	154,496.65
固定资产折旧	231,663.61	241,124.43	251,026.22	262,041.65	273,424.60	273,424.60
摊销	25,237.66	25,237.66	25,237.66	25,237.66	25,237.66	25,237.66
扣税后利息	71,425.69	70,977.63	70,981.95	70,977.08	70,977.08	70,977.08
资产更新	-	-	-	-	-	200,770.57
营运资本增加额	1,352.77	12,061.20	10,066.20	5,949.06	4,408.66	-
资本性支出	251,957.97	134,381.36	156,344.04	173,927.96	179,730.80	-
净现金流量	92,417.95	253,780.39	283,936.27	310,524.49	339,996.53	323,365.42
现金流量折现值	86,685.11	209,422.16	206,139.78	198,341.30	191,059.30	1,329,853.08
合计	2,221,500.73					

经测试，星科金朋资产组于2016年12月31日预计未来现金流量的现值为222,150万美元，包含商誉的资产组账面价值为179,584万美元（其中资产组账面价值141,161万美元，商誉账面价值38,423万美元），资产组预计未来现金流量现值高于包含商誉的资产组账面价值，因而无需计提减值准备。

商誉系一种长期资产，而长电科技收购星科金朋系依据公司高端化、国际化的长期发展战略所作出的长期性、战略性决策，也响应了国家《中国制造2025》中所提到的“提升封装产业和测试的自主发展能力”的政策导向。该次收购加速提升了公司行业地位及国际影响力，大幅提升了公司先进封装技术水平，使公司直接进入国际知名客户供应链及封测行业第一阵营。星科金朋作为全球封

测行业第一梯队企业，其领先封装技术、高端客户资源、国际化经营管理、信息化管理系统等竞争优势依然突出，2017年第四季度经营状况已明显改善，公司对星科金朋的整合已初见成效，其具备良好的发展前景和盈利能力，从中长期看能够有利于公司整体竞争力和影响力的提升。

综上，公司管理层认为公司于2016年12月31日对商誉的减值测试是有效的，未计提减值准备。截至本反馈回复出具日，公司对2017年12月31日的商誉减值测试工作仍在进行中。

三、会计师关于公司商誉确认及减值测试是否符合企业会计准则要求，减值测试是否有效，标的资产的公允价值较账面值的增值部分是否直接归集到对应的具体资产项目的说明

(一) 公司商誉确认及减值测试是否符合企业会计准则要求及减值测试是否有效的说明

1、公司商誉确认是否符合企业会计准则要求

公司上述对商誉确认的陈述与会计师在审计过程中所了解到的与收购星科金朋所确认商誉相关的信息一致。在对长电科技2015年及2016年度合并财务报表进行审计过程中，会计师按照中国注册会计师审计准则对商誉确认执行了审计程序，会计师认为公司上述商誉确认的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的要求。

2、公司商誉减值测试是否符合企业会计准则要求，减值测试是否有效

公司上述对2016年12月31日商誉减值测试相关的陈述与会计师在审计过程中所了解到的信息一致。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》，因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金

额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。

在对长电科技 2016 年度合并财务报表进行审计过程中，会计师取得了长电科技聘请的中联资产评估集团有限公司对收购星科金朋所确认的商誉进行减值测试的评估报告，以及公司对星科金朋资产组进行商誉减值测试的详细会计文档。会计师委托内部商业模型及价值估值专家对上述评估报告及公司评估结果进行复核，对减值测试过程中使用的模型及重要参数进行查验，未发现重大异常。会计师认为长电科技对上述商誉于 2016 年 12 月 31 日的减值测试是有效的，在所有重大方面符合企业会计准则的规定。

（二）标的资产的公允价值较账面值的增值部分及是否直接归集到对应的具体资产项目的说明

在对长电科技 2015 年及 2016 年度合并财务报表进行审计过程中，会计师按照中国注册会计师审计准则的要求对商誉确认执行了审计程序，会计师注意到公司的商誉为 2015 年 8 月 5 日完成收购星科金朋 100% 股权产生，公司聘请了第三方评估机构新加坡 Duff & Phelps Corporation 对收购标的星科金朋购买日可辨认净资产公允价值进行了评估，依照会计准则对星科金朋各项可辨认资产、负债及或有负债均逐项单独予以确认，收购日各项可辨认资产公允价值较账面值的增值部分直接归集到对应的具体资产项目。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构核查了新加坡 Duff & Phelps Corporation 对购买日星科金朋可辨认净资产公允价值的评估报告、中联资产评估集团有限公司出具《江苏长电科技股份有限公司商誉减值测试所涉及的 STATS ChipPAC. PTE.Ltd. 预计未来现金流量的现值咨询报告》及公司的定期报告，与发行人管理人员、会计师进行了沟通。

经核查，保荐机构认为：发行人能够对子公司星科金朋进行有效整合，发行人 2016 年 12 月 31 日商誉减值测试有效，未计提商誉减值准备。

重点问题十

10、申请人报告期内除 2014 年度营业利润为正值外，其他年度均为负值，且毛利率逐年下降。请申请人补充说明公司毛利率逐年下滑、营业利润为负值的原因及合理性，相关影响因素是否已消除，是否影响公司持续经营，是否对募投项目实施造成不利影响。

请保荐机构发表核查意见。

回复：

一、公司毛利率逐年下滑、营业利润为负值的原因及合理性

（一）报告期内公司经营情况

报告期内，公司的经营业绩如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入	1,685,980.62	1,915,452.77	1,080,702.38	642,827.33
营业成本	1,517,143.60	1,689,061.57	887,961.60	506,967.03
营业税金及附加	4,117.49	3,151.85	1,426.50	717.82
销售费用	17,391.12	23,356.50	15,038.92	8,707.80
管理费用	126,608.67	159,510.47	130,853.19	80,513.40
财务费用	77,651.26	96,429.98	59,085.42	22,398.20
资产减值损失	766.02	6,854.79	3,087.53	1,534.18
公允价值变动收益	6,893.20	15,411.73	-1,565.54	-225
投资收益	8,374.65	1,865.59	985.1	154.89
其他收益	24,950.94	-	-	-
营业利润	-17,478.75	-45,635.06	-17,331.21	21,918.79
毛利率	10.01%	11.82%	17.83%	21.13%

报告期内随着公司收购星科金朋及主营业务的发展，公司营业收入和营业毛利大幅上升，2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月公司营业收入分别为 624,827.33 万元、1,080,702.38 万元、1,915,452.77 万元和 1,685,980.62 万元。由于受星科金朋产能利用率不足、公司产品结构改变、管理费用、财务费用较高等因素的影响，公司毛利率逐年下降且营业利润自 2015 年起为负。

（二）毛利率逐年下滑的原因及合理性

1、星科金朋毛利率低，公司自 2015 年 8 月起合并了星科金朋财务报表

报告期内，星科金朋由于个别大客户订单量下滑、工厂搬迁等因素，导致其产能利用率较低。

半导体行业作为重资产、重投入行业，固定成本在总成本中占比较大，产能利用率水平直接决定了企业的毛利率水平。2015 年下半年开始，受个别大客户订单下滑、工厂搬迁等因素影响，星科金朋订单量和营业收入大幅下滑，造成产能利用率不足，毛利率大幅降低，从而导致公司自 2015 年 8 月合并星科金朋财务报表后总体毛利率水平下滑。

2、SCC 工厂搬迁

由于上海市青浦区城市建设总体规划和上海市政府关于西虹桥地区整体开发建设需要等原因，星科金朋上海厂 SCC 自 2015 年下半年开始将其工厂逐步搬迁至江阴新厂 JSCC，JSCC 自 2016 年启动运营，承担客户试样，2017 年 9 月搬迁完成。一方面，搬迁过程中部分客户暂停了对星科金朋的订单导入，导致星科金朋订单量下滑；另一方面，由于两地工厂同时运营、JSCC 大量新工厂员工培训、产能提升增加投入，此期间内人工成本与运营成本也有较大幅度增加，从而导致星科金朋及公司整体毛利率水平降低。

3、产品结构调整，JSCK 产品毛利率较低

报告期内，公司在韩国新设子公司 JSCK 主要生产高阶 SiP 封装系列产品，该类产品材料费用在成本中占比大于上市公司其他封装类产品，且 JSCK 于 2016 年开始运营，初期投入较大，导致毛利率较低：

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年
集成电路封装业务综合毛利率	8.95%	11.54%	17.17%
JSCK 毛利率	4.64%	4.74%	-

随着 JSCK 业务发展，其收入在公司总收入中占比逐渐上升，2016 年及 2017 年 1-9 月，JSCK 营业收入分别为 236,820.92 万元、320,624.25 万元（未经审计），占公司收入比重分别为 12.36%、19.02%，JSCK 收入占比上升使得公司毛利率有一定下降。

4、长电先进价格及产品结构调整

报告期内，公司子公司长电先进为扩大市场占有率，对部分国际一线大客户进行了价格调整；同时长电先进 12 英寸 Bumping 订单权重变大，上述产品原材料单价较高，材料成本在产品最终售价中占比较大，毛利率相对较低。上述因素共同导致长电先进报告期毛利率下降。

（三）营业利润为负的原因及合理性

公司自 2015 年 8 月 5 日开始合并星科金朋后营业利润由正转负，2016 年、2017 年 1-9 月整个期间合并了星科金朋业绩。公司自 2015 年开始营业利润为负的主要原因系公司合并星科金朋财务报表所致。

受个别大客户订单量下滑、工厂搬迁等因素，星科金朋产能利用率较低，毛利下降，2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月，星科金朋营业毛利分别为 11,700.2 万美元、7,820.1 万美元及 768.1 万美元，加上管理费用、财务费用等期间费用之后，营业利润为负。

造成星科金朋报告期营业利润损失较大的原因具体如下：

1、产能利用率较低，毛利下降

半导体行业作为重资产、重投入行业，固定成本在总成本中占比较大，产能利用率水平直接决定了企业的毛利率水平。2015 年下半年开始，受个别大客户订单下滑、工厂搬迁等因素影响，星科金朋订单量和营业收入大幅下滑，造成产能利用率不足，毛利下降。

2、由于要约收购事项产生较大规模一次性费用

星科金朋在要约收购过程中，产生较大金额与收购相关的一次性费用，例如要约收购过程中的中介机构费用等。于 2015 年，星科金朋因为要约收购事项产生相关中介机构费等费用 11,546.7 万元，导致星科金朋管理费用增幅较大。

与此同时，要约收购完成后，星科金朋进行了债务重组，由此产生了包括债务重组交换要约和赎回费用、债务发行安排费用等一次性财务费用。于 2015 年，星科金朋增加的与债务重组有关的提前偿还及赎回债务和发行新债务所支

付一次性安排费用合计 27,021.6 万元；于 2016 年，星科金朋因 3.15 亿美元退出贷款发行费用发生债务发行安排费用 6,412.01 万元。上述债务重组费用导致星科金朋 2015 年及 2016 年财务费用增幅较大。

3、星科金朋资产负债率高，导致其财务费用较高

2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 9 月 30 日，星科金朋资产负债率分别为 61.81%、65.42%和 61.64%，在考虑永续债影响后，上述资产负债率分别为 71.34%、75.48%和 72.47%，较高的资产负债率导致较高的财务费用。

综上所述，公司于 2015 年 8 月开始合并星科金朋财务报表，星科金朋自合并以来因产能利用率较低，毛利下降，加上要约收购、债务重组等一次性费用和高额财务费用等原因导致营业利润为负，从而构成导致公司整体营业利润为负的主要原因。在扣除星科金朋及 JSCK 影响后，公司 2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月的营业利润为正。

二、相关影响因素是否已消除，是否影响公司持续经营，是否对募投项目实施造成不利影响

（一）相关影响因素消除情况

1、造成毛利率下降的因素正在逐步消除或稳定

（1）公司加大对星科金朋的整合力度，改善经营绩效

报告期内，公司加大了对星科金朋的整合力度，从经营机制、产品结构、文化融合等多个方面切入，目前已经逐步见效。2017 年第四季度，星科金朋实现营业收入约 3.39 亿美元（未经审计），较第三季度上升 13.18%；综合毛利率上升至 8.58%；星科金朋第四季度实现营业毛利 2,905.95 万美元，较第三季度也有较大提升。因此，星科金朋经营绩效已经体现出向好的趋势。

关于公司对星科金朋整合的具体情况，请参见本反馈回复“重点问题九”之“一、关于公司是否能够对子公司星科金朋进行有效整合的说明”。

（2）SCC 工厂搬迁完成

上海厂 SCC 于 2015 年下半年-2017 年 9 月搬迁，目前 SCC 搬迁已经完成，

江阴新厂 JSCC 客户订单恢复良好，新客户导入顺利，特别是倒装（FC）相关业务订单饱满。JSCC 目前正加快对新员工的培训，加紧提升产能和生产效率，以应对正在恢复和新增的客户订单。

（3）长电先进及 JSCK 产品结构趋于稳定

2016 年长电先进实现营业收入 219,729.42 万元，较 2015 年增长 14.75%，主营业务发展情况良好。

JSCK 为世界一流客户提供行业内领先的高阶 SiP 服务，2017 年 1-9 月，JSCK 实现营业收入 320,624.25 万元（未经审计），未来 JSCK 将成为公司新的利润增长动力之一。

综上，上述造成公司毛利率下降的因素已逐步消除或稳定。

2、公司提升管理效率、降低管理费用的规划

公司作为中国内地第一、全球第三大的半导体封装测试企业，由于规模较大，管理费用绝对金额较高，但公司管理费用率水平低于同行业可比上市公司：

项目	通富微电	华天科技	晶方科技	平均	长电科技
2017 年 1-9 月	9.57%	7.52%	23.82%	13.64%	7.51%
2016 年	11.86%	9.17%	27.23%	16.09%	8.33%
2015 年	18.26%	10.93%	22.86%	17.35%	12.11%
2014 年	13.55%	10.65%	21.55%	15.25%	12.52%

数据来源：Wind

注：管理费用率=管理费用/营业收入。

公司在完成对星科金朋的要约收购后，精简行政机构，减少星科金朋行政管理人员，实行扁平化管理，缩短管理流程，提高决策效率，变子公司为利润中心，推行阿米巴管理模式。通过上述措施多管齐下，有效将公司管理费用控制在合理水平内。从上表可以看出，公司报告期的管理费用率呈现逐渐下降的趋势。

3、公司改善财务结构、降低财务费用的规划

一方面，公司在收购星科金朋后，置换了星科金朋部分存续的高息债务。同时公司通过借入成本较低的项目贷款等方式，降低了公司整体财务费用水平。此外，前次发行股份购买资产并募集资金也缓解了公司的资金压力。截至 2017 年

9月30日，公司有息债务总额（含短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款）为1,495,990.19万元，较2016年12月31日减少162,594.37万元。

另一方面，本次发行完成后，公司资产总额、净资产规模均将增加，且通过使用募集资金来偿还一部分银行贷款，能够使负债总额和资产负债率进一步下降，从而能够有效的优化公司财务结构，降低公司财务费用，提升公司盈利能力。谨慎考虑，按照金融机构人民币贷款基准利率（1-5年）4.75%计算，本次非公开发行偿还**10.8亿元**银行贷款后，公司年财务费用可减少**5,130万元**，占2016年公司归属于母公司所有者的净利润**48.24%**。

关于本次非公开发行对公司资产负债率等财务指标的具体影响，请参见本反馈回复“重点问题七”之“二、对比本次发行完成后的资产负债率水平、有息负债水平与同行业可比上市公司平均水平，说明偿还银行贷款需求是否与实际需求相符”。

（二）相关影响因素将不会影响公司的持续经营

1、国家产业政策大力支持，我国集成电路行业快速发展

集成电路产业是我国信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。2011年，中国集成电路营业收入为1,933.7亿元，到2016年时达到4,335.5亿元，复合增长率达到22.37%。考虑到国家对半导体行业的大力支持和《国家集成电路产业发展推进纲要》等政策的发布，预计我国集成电路市场增长将持续。《国家集成电路产业发展推进纲要》指出：“到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强”，按照2017年至2020年，年增长率稳定在20%的趋势计算，到2020年，我国集成电路营业收入将达到8,990亿元。

2、公司主营业务发展良好

报告期内公司主营业务发展良好，原有业务稳定增长，通过收购星科金朋国际业务大幅增加，公司在全球集成电路委外封装测试（OSAT）行业排名由第六

名提升到第三名，并跻身全球封测行业第一阵营。同时，公司于中国江阴、滁州、宿迁及新加坡、韩国设有不同特色的生产基地，业务覆盖国际、国内主要高端客户；公司拥有 Fan-out (eWLB)、SiP、WLCSP、FC 等多项高端集成电路封测技术与生产能力，技术水平已步入世界先进水平行列。

3、公司经营现金流量情况良好

2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 104,851.87 万元、174,459.62 万元、266,928.32 万元及 261,843.90 万元，公司现金流量情况良好。同时，公司与多家商业银行建立了良好的合作关系，拥有足够的授信额度和资金支持，且公司主要客户为国际国内知名的半导体企业，商业信用良好。

4、相关不利因素已逐步消除，本次非公开发行将优化公司财务结构，提高公司盈利能力

目前，公司对星科金朋的整合正逐步见效，SCC 已完成搬迁，长电先进与 JSCK 经营情况向好，影响公司毛利率和营业利润的因素正在逐步消除或稳定。同时公司采取多种措施控制管理费用增长，优化财务结构，通过本次非公开发行进一步降低财务费用，增强公司盈利能力。

综上，公司业务规模、产能布局、技术能力、客户资源等重要方面均稳定、可持续，主营业务突出，相关影响因素对公司持续经营无重大不利影响。

(三) 对募投项目实施无重大不利影响

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 **405,000 万元**，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入“年产 20 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”、“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”及偿还银行贷款。

目前上述导致公司毛利率逐年下降且营业利润为负的不利因素正在逐步消除或稳定。同时全球半导体市场尤其是我国半导体市场继续保持增长态势，募投项目相关的产品市场前景良好，公司在相关领域有长期的研发、生产、管理经验及丰富的客户资源。此外，公司通过扁平化管理、精简管理机构多种措施控制管理费用水平；通过置换高息债务，偿还银行贷款，公司的财务结构将得到有效改

善，财务费用得到减少，从而能够提高抗风险能力，提升盈利能力。上述募投项目实施主体分别为上市公司下属集成电路事业中心及子公司长电先进，上市公司及子公司长电先进在报告期内经营业绩良好且产能利用率较高，上述造成毛利率下降及营业利润为负的因素不会对募投项目实施造成重大不利影响。

综上，公司报告期毛利率下降和营业利润为负的相关影响因素对本次发行的募投项目实施无重大不利影响。

三、保荐机构的核查意见

保荐机构核查了发行人历年的定期报告、临时报告，对星科金朋等发行人重要子公司进行了走访，并对发行人管理人员进行了访谈。

经核查，保荐机构认为：造成发行人报告期内毛利率逐年下降且营业利润为负的不利因素正得到逐步消除或稳定，不存在影响发行人持续运营的重大不利情形，对本次募投项目实施无重大不利影响。

重点问题十一

11.报告期内，申请人非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助、公允价值变动损益以及投资收益等非经常性损益金额较高，对净利润的影响较大。请申请人补充说明上述非经常性损益的主要内容，申请人是否对政府补助等非经常性损益存有重大依赖。

请保荐机构发表核查意见。

回复：

一、发行人非经常性损益的主要内容

报告期内，公司非经常性损益的主要内容如下：

单位：万元

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置利得	1,983.91	1,215.23	1,430.37	73.85
其中：固定资产处置利得	1,983.91	1,215.23	1,430.37	73.85
无形资产处置利得	-	-	-	-

项目	2017年1-9月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动资产处置损失	776.76	1,508.52	2,334.37	337.63
其中：固定资产处置损失	776.76	1,508.52	2,334.37	337.63
无形资产处置损失		-	-	-
计入当期损益的政府补助	33,298.00	20,675.01	5,989.20	4,411.74
其中：递延收益转营业外收入/其他收益	20,929.32	16,820.98	5,101.62	3,597.26
直接记入营业外收入/其他收益	12,368.68	3,854.03	887.58	814.48
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	6,893.20	15,411.73	-1,565.54	-225.00
其中：黄金远期合约公允价值变动损益	-	36.22	-39.70	-225.00
最低采购承诺公允价值变动收益	6,893.20	15,375.52	-	-
可转换股东贷款公允价值变动损失	-	-	-1,525.84	-
投资收益（损失以“-”号填列）	8,374.65	1,865.59	985.10	154.89
其中：权益法核算的长期股权投资损失	-311.13	-275.19	-3,071.97	-190.93
处置长期股权投资产生的投资收益	8,685.78	-	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	1,577.83	3,477.88	0.72
银行理财产品利息收益	-	562.95	566.79	345.09
其他	-	-	12.40	-
其他非经常性损益（损失以“-”号填列）	2,099.87	-6,437.30	110.23	-683.59
其中：其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,358.77	-	-	-
少数股东权益影响额	-4,756.79	-4,312.18	928.74	-298.74
所得税影响额	-5,021.78	-978.74	-416.93	-299.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519.67	-1,146.38	-401.58	-85.50
合计	51,872.87	31,221.74	4,614.99	3,394.26

（一）非流动资产处置利得与非流动资产处置损失

公司非流动资产处置损益主要来自于星科金朋的固定资产处置。由于星科金朋每年进行设备更新换代且设备单价较高，故产生较多的固定资产处置损失和利得。此外，SCC 工厂搬迁过程中处置固定资产也产生了较多的固定资产处置损失。

（二）计入当期损益的政府补助

作为国家重点扶持的半导体封测行业龙头企业，长电科技、长电滁州、长电宿迁、长电先进除享受作为高新技术企业的税收优惠外，每年还享受各级政府的补助支持，内容涵盖设备采购资金扶持、进口设备贴息补助、研发资金扶持、节

能环保和技术创新鼓励奖金等。

（三）公允价值变动损益

公司 2017 年前三季度及 2016 年度公允价值变动损益主要来自于最低采购承诺公允价值变动收益，2015 年度公允价值变动损益则主要来自可转换股东贷款公允价值变动损失。

1、最低采购承诺公允价值变动收益

（1）最低采购承诺具体内容及形成过程

①星科金朋剥离其原台湾子公司 SCT1、SCT3

由于台湾地区对于大陆企业投资台湾半导体相关行业企业存在一定的政策限制，大陆企业不得对台湾半导体封装及测试企业具有控制能力，公司要约收购星科金朋的过程中将其台湾子公司 SCT1、SCT3 通过重组进行了剥离。

SCT1、SCT3 主要为星科金朋韩国子公司 SCK 的倒装（FC）业务提供凸块中段制造（Bumping）及测试服务，重组剥离后星科金朋韩国子公司 SCK 将成为 SCT1、SCT3 客户，向 SCT1、SCT3 采购服务和产品，双方构成业务合作关系。

②星科金朋与 SCT1、SCT3 签署《技术服务协议》的原因及主要内容

根据公司要约收购方案的约定，同时为了：（1）SCT3 归还欠星科金朋的 1.27 亿美元股东借款，（2）保证重组剥离后星科金朋与台湾子公司 SCT1、SCT3 三方的业务和正常经营不受影响，（3）发挥 SCT1、SCT3 的区位优势帮助星科金朋承接台湾客户订单，2015 年 8 月，星科金朋与 SCT1、SCT3 签署了《技术服务协议》。

《技术服务协议》约定协议期限内星科金朋有权按约定价格向 SCT1、SCT3 下达采购订单；SCT1、SCT3 预留产能给星科金朋，以及时提供服务。协议初始期限为签署之日起的 5 个合同年度（每一合同年度为当年 8 月 5 日起的连续 12 个月）。

《技术服务协议》同时约定，星科金朋承诺并同意 SCT1、SCT3 符合条件

的收入在任何一个合同年度中均不得低于在该合同年度中的最低采购金额 (Minimum Spend)，具体如下：

单位：千美元

年份	期限	最低采购金额
第 1 年	2015 年 8 月 5 日-2016 年 8 月 4 日	95,000
第 2 年	2016 年 8 月 5 日-2017 年 8 月 4 日	80,800
第 3 年	2017 年 8 月 5 日-2018 年 8 月 4 日	75,100
第 4 年	2018 年 8 月 5 日-2019 年 8 月 4 日	63,200
第 5 年	2019 年 8 月 5 日-2020 年 8 月 4 日	51,400

协议期限内，若每一合同年度 SCT1、SCT3 取得的符合条件收入 (Eligible Revenue) 低于最低采购金额，SCT1、SCT3 可依据协议约定程序向星科金朋主张差额补偿 (Reconciliation Payment)；

星科金朋可以选择将该合同年度不超过最低采购金额 5% 的部分 (Maximum Deferred Revenue) 递延到下一合同年度，不在该合同年度结束后补偿；星科金朋每年只能行使递延权利一次，且该递延部分不得于次年度再递延，最后一合同年度不得行使递延权利。

③最低采购承诺的具体内容

基于星科金朋与 SCT1、SCT3 原有业务量约 1.1 亿美元/年，且 SCT1、SCT3 正常经营需依赖于星科金朋下达的订单，要约收购谈判时作为要约生效条款之一的《技术服务协议》约定了前述的 5 个合同年度的最低采购金额。

2015 年第三季度开始，个别大客户对星科金朋韩国子公司 SCK 订单突然下降，导致 SCK 对 SCT1、SCT3 采购量也大幅下滑，2015 年 8-12 月星科金朋向 SCT1、SCT3 采购金额仅为 1,400 余万美元。

考虑到订单回补需要时间，为谨慎起见，并聘请专业机构进行了公允价值评估，星科金朋于 2015 年末计提了约 8,600 万美元的“最低采购承诺”拨备，以反映补偿风险的最佳估计。由于该拨备无初始投资，且补偿金额随着星科金朋向 SCT1、SCT3 采购金额而波动，在未来由星科金朋结算，公司将其确认为衍生金融工具，并以公允价值计量且其变动计入损益。公司合并财务报表层面将“最低采购承诺”拨备根据合同期限划分为短期负债与长期负债，拨备归属于短期的

部分（2015年8月5日-2016年8月4日）记入衍生金融负债，长期部分（2016年8月5日-2020年8月4日）记入其他非流动负债；同时“最低采购承诺”拨备减少了收购日（2015年8月5日）星科金朋的净资产金额，最终增加了收购日的商誉金额。

在评估“最低采购承诺”公允价值时，模型输入值为星科金朋对 SCT1 和 SCT3 的采购金额，该采购金额分布的最大及最小值依据星科金朋承诺期内向 SCT1 和 SCT3 采购金额的最差及最好估计确定，对模型输入值进行概率加权平均并折现得出最低采购承诺的公允价值。

（2）最低采购承诺公允价值变动收益的形成原因

鉴于 2015 年 8-12 月星科金朋向 SCT1、SCT3 采购金额极低的情况，一方面公司计提了“最低采购承诺”拨备，另一方面公司将《技术服务协议》履行作为重大项目管理，明确责任人和管理团队解决对 SCT1、SCT3 履约问题。

通过导入新客户与新产品等措施，2016 年以来星科金朋对 SCT1、SCT3 订单量开始逐步上升，2016 年四个季度订单金额分别超过 1,300、1,900、1,900、1,800 万美元，合计金额超过 7,000 万美元，加上协议约定的最低采购额逐年递减，预计协议期间后续年度补偿额将加速减少。

2015 年 8 月 5 日-2016 年 8 月 4 日的第一合同年度，星科金朋对 SCT1、SCT3 的采购金额合计约 5,300 万美元，与第一合同年度最低采购金额差额达 4,200 万美元。2017 年 1 月，经协商双方达成一致，星科金朋最终向 SCT1、SCT3 补偿了 3,019.66 万美元，此部分金额冲减了最低采购承诺拨备的余额。

2016 年 8 月 5 日-2017 年 8 月 4 日的第二合同年度，星科金朋对 SCT1、SCT3 的采购金额合计约 6,082 万美元，与第二合同年度最低采购金额差额约 2,000 万美元。2017 年 11 月，经协商双方达成一致，星科金朋向 SCT1、SCT3 补偿约 1,570 万美元，此部分金额冲减了最低采购承诺拨备的余额。

结合上述订单采购实际情况以及星科金朋向 SCT1、SCT3 支付的补偿金情况，基于星科金朋对 SCT1、SCT3 的采购金额逐年上升、第三至第五年度最低采购承诺金额逐年下降以及自第三年度起星科金朋将以市场价格向 SCT1、SCT3

进行采购等事实，公司认为对 SCT1、SCT3 预提的最低采购承诺风险已逐步释放。2016 年末、2017 年 5 月末，星科金朋分别聘请专业机构再次对最低采购承诺的公允价值进行了评估，其变动金额计入了当期最低采购承诺公允价值变动收益。同时，公司在每个资产负债表日根据合同期限划分归属于短期负债与长期负债的金额。

2、可转换股东贷款公允价值变动损失

产业基金在公司收购星科金朋过程中于 2015 年 6 月向长电新朋提供了 1.4 亿美元等值人民币的可转换股东借款。公司将该股东借款整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，并按评估值入账。2015 年 11 月产业基金将该股东借款按本金转换为对长电新朋股权，转换时对公允价值进行了重新评估，形成可转换股东借款公允价值变动损失。

因公司将该股东借款整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，并按评估值计量其公允价值的变动；同时根据《共同投资协议》相关约定，如果产业基金在该次收购实施完成 5 年后仍未选择行使该可转换股东贷款的转股权利，长电新朋才需支付相应的利息，而该可转换股东贷款已于 2015 年 11 月完成转股，因此，不涉及 2015 年资产负债表日的应付利息计提。

（四）投资收益

报告期内，公司主要通过以下各类投资获取收益：

1、投资联营公司，主要是对国富瑞数据系统有限公司、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、江阴达仕新能源科技有限公司和中芯长电（开曼）有限公司各期损益确认按照享有股权比例确认的投资损益。2015 年，由于公司参股的中芯长电（开曼）之全资孙公司中芯长电（江阴）刚开始投产，亏损较大，因此产生较大的长期股权投资损失。

2、处置长期股权投资产生的投资收益，系 2017 年公司转让持有的国富瑞数据系统有限公司 19.99% 股权产生的收益。

3、公司持有可供出售金融资产等取得的投资收益主要系 2015 年、2016 年收到的新加坡 JCI 分配的现金股利。

4、银行理财产品利息收益主要系公司为提高资金使用效率而购买理财产品产生的收益。

(五) 其他符合非经常性损益定义的损益项目

鉴于 SCC 与 SCK 分别于 2017 年与所在地税务部门就历史期间的转让定价问题解决方案达成一致并支付相应税款，公司于 2017 年转回了原预计负债的超出部分，该转回产生的损益符合非经常性损益的定义。关于预计负债的具体情况，请参见本反馈回复“一般问题五”之“一、发行人关于最近一期末预计负债的具体内容及其确认和计量是否符合会计准则相关规定的说明”。

二、发行人是否对政府补助等非经常性损益存在重大依赖的说明

(一) 公司对非流动资产处置损益不存在重大依赖

2014 年，2015 年，2016 年和 2017 年 1-9 月，公司由于处置非流动资产而产生的净损益分别为-263.79 万元、-903.99 万元、-293.28 万元和 1,207.15 万元，上述非流动资产处置事项主要系星科金朋的固定资产处置，其对公司损益影响金额较小，且 2014 年至 2016 年相关处置损益均为负，公司不存在依赖非流动资产处置损益的情形。

(二) 公司对政府补助不存在重大依赖

1、递延收益计入当期损益的政府补助

报告期内，公司递延收益转入营业外收入或其他收益的政府补助项目明细如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
高效节能应用开关芯片研发与产业化项目	-	40.00	40.00	40.00
年产 240 亿只中小功率分立器件封测新工艺研究及应用	18.75	25.00	25.00	25.00
双回路供电项目	77.44	48.31	14.17	-
进口设备贴息及涉外服务收入	47.69	30.96	10.75	6.47
战略新兴项目贴息	-	1,054.17	1,150.00	95.83
国际合作项目圆片级 LED 封装专项资金	-	-	12.50	12.50

项目	2017年 1-9月	2016年	2015年	2014年
超大规模集成电路圆片级芯片封装、检测技术及产业化	-	-	30.91	49.82
江苏省软件和集成电路业专项经费项目	21.58	28.77	28.77	28.77
硅通孔-CMOS 图像传感器研发项目设备补助	14.72	19.63	19.63	19.63
关键封测设备、材料应用工程	35.42	47.23	47.23	47.23
高端封装工艺及大容量闪存集成封装技术开发与产业化	518.99	691.98	691.98	729.84
CPU 协作研究经费	349.46	-	-	-
其他涉外发展服务支出	22.53	30.04	30.04	30.04
12.5 应用工程项目经费-通讯与多媒体芯片封装测试费	3,101.69	-	-	-
装备贴息资金	26.06	34.75	34.75	34.75
进口设备贴息	2.52	3.36	3.36	-
鼓励进口结构调整项目	2.46	3.28	3.28	0.27
进口设备贴息	19.56	26.08	26.08	-
物联网项目拨款	12.28	16.37	15.01	-
华进项目经费（中芯国际）	610.84	-	-	-
02 专项-关键封测设备、材料应用工程	-	22.24	22.24	22.24
高密度集成电路封装技术国家工程实验室建设项目	135.08	180.10	180.10	180.10
关键封测设备、材料应用工程	6.73	8.97	9.43	8.97
组建年产 5 亿块新型集成电路 FBP 封测生产线	18.75	25.00	25.00	25.00
新型方形扁平无引脚集成电路封装研发	1.04	-	-	-
企业技术中心创新能力项目	46.87	62.50	62.50	62.50
基于 MIS 技术的 QFN 封装产品研究与产业化项目	64.17	85.55	85.55	85.55
系统级封装产品技改项目	27.69	36.92	36.92	36.92
MicroSD 卡的研发及产业化项目	32.61	43.48	43.48	43.48
集成电路封测生产线技改项目	51.66	68.87	68.87	68.87
高密度细间距 FBP 技术研发及产业化	45.54	60.73	60.73	60.73
新型集成电路封测产业化项目	-	93.92	93.92	93.92
高端封装工艺及大容量闪存集成封装技术开发与产业化	421.20	561.59	561.59	570.04
重布线/嵌入式圆片级封装技术及高密度凸点技术研发及产业化	461.65	6,094.27	-	205.35
通讯与多媒体芯片封装测试费	-	3,157.23	-	-
进口设备贴息	142.09	189.45	189.45	-
工业和信息产业支持——通信用新型片式混合集成电路技改扩能项目	16.80	22.40	22.40	22.40
工业和信息产业支持——高密度细间距 BGA 封装产品的开发项目	13.75	18.33	18.33	18.33
物联网项目——物联网和集成电路研发及产业化项目	368.75	82.19	-	-

项目	2017年 1-9月	2016年	2015年	2014年
科技条件专项——通信用系统级封装产品项目	14.33	19.10	19.10	19.10
科技条件专项——通信用高密度球栅阵列封装 FBGA 技改扩能	55.83	74.44	74.44	74.44
创新能力项目——其他工业和信息产业监管支出	100.00	-	-	-
创新能力项目——科技创新奖励	63.77	-	-	-
IC 先进旋转涂胶贴片技术研发	73.08	97.45	97.45	97.45
通信用混合射频集成电路改造项目	-	-	-	-
装备贴息资金	28.13	37.50	37.50	-
移动智能终端芯片（联芯）	-	378.11	-	-
移动智能终端芯片（展讯）	-	795.99	-	-
移动智能终端芯片（中兴）	-	256.50	-	-
进口设备贴息	121.05	161.40	161.40	354.21
通信用 BGA 球栅阵列封装技改扩能项目（装备贴息拨款）	28.13	37.50	37.50	-
量产应用工程专项（2014ZX02003）	2,113.12	-	-	-
移动智能终端芯片（海思）	-	437.89	-	-
通信用高脚位 QFN 封装混合电路改造项目	300.00	-	-	-
智能功率模块封装技术研发与产业化	2.71	-	-	-
进口设备贴息（江阴财政局）	199.77	266.37	266.37	-
进口设备贴息（江阴财政局）	60.71	80.94	6.75	-
通信用高脚位 QFN 封装混合集成电路改造项目	159.38	-	-	-
财政设备贴息	14.35	19.14	19.14	15.95
高密度混合集成电路封装改造项目	93.75	52.08	-	-
进口设备贴息	200.84	66.95	-	-
工业和信息产业转型升级专项资金	-	600.00	-	-
进口设备贴息	101.90	33.97	-	-
鼓励企业创新发展（购置设备）	119.36	94.35	-	-
技改补助	422.76	393.75	70.49	-
华进（2014ZX02501-004）	7,593.05	-	-	-
中芯项目国拨经费	204.37	-	-	-
按压式指纹识别传感器系统封装模块的研发与产业化	8.33	-	-	-
通信用高密度基板封装混合集成电路扩能项目（装备贴息拨款）	300.00	-	-	-
应用于智能多媒体终端芯片的大尺寸 PBGA 封装技术开发与产业化	8.33	-	-	-
进口设备贴息款	20.25	3.89	-	-
技术改造资金	30.94	-	-	-
2017 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金	7.75	-	-	-
年产 9.6 亿颗 12 英寸晶圆凸块及晶圆级	500.00	-	-	-

项目	2017年 1-9月	2016年	2015年	2014年
芯片尺寸封装技改扩能项目				
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	1,000.00	-	-	-
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目	247.00	-	-	-
进口贴息	-	-	647.52	-
涂胶显影机研发项目	-	-	-	398.04
科技三项拨款	-	-	-	11.25
外贸促进资金	-	-	-	2.28
合计	20,929.32	16,820.98	5,101.62	3,597.26

公司对于计入递延收益的政府补助，按照如下原则计入损益：（1）对于与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）对于与资产相关的政府补助，公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

根据公司的实际情况，报告期内，由递延收益转入当期损益金额较大政府补助项目如下：

单位：万元

序号	项目	2017年 1-9月	2016年	2015年	2014年
1	战略新兴项目贴息	-	1,054.17	1,150.00	95.83
2	高端封装工艺及大容量闪存集成封装技术开发与产业化 ^注	518.99	691.98	691.98	729.84
3	高端封装工艺及大容量闪存集成封装技术开发与产业化 ^注	421.20	561.59	561.59	570.04
4	重布线/嵌入式圆片级封装技术及高密度凸点技术研发及产业化	461.65	6,094.27	-	205.35
5	通讯与多媒体芯片封装测试费	-	3,157.23	-	-
6	移动智能终端芯片（展讯）	-	795.99	-	-
7	工业和信息产业转型升级专项资金	-	600.00	-	-
8	12.5应用工程项目经费-通讯与多媒体芯片封装测试费	3,101.69	-	-	-
9	华进（2014ZX02501-004）	7,593.05	-	-	-
10	量产应用工程专项（2014ZX02003）	2,113.12	-	-	-
11	华进项目经费（中芯国际）	610.84			

注：该两项目属于同一课题，分别由长电科技与子公司长电先进实施，下文将统一介绍该项目情况。

上述项目具体情况如下：

（1）战略新兴项目贴息

①项目基本情况

该项目为年产 350 亿块半导体分立器件封测新工艺研究与应用。上述课题是针对中小功率分立器件方面的技术，并在长电滁州进一步研发、形成产业化。其解决了传统产品封装成本高、工艺复杂、成品率低、可靠性差的困扰。该项目产品具有可靠性高、抗振能力强、焊点缺陷率低的特点。

②项目应用领域

该项目主要应用于消费电子、计算机外设、通信、显示屏、汽车电子、电子照明、无线电通讯等领域。

（2）高端封装工艺及大容量闪存集成封装技术开发与产业化

①项目基本情况

该项目的实施主体包括长电科技及长电先进。该项目重点开展具有自主知识产权的高密度芯片凸块（Bumping）及圆片级封装技术（WLCSP）等高密度集成电路封装技术的研发及产业化，产业化建设完成后 WLCSP 产能 5,000 万颗/月；在大容量闪存及系统级集成封装技术上取得突破，产业化建设完成后，达到可年产 4,000 万颗大容量闪存及系统级集成封装产品（包括 USB 模块、Micro SD、HD-SIM、BGA、LGA、MCP 等），通过项目建设为国内同行业建立开展多目标封装（MPP）技术服务平台。

②项目应用领域

该项目已服务多家国内 IC 设计公司，其音频功放/RFID/LCD/Driver/Power IC/RFIC 等 IC 产品应用在中多媒体数码产品、NB/手机、移动支付、移动电视及物联网上，能够与国际大企业直接竞争。

（3）重布线/嵌入式圆片级封装技术及高密度凸点技术研发及产业化

①项目基本情况

该项目主要建立了重布线/嵌入式圆片级封装技术生产线，实现了双层再布线/嵌入式产品的量产；开发了高密度凸点技术产品，实现了凸点数大于 3,000

的凸块工艺技术开发。该项目实现了圆片级封装产品产能 15 亿颗/年。

②项目应用领域

该项目已经成为便携式电子产品主流的封装技术，项目产品被大量应用到手机、笔记本电脑、相机及平板电脑等便携式电子产品。

(4) 通讯与多媒体芯片封装测试费

①项目基本情况

该项目主要开发高端模拟/混合电路测试系统、高压大电流测试系统、先进封装测试用高性能探针卡、高端封装 X-RAY 检测设备等 17 种设备与 6 种材料产品，并对其进行产业化性能验证与考核，达到技术协议的指标，形成产业化销售，取得批量订单。

②项目应用领域

该项目为开发适用于 SiP、CSP、WLP 等先进、高端封装需要的封测设备与材料提供验证平台。

(5) 移动智能终端芯片（展讯）

①项目基本情况

该项目重点开展具有自主知识产权的合金线键合封装技术的开发，实现 Low-K Wafer 的切割工艺及合金线的键合技术开发及产业化，完成移动智能终端芯片封装成套技术的研发及产业化的目标。

②项目应用领域

该项目主要应用于移动智能终端领域。

(6) 工业和信息产业转型升级专项资金项目

①项目基本情况

该项目为企业内部实施的搬迁扩能装备升级改造项目。项目的主要建设内容为：利用企业搬迁的机会，淘汰部分工艺落后的设备，引进国内外先进的技术装备，对原有半导体芯片封装生产线进行自动化、智能化整合改造，同时在生产线

关键岗位应用机器人替代人工进行操作。

②项目应用领域

该项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年修正版）中“第一类、鼓励类，信息产业 19、集成电路设计，线宽 0.8 微米以下集成电路制造，及球栅阵列封装（BGA）、插针网络阵列封装（BGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）等先进封装与测试”。

（7）12.5 应用工程项目经费-通讯与多媒体芯片封装测试费

①项目基本情况

该项目主要对 SiP、CSP、WLP 等先进、高端封装生产线封测设备与材料进行验证，通过项目的实施，验证了大视场/双面对准步进投影光刻机、先进封装测试用高性能探针卡、高密度倒装设备、高端封装（TSV）PVD 设备、WLP 全自动晶圆激光打标机、单片湿法去胶机、全自动晶圆植球机、12 英寸晶圆单片多腔体显影机 8 种设备以及 WLP 等高端先进封装用蚀刻液。项目的实施进一步推动了国产设备及材料的发展。

②项目应用领域

该项目验证设备及材料主要用于 WLCSP 及 Bumping 先进封装生产线，封装产品主要用于手机、笔记本电脑、相机、平板电脑等便携式电子产品。

（8）华进（2014ZX02501-004）：基于 Low-K 芯片的 BOT-FC 等高密度键合技术的系统集成封装开发与产业化

①项目基本情况

该项目实施主体包括公司及子公司长电先进。长电科技方面，该项目重点开展基于 Low-K 芯片 BOT-FC 等高密度键合工艺、Low K 圆片的晶圆凸点加工等技术开发与产业化，通过课题的成功实施，使公司的集成电路封装技术达到国际先进水平。最终建成年产能 2 亿颗的课题产品的产业化生产线。长电先进方面，主要进行 Low K 圆片的晶圆凸点加工等技术开发与产业化，解决了 Low K 晶圆在加工过程中的晶圆溅射工艺、光刻工艺、电镀工艺问题，形成了 Low K 圆片

的晶圆凸块加工成套技术，该项目完成后实现了 Low K 圆片的晶圆凸块量产技术。

②项目应用领域

该项目技术用于高功率器件、高频器件、高端集成芯片的封装，相关产品应用于高端移动、智能终端封装产品市场。

(9) 量产应用工程专项（2014ZX02003）

①项目基本情况

该项目针对在前期应用工程项目支持下的国产封测设备、材料及单位，由用户单位采购建成基于国产设备、面向中高端 QFN/QFP、LED 等电子电力器件封装的规模化生产线，批量采购，形成量产能力，具备产业化能力及市场竞争力。

②项目应用领域

该项目主要应用于 FN/QFP、LED 等电子电力器件封装的国产设备及材料提供验证平台，并积极采购，形成国产化封测规模生产线。

(10) 华进项目经费（中芯国际）

①项目基本情况

该项目主要建立基于 2.5D 网络系统芯片的开发和封装设计能力，解决基于 TSV 的芯片设计的相关问题。集成两颗或多颗先进工艺节点的 Silicon Dies 于 2.5D TSV 封装技术中，通过多 Die 通过 Interposer 的高密度互连，实现芯片的高集成度、高性能与高可靠性。探索基于 2.5D TSV 技术的芯片开发新流程，解决由于 TSV Interposer 的引入导致的芯片设计、封装工程与验证方法上改变。基于芯片性能的要求，开发并建立 Interposer 设计的方法、Interposer 与基板之间的交互以及 Interposer 性能的验证。打造一支具备 2.5 TSV 集成芯片开发设计的研发团队。

②项目应用领域

项目技术用于高功率器件、高频器件、高端集成芯片的封装，相关产品应用于高端移动、智能终端封装产品市场。

在承接上述项目后，于项目执行过程中，公司需要按照一定比例（具体比例视项目情况及款项性质而定）配套投入资金，并将产生相应的研发支出。与此同时，公司收到的上述政府补助也专款专用于相应项目。

报告期内，公司收到的计入递延收益的政府补助与发生的研发支出的对比情况如下：

单位：万元

年份	2017年1-9月	2016年	2015年	2014年
政府补助作为递延收益 转营业外收入/其他收益	20,929.32	16,820.98	5,101.62	3,597.26
公司计入管理费用的 研发支出	46,259.00	63,788.32	49,513.59	36,940.00

从上表的对比可以看出，公司报告期内的研发支出高于政府补助作为递延收益转为营业外收入或其他收益的金额，即若公司不承担上述科研项目，一方面公司递延收益余额及转入营业外收入或其他收益的金额将大幅降低，另一方面公司相应项目研发支出也将减少。因此，公司该等政府补助金额较高主要系公司为积极开展封装测试领域的技术研发并承接多种科研项目所致。通过接受上述政府补助，公司实施了多项技术含量高、产业带动能力强的项目，开发出了一系列对行业有明显意义的技术与产品。公司不存在依赖政府补助收入的情形。

2、直接计入当期损益的政府补助

报告期内，公司收到的直接计入当期损益的政府补助主要为政府奖励、补助等，2014年及2015年上述补助金额分别为814.48万元、887.58万元，金额较小。2016年和2017年1-9月上述补助金额相对较大，分别为3,854.03万元和12,368.68万元。其中，2016年直接计入当期损益的政府补助主要项目有：

单位：万元

受补助主体	补助内容	金额
长电科技	企业人才培养、研发创新补助	500.00
长电滁州	自主创新奖励	341.15
长电科技	对外投资与经济技术合作项目补贴	300.00
长电滁州	岗位补贴	200.00
长电科技	工业和信息产业转型升级专项资金	150.00

2016年直接计入当期损益的政府补助金额较高主要系SCC搬迁至江阴JSCC收到部分一次性奖励。

2017年1-9月直接计入当期损益的政府补助金额为12,368.68万元，主要项目有：

单位：万元

受补助主体	补助内容	金额
长电科技	重大收购项目专项资金	6,331.50
长电科技	进口贴息	1,480.42
长电滁州	企业发展扶持资金	1,460.89
JSCC	项目载体补贴	825.00
JSCC	人才引进专项资金补助	600.00
长电科技	进口贴息	539.22

2017年2月，根据江阴高新技术产业开发区经济发展局和财政局联合下发的《关于下达长电科技重大收购项目专项资金的通知》（澄高经发[2017]1号），为鼓励公司收购星科金朋、提升产业发展综合竞争力、发挥示范引领作用，江阴高新技术产业开发区经济发展局和财政局对公司收购星科金朋过程中的融资利息差折合人民币6,331.50万元给予一次性奖励。公司于2017年2月收到奖励款，鉴于收购事项已经完成，公司将该奖励直接计入当期损益。由于该事项，公司2017年1-9月直接计入当期损益的政府补助增加较大。

上述政府补助主要为一次性事项，公司不依赖其维持日常经营活动，最近一年一期上述补助金额较大主要与公司收购星科金朋事项有关。该等直接计入当期损益的政府补助金额相较公司营业收入占比较小，公司对其不存在重大依赖。

3、政府补助较高是集成电路行业的特征

报告期各期，同行业可比上市公司政府补助情况如下：

单位：万元

项目	通富微电	华天科技	晶方科技	平均	长电科技	
属于非经常性损益的政府补助发生额	2017年1-9月	8,745.78	3,629.40	1,877.38	4,750.85	33,298.01
	2016年	9,443.48	7,218.17	1,806.19	6,155.95	20,675.01
	2015年	13,721.55	12,423.84	4,806.10	10,317.16	5,989.20
	2014年	8,945.19	6,503.10	2,783.72	6,077.34	4,411.74
政府补助/营业收入	2017年1-9月	1.80%	0.68%	4.14%	2.21%	1.97%
	2016年	2.06%	1.32%	3.53%	2.30%	1.08%
	2015年	5.91%	3.21%	8.35%	5.82%	0.55%
	2014年	4.28%	1.97%	4.52%	3.59%	0.69%

从上表可以看出，同行业可比上市公司在报告期内政府补助占营业收入的比

重平均值均高于长电科技的水平，显示出该行业政府补助较高的特征。

由于上述同行业可比公司营收规模均大幅小于长电科技，为进一步说明集成电路行业具有政府补助较高的特征，选取京东方 A、三安光电及亨通光电等营收规模较大的集成电路行业企业进行比较：

单位：万元

项目		京东方 A	三安光电	亨通光电	平均	长电科技
属于非经常性损益的政府补助发生额	2017 年 1-9 月	61,235.20	12,590.64	7,483.23	27,103.02	33,298.01
	2016 年	191,453.16	50,190.10	8,284.63	83,309.30	20,675.01
	2015 年	104,510.17	59,408.60	6,332.32	56,750.36	5,989.20
	2014 年	83,047.12	50,487.14	10,256.79	47,930.35	4,411.74
政府补助/营业收入	2017 年 1-9 月	0.88%	2.00%	0.39%	1.09%	1.97%
	2016 年	2.78%	8.00%	0.43%	3.74%	1.08%
	2015 年	2.15%	12.23%	0.47%	4.95%	0.55%
	2014 年	2.26%	11.02%	0.98%	4.75%	0.69%

从上表可以看出，京东方 A 等营收规模较大的集成电路企业在 2014 年至 2016 年期间所收到的政府补助无论从绝对规模还是占营业收入的比重而言均高于长电科技。

集成电路行业作为国家鼓励产业之一，系资本密集型、技术密集型、人才密集型行业，具有重研发、重投入特点。因此集成电路行业内其他上市公司在报告期内也存在较大金额政府补助收入，主要由于相关公司承担科研项目以及来自政府的奖励和补贴。从金额上而言，由于公司规模、技术等方面均处于国内领先地位，承担的研究、开发项目较多，同时由于收购星科金朋等事项导致公司获得了一次性补贴，因此政府补助绝对金额高于同行业可比上市公司，但与营收规模较大的其他集成电路行业内公司相比，不存在政府补助金额过高情形。同时从收到的政府补助占营业收入比重而言，公司该项占比低于同行业可比上市公司平均水平。

综上所述，公司收到的政府补助具有合理性，政府补助较高是集成电路行业的特征，公司对政府补助不存在重大依赖的情形。

（三）公司对公允价值变动损益不存在重大依赖

1、黄金远期合约公允价值变动损益：截至 2017 年 9 月 30 日，公司已无黄

金租赁事项，且公司在报告期内黄金租赁金额较小，其公允价值变动对公司业绩影响较小。

2、最低采购承诺公允价值变动损益：该事项系星科金朋因被收购而剥离 SCT1、SCT3 并与其签署《技术服务协议》产生，后续星科金朋通过导入新客户与新产品等措施，逐步提高对 SCT1、SCT3 订单量，加上协议约定的最低采购额逐年递减，预计协议期间后续年度补偿额将加速减少。在此基础上，星科金朋分别聘请专业机构再次对最低采购承诺的公允价值进行了评估，其变动金额计入了当期最低采购承诺公允价值变动收益。（关于实际采购金额，请参见本题之“一、发行人非经常性损益的主要内容”之“（三）公允价值变动损益”）

截至 2017 年 9 月 30 日，最低采购承诺余额为 14,344.02 万元，其中约 1,570 万美元（根据 2017 年 9 月 30 日即期汇率，该笔款项折合人民币约 10,416 万元，截至本反馈回复出具日，该笔款项尚未支付完毕）将作为第二合同年度补偿款支付给 SCT1、SCT3。该笔补偿支付完成后，最低采购承诺余额将大幅降低，对公司财务情况不再具有重大影响。公司对最低采购承诺公允价值变动损益不存在重大依赖。

3、可转换股东贷款公允价值变动损益：该事项属于公司要约收购星科金朋后的一次性事项，未来不会对公司的经营产生影响。

综上，公司对公允价值变动损益不存在重大依赖。

（四）公司对投资收益不存在重大依赖

1、权益法核算的长期股权投资损失：报告期内由于中芯长电（开曼）、华进半导体等仍处于亏损状态，公司权益法核算的长期股权投资仍处于损失状态，公司对其不存在依赖。

2、处置长期股权投资的投资收益：由于国富瑞主营业务与公司相关性不高，公司根据战略规划将其股权转让。该事项为一次性事项，公司不存在依赖处置长期股权投资收益的情形。

3、可供出售金融资产等产生的投资收益：公司持有的可供出售金融资产均为成本法核算的股权投资，相关投资收益主要来自于 JCI 对公司的分红。公司通

过 JCI 间接持有 APS 的股权，APS 主要业务为封装测试技术的前期研发。公司不以获取投资收益为目的投资 JCI，对其投资收益不存在依赖情形。

4、银行理财等利息收益：截至 2017 年 9 月 30 日，除子公司星科金朋持有的一笔可随时赎回的货币基金以及公司为提高资金利用效率购买的一笔期限为三个月的结构性存款（截至本反馈回复出具日，该笔存款已到期）外，公司不存在其他委托理财情形，且相关利息收益在报告期内金额较小。

因此，公司对投资收益不存在重大依赖。

（五）公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目不存在重大依赖

星科金朋于收购前形成的预提的税务风险已基本得到解决（具体情况请参见本反馈回复“一般问题五”之“一、发行人关于最近一期末预计负债的具体内容及其确认和计量是否符合会计准则相关规定的说明”），截至 2017 年 9 月 30 日，预计负债余额已经降低至 204.20 万元，金额较小，该事项后续对公司经营无重大影响。

综上，公司对其他符合非经常性损益定义的损益项目不存在重大依赖。

三、保荐机构的核查意见

保荐机构核查了公司历年的定期报告、相关政府补助的文件、最低采购承诺的估值报告等。经核查，保荐机构认为：发行人对政府补助等非经常性损益不存在重大依赖。

重点问题十二

12、请申请人补充说明：（1）申请人是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。（2）自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，有无未来三个月进行重大投资或资产购买的计划。

请保荐机构发表核查意见。

回复：

一、发行人是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形说明

截至 2017 年 9 月 30 日，公司可供出售金融资产金额为 2,584.35 万元，委托理财金额为 10,628.23 万元（其中星科金朋持有 2,628.23 万元的货币市场基金，长电科技持有 8,000 万元的结构性存款），无交易性金融资产及借予他人款项。

（一）可供出售金融资产的具体情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司可供出售金融资产明细情况如下：

单位：万元

项目	持股比例	2017/9/30	
		账面价值	减值准备
按成本计量的可供出售权益工具		2,584.35	-
其中：			
江阴大桥联合投资有限公司	0.09%	7.20	-
J C Investment Pte. Ltd.	19.06%	747.15	-
江阴芯智联电子科技有限公司	19.00%	1,830.00	-

公司可供出售金融资产均为按成本计量的股权投资，具体情况如下：

1、江阴大桥联合投资有限公司

江阴大桥联合投资有限公司成立于 2007 年 9 月，注册资本为 7,673.8058 万元，经营范围为利用自有资金对外投资。目前公司对江阴大桥联合投资有限公司出资 7.2 万元，占比 0.09%。

2、J C Investment Pte. Ltd. (JCI)

JCI 于 1997 年设立于新加坡，注册资本为 2,224.01 万新元，经营范围为投资控股。目前公司全资子公司长电国际持有其 19.06% 股权。

3、江阴芯智联电子科技有限公司

芯智联成立于 2015 年，注册资本为 17,000 万元，经营范围主要为新型集成电路先进封装测试技术的研发，集成电路先进封装测试材料的研发、生产、销售。

目前公司持有其 19% 股权。

上述可供出售金融资产合计金额为 2,584.35 万元，截至 2017 年 9 月 30 日，占公司期末总资产比例为 0.08%，占比较小。公司不存在持有金额较大、期限较长的可供出售金融资产的情形。

（二）委托理财的具体情况

截至 2017 年 9 月 30 日，公司委托理财情况如下：

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型
结构性存款	兴业银行	8,000 万元	2017.8.23-2017.11.21	保本浮动收益型
货币基金	卢森堡摩根大通新加坡元流动性基金	537.45 万新元	无 (随时可赎回)	非保本浮动收益

上述委托理财为公司为提高资金使用效率、最大化股东权益而进行的现金管理。截至本反馈回复出具日，长电科技的结构性存款已到期赎回；星科金朋的货币基金期末余额较小且随时可以赎回，不属于持有金额较大、期限较长的委托理财的情形。

综上，截至 2017 年 9 月 30 日，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。

二、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间，以及有无未来三个月进行重大投资或资产购买计划的说明

（一）重大投资或资产购买情况

自本次非公开发行相关董事会决议日（2017 年 9 月 28 日）前六个月起至本反馈回复出具日，除本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买交易如下：

序号	交易内容	交易金额	资金来源	交易完成情况
1	发行股份购买产业基金持有的长电新科 29.41% 股权、长电新朋 22.73% 股权	标的资产作价 265,500 万元	发行股份购买资产	2017 年 6 月完成资产过户

序号	交易内容	交易金额	资金来源	交易完成情况
	以及芯电半导体持有的长电新科 19.61% 股权			
2	公司全资子公司长电国际拟投资 3.5 亿元人民币(等值美元现金出资), 与其他投资方共同对芯鑫租赁以现金进行增资	35,000 万元	自有资金	2018 年 1 月完成缴付 50% 出资
3	对子公司长电新科、长电新朋进行增资, 再从长电新朋以资本金的形式投入新加坡 JCET-SC、星科金朋, 以偿还并购贷款和投向星科金朋的 eWLB 相关项目	209,550 万元	部分 2017 年发行股份购买资产配套募集资金和自有资金	2017 年 10 月完成对长电新科、长电新朋增资

(二) 未来三个月重大资产投资或购买计划

截至本反馈回复出具日, 除日常经营所需设备采购和募投项目投资外, 公司在未来三个月无重大投资或资产购买计划。如果公司在未来三个月内因外部环境变化或突发情况影响, 需要进行重大投资或资产购买的, 公司将通过自有资金或另行筹资等形式筹集所需资金, 并将依据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关规定做好信息披露工作。

三、保荐机构的核查意见

保荐机构核查了发行人审计报告、主要资产科目分类总账、定期报告、相关董事会决议及相关交易的合同, 了解了发行人的投资情况。

经核查, 保荐机构认为: 发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。未来三个月发行人无重大投资或资产购买的计划。

重点问题十三

13、截至最近一期末, 申请人账面价值为 95.8 亿元的固定资产已作为融资担保抵押给债权人, 截至最近一期末的短期借款及长期借款金额均较大。请申请人补充说明公司债务偿付计划及还款来源, 是否存在无法清偿的风险, 是否

影响公司的持续经营。

请保荐机构发表核查意见。

回复：

一、公司债务偿付计划及还款来源，是否存在无法清偿的风险，是否影响公司持续经营的说明

（一）公司债务情况

截至 2017 年 9 月 30 日，短期借款及长期借款（含一年内到期的长期借款）金额分别为 325,053.61 万元、452,152.10 万元，其中，境外经营主体星科金朋长期借款（含一年内到期的长期借款）金额为 235,647.25 万元。公司借款规模近年来增长幅度较大主要是因为公司于 2015 年收购星科金朋及之后星科金朋进行债务重组，以及公司近年来营业规模增加导致营运资金需求量和资本性支出规模提升等因素所致。

（二）公司已建立完善的资金管理制度

公司具备较完善的资金管理制度，根据公司《预算管理规范》制定年度、月度预算，并根据《筹资管理规范》、《资金管理规范》确定年度资金收支计划，确保所有债务按期偿付。

报告期内，长电科技在偿还银行债务、与客户往来方面不存在违约情况。

（三）公司还款来源及偿付计划，是否影响公司持续经营的说明

目前公司经营情况良好，资金周转正常、贷款偿付压力可控。公司主要还款来源及偿付计划如下：

1、公司拥有较为充裕的货币资金储备

截至 2017 年 9 月末，公司的货币资金余额为 293,301.88 万元，占总资产的比例为 9.36%，该等货币资金可用于资金周转和债务偿付，为公司正常经营和资金流转提供了支持和保障。

2、公司主要客户商业信用好，经营性现金流充足

报告期公司主营业务稳定发展，营业收入不断增加，主要客户为国际、国内的知名半导体企业，商业信用良好，应收账款周转率高。2014年、2015年、2016年和2017年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为104,851.87万元、174,594.62万元、266,928.32万元和261,843.90万元，公司稳定提升的经营性现金流为公司未来按时、足额偿付债务本息提供了保证。

3、加强直接融资，降低资产负债率

公司将加强直接融资，借助资本市场融资，降低资产负债率。公司本次非公开发行股票拟募集资金**40.5亿元**，其中**10.8亿元**将用于偿还银行贷款。本次非公开发行后，按照偿还**10.8亿元**银行贷款计算，公司资产负债率将降低至**60.88%**（以2017年9月30日数据为基准），偿债压力得到较大缓解。

4、公司银行授信额度充裕

截至2017年9月末，共有32家商业银行给予公司授信额度，授信额度总额为181.40亿元，其中尚未使用的授信余额为69.23亿元；并且公司与国家开发银行、中国进出口银行已经达成在融资方面的战略合作，与国家开发银行江苏省分行签署开发性金融合作备忘录，约定自2017年至2022年期间，双方在各类金融产品上的意向合作融资总量为160亿元人民币；与中国进出口银行江苏省分行签署战略合作协议，约定自2017年起的三年内，在政策允许范围内，中国进出口银行将为公司提供总额不超过100亿元人民币或等值美元的信贷支持。

5、来自于主要股东的支持

公司通过实施2017年发行股份购买资产并募集配套资金引入产业基金及芯电半导体成为公司第三大、第一大股东。其中产业基金系为促进国家集成电路产业发展而设立的国家产业投资基金，芯电半导体的最终控制方中芯国际拥有我国内地最强的芯片制造实力，两家股东资金实力雄厚。本次非公开发行中，上述股东将分别认购不超过29亿元和不超过6.5亿元金额的股份，继续支持公司发展。来自主要股东的支持也将为公司正常运营提供有力保障。

综合上述分析可以看出，公司的借款金额虽然较高，但公司具备充足的还款来源，公司对借款的偿付压力可控，无法偿付的风险较小；并且公司未来持续经

营所需要的资金也有明确切实可行的融资渠道来支持，因此，公司目前借款规模较大的情形对于公司持续经营的无重大不利影响。

（四）公司关于偿债风险的披露

公司已在《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》之“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”进行了偿债风险相关风险提示，具体如下：

“2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2017 年 9 月 30 日，公司合并口径的资产负债率分别为 73.83%、77.55%和 70.12%，远高于同行业可比上市公司。

公司与多家商业银行保持着良好的合作关系，拥有足够授信额度；主要客户为国际、国内的知名半导体企业，商业信用良好；同时公司针对应收账款建立了严格的管控制度，为偿付到期债务提供了可靠保障；本次非公开发行募集资金到位后也将降低公司资产负债率；但是公司仍然存在因资产负债率较高、债务本息偿还压力较大导致现金流紧张的风险。此外，公司为子公司提供担保的额度较大，存在承担担保连带责任的风险。”

二、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了公司报告期内的审计报告、《预算管理规范》、《筹资管理规范》、《资金管理规范》等公司资金管理制度，与相关资金业务负责人进行访谈，了解公司授信情况和资金管理情况。

经核查，保荐机构认为：报告期内，公司在偿还银行债务、与客户往来方面不存在违约情况；目前公司经营情况良好，资金周转正常，具有较为稳定且多元化的还款来源，无法正常偿付债务的风险较小，对于公司的持续经营无重大不利影响；同时公司在《二〇一七年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中也进行相关风险提示。

二、一般问题

一般问题一

1. 报告期内，申请人与子公司星科金朋的应收账款坏账准备计提政策不一致。请申请人补充说明：（1）母子公司坏账准备计提政策不一致的原因及合理性，子公司未按照母公司坏账准备计提政策进行调整是否符合企业会计准则的相关规定。（2）星科金朋应收账款金额较高且账龄均在一年以内的原因及合理性。

请申请人会计师补充说明子公司未按照母公司坏账准备计提政策进行调整是否符合企业会计准则的相关规定，并说明针对星科金朋应收账款余额及其账龄划分的真实准确性采取的主要核查程序，并发表明确意见。

请保荐机构对上述事项进行核查并发表明确意见。

回复：

一、母子公司坏账准备计提政策不一致的原因及合理性，子公司未按照母公司坏账准备计提政策进行调整是否符合企业会计准则相关规定的说明

根据企业会计准则，应收账款坏账准备计提属于会计估计。对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。对于单项金额非重大的应收款项可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

长电科技于 2015 年收购了星科金朋，在该次收购前，星科金朋（包括其子公司）作为境外公司，主要客户应收账款的信用期一般为 1-3 个月，结合星科金朋历史坏账发生情况，星科金朋应收账款的坏账准备计提政策为：以逾期账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，对逾期账龄超过一年的应收账款计提全额坏账准备。在该次收购后，因原长电科技与星科金朋的应收账款的信用风险特征不同，星科金朋保持其坏账准备计提政策不变。

由于原长电科技与星科金朋所处的地区及客户群不同，其应收账款的信用风险特征也不同。星科金朋客户群较为集中，且主要客户为全球前 20 大半导体公

司，信用好，应收账款账龄集中在一年以内；而原长电科技客户群相对较分散，且国内客户众多，应收账款账龄跨度较大且历史坏账损失高于星科金朋。为避免将不具有类似信用风险特征的应收账款分为同组，公司采用复合的分类标准，先将应收账款按不同的客户群体在原长电科技与星科金朋之间进行划分，再按照账龄进行分组。因此，该等坏账准备计提方式的不同符合企业会计准则的相关规定。

综上，原长电科技与星科金朋坏账准备计提政策的不同符合企业会计准则的相关规定。星科金朋保持其坏账准备计提政策不变是谨慎的。

二、星科金朋应收账款金额较高且账龄均在一年以内的原因及合理性

1、星科金朋应收账款金额较高的原因及合理性

星科金朋的应收账款周转天数在 60 天左右，与同行业的日月光、安靠、力成科技等国外知名半导体企业相比处于合理的水平。而星科金朋月均销售额在 6.5 亿元人民币左右。星科金朋截至 2015 年 12 月 31 日，2016 年 12 月 31 日及 2017 年 9 月 30 日的应收账款余额分别为 109,388 万元，142,363 万元和 114,667.61 万元，与按照前述应收账款周转天数及月均销售额所测算的应收账款余额相匹配。

2、星科金朋应收账款账龄均在一年以内的原因及合理性

星科金朋客户信用期主要集中在 1-3 个月。由于星科金朋客户主要为全球前 20 大半导体公司，信用好，回款快，因此应收账款基于信用期的账龄均在一年以内。

三、会计师关于子公司星科金朋未按照母公司坏账准备计提政策进行调整是否符合企业会计准则的相关规定的说明，以及会计师针对星科金朋应收账款余额及其账龄划分的真实准确性采取的主要核查程序，并发表明确意见

（一）子公司未按照母公司坏账准备计提政策进行调整符合企业会计准则的相关规定

根据企业会计准则，应收账款坏账准备计提属于会计估计。对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。对于单项金额非重大的应收款项可以与

经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

为避免将不具有类似信用风险特征的应收账款分为同组，公司采用复合的分类标准，先将应收账款在原长电科技与星科金朋之间进行划分，再按照账龄进行分组。

经核查，会计师认为根据企业会计准则，应收账款坏账准备计提属于会计估计，因原长电科技与星科金朋应收账款的信用风险不同，长电科技坏账准备计提政策采用上述复合的分类标准，符合企业会计准则的相关规定。

（二）针对星科金朋应收账款余额及其账龄划分的真实准确性采取的主要核查程序，并发表明确意见

长电科技于 2015 年 8 月收购了星科金朋，基于对长电科技 2015 年度及 2016 年度合并财务报表执行的审计程序，会计师针对 2015 年度及 2016 年度星科金朋应收账款余额及其账龄划分的真实准确性采取的主要核查程序如下：

（1）对星科金朋的信息技术一般控制和信息技术应用控制的有效性进行测试；

（2）了解、评估并测试星科金朋与收入确认及应收账款相关的内部控制，对该等内部控制有效性进行测试；

（3）获取应收账款基于信用期的账龄明细表，基于会计师对星科金朋与账龄准确性相关的信息技术和其他内部控制测试有效的结果，抽样检查应收账款账龄信息是否准确；

（4）获取应收账款按客户明细，比较报告期内各客户应收账款余额变动情况，针对余额变动较大的客户执行分析性复核程序；

（5）获取各客户信用期，结合报告期内主要客户销售情况，分析主要客户应收账款余额的合理性；

（6）计算应收账款周转天数，结合客户信用期的变化情况，分析应收账款

余额的合理性；以及

(7) 针对应收账款余额实施函证程序，结合替代程序及期后收款情况，验证主要客户期末应收账款余额的真实准确性。

基于上述核查程序，会计师认为，星科金朋 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日应收账款余额及其账龄划分是真实准确的。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了企业会计准则相关规定，核查了发行人的审计报告、应收账款明细表等。经核查，保荐机构认为：星科金朋被长电科技收购后未按照长电科技坏账准备计提政策进行调整符合企业会计准则的相关规定。星科金朋应收账款余额及账龄划分具有合理性。

一般问题二

2.截至最近一期末，申请人应付债券余额为 41.7 亿元，主要为子公司星科金朋发行在外的优先票据和永续债。请申请人结合上述债券的具体发行条款说明上述应付债券的会计处理方式，是否符合我国企业会计准则的相关规定。

请保荐机构及会计师发表核查意见。

回复：

一、星科金朋发行的优先票据和永续债的会计处理方式及符合我国企业会计准则相关规定的说明

截至 2017 年 9 月 30 日，公司应付债券余额具体内容如下：

单位：万元

项目	债券发行主体	2017年 9月30日	2017年 6月30日	2016年 12月31日
2020年到期的优先票据	星科金朋	275,958.44	281,277.89	338,876.98
永续债	星科金朋	132,738.00	135,488.00	138,740.00
合计		408,696.44	416,765.89	477,616.98

(一) 优先票据

星科金朋于 2015 年 11 月 24 日，发行了将于 2020 年 11 月 24 日到期的优先票据。本次发行的票据面值共计 4.25 亿美元，年利息率为 8.5%，每半年付息一次。

上述优先票据的其他主要条款如下：

1、该优先票据作为星科金朋的优先债务，与星科金朋现有及将来的所有优先债务在偿付顺序上享有至少同等地位。

2、该优先票据按年利率 8.5% 计息，自 2016 年 5 月 24 日起于每年 5 月 24 日及 11 月 24 日派息。如有逾期的利息未支付，将以 9.5% 的年利率计息。

3、于 2018 年 11 月 24 日前，星科金朋随时可以 108.5% 的本金加应计及未付利息（如有）的赎回价提前赎回最多 35% 的上述票据。于 2018 年 11 月 24 日之后，星科金朋需提前 30-60 天公告赎回全部或部分票据，以本金的固定比例加应计及未付利息（如有）的赎回价提前赎回票据（2018 年 11 月 24 日开始的十二个月期间内赎回时，比例为 104.25%；2019 年 11 月 24 日及以后赎回时，比例为 102.125%）。

根据企业会计准则规定，公司将优先票据分类为其他金融负债，计入了应付债券科目，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，符合我国企业会计准则的相关规定。

（二）永续债

2015 年长电科技收购星科金朋时，星科金朋向原控股股东 Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd (“STSP”) 及其他投资者发行了两亿美元的永续证券 (Perpetual Securities)。

上述永续证券的主要条款如下：

1、利息：自发行日起，前三年每年单利 4%，第三年末起上升到 8%，此后每年上升 1%，最高达到 12%。星科金朋有权选择延期支付利息。若星科金朋在第四年年初仍未偿还该永续证券，则该笔永续证券将转为复利计息。

2、如果星科金朋违反该永续证券的条款规定，触发违约，或者星科金朋的

其他债务发生违约（即交叉违约的情况），那么该永续证券的分配率将立刻上升至 12%。

3、星科金朋还需要满足以下条件：（1）向包括 STSPL 在内的永续证券持有人及时提供星科金朋的年度及季度财务信息，该财务信息需要按照新加坡会计准则或其他适用的准则进行编制，并于会计年度结束后 120 天内向永续证券持有人提供由国际认可的独立审计师出具的审计报告；（2）在发生关联交易的情况下，需按约定告知永续证券持有人；（3）在替换星展银行过桥贷款时，需要尽合理努力争取赎回永续证券，但若无法赎回，亦不构成违约。

4、该永续证券为永久性证券，无固定赎回日期，星科金朋有权随时赎回该永续证券。

5、若星科金朋发生违约或者三年后仍未偿还本金，永续证券持有人有权按照持有的永续证券规模占所有债务规模的比例向星科金朋委派董事，委派董事的数量向下取整，但至少一名，且不得超过半数董事。且对于所有需要星科金朋股东表决的事项，均需事先获得合计持有 50% 以上永续证券面值的持有人的书面同意。

根据企业会计准则，如果企业不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。由于长电科技出具担保承诺，若星科金朋三年后仍无法赎回上述永续证券，永续证券持有人有权将所有永续证券出售给长电科技，长电科技作为永续证券担保人将按照出售价格偿付包括永续证券本金及所有应付未付的利息。因此无论星科金朋是否主动赎回该永续证券，长电科技都不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行该合同义务，所以公司合并财务报告层面将该永续证券确认为金融负债，符合我国企业会计准则的相关规定。

二、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了优先票据和永续债相关的文件及相应企业会计准则规定。经核查，保荐机构认为：发行人对上述优先票据及永续债的会计处理符合企业会计准则的规定。

三、会计师的核查意见

经核查，会计师认为：星科金朋优先票据及永续债的会计处理方式与会计师在审计长电科技 2015 年度、2016 年度合并财务报表的过程中了解到的情况一致，符合企业会计准则的相关规定。

一般问题三

3. 最近一期末，申请人应收账款和存货金额较高，请申请人补充说明应收账款及存货的主要内容，相关减值准备计提政策，减值计提是否充分合理。

请保荐机构和会计师发表核查意见。

回复：

一、应收账款的主要内容

截至 2017 年 9 月 30 日，公司应收账款的账面余额为 299,638.09 万元。应收账款的主要内容为销售芯片与提供芯片封测服务而应收货款。公司主要客户均为国内外知名半导体企业，客户商业信用良好。

公司客户数量众多，应收账款也相应较分散，截至 2017 年 9 月 30 日，其中余额前五大客户的金额及占比如下：

客户	应收账款余额（万元）	占应收账款余额的比例
客户一	30,318.69	10.12%
客户二	25,275.02	8.44%
客户三	23,026.34	7.68%
客户四	16,453.94	5.49%
客户五	12,832.01	4.28%
合计	107,906.00	36.01%

二、应收账款相关减值准备计提政策及减值计提是否充分合理的说明

公司应收账款坏账准备计提政策如下：

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的判断标准：存在客观证据表明公司将无法按应收账款的

原有条款收回款项。金额人民币 1,000 万元以上（含）的应收账款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

除星科金朋外，公司以账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，并采用账龄分析法对应收账款计提坏账准备比例如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例(%)
1 年以内（含）	5
1 至 2 年（含）	10
2 至 3 年（含）	20
3 至 5 年（含）	50
5 年以上	100

星科金朋及其子公司以逾期账龄作为信用风险特征确定应收账款组合，对逾期账龄超过一年的应收款项计提全额坏账准备，如有客观证据表明应收账款的价值已经恢复，则原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

公司上述应收账款坏账准备计提政策基于各子公司应收账款按类似信用风险特征的组合在历史期间的实际损失率确定。基于对公司历史期间应收账款实际损失率的分析，公司应收账款坏账准备计提政策是合理的。

三、存货的主要内容

截至 2017 年 9 月 30 日，公司存货的账面价值为 235,897.23 万元。存货主要由原材料、在产品及自制半成品、库存商品、低值易耗品构成，具体明细如下：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	计提比例
原材料	114,617.03	3,066.21	111,550.81	2.68%
在产品及自制半成品	71,545.80	-	71,545.80	-
库存商品	47,741.65	615.05	47,126.60	1.29%
低值易耗品	5,674.01	-	5,674.01	-
合计	239,578.49	3,681.27	235,897.23	1.54%

截至 2017 年 9 月 30 日，公司存货主要为芯片、引线框、印刷电路板、分立器件、集成电路等，主要存货跌价准备计提情况如下：

1、原材料跌价准备主要内容及计提原因

公司原材料按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。原材料的可变现净值以其估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

2、库存商品跌价准备主要内容及计提原因

库存商品跌价准备主要为部分自销分立器件计提的减值准备。公司按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。库存商品的可变现净值以其估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

四、存货相关减值准备计提政策及减值计提是否充分合理的说明

（一）发行人存货跌价准备的计提符合会计准则的相关规定

公司根据《企业会计准则 1 号——存货》的规定，对 2017 年 9 月 30 日结存的存货进行减值测试。存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，对于其他数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提，其他存货按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

公司对 2017 年 9 月 30 日的存货已进行减值测试。公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。公司的存货跌价准备计提政策符合企业会计准则规定，是合理的。截至 2017 年 9 月 30 日，公司存货跌价准备账面余额为 3,681.27

万元，系按照公司存货跌价准备计提政策计提。结合公司历史期间存货减值的实际发生情况，公司计提的存货跌价准备是充分的。

（二）发行人存货跌价准备计提比例的同行业比较

截至 2017 年 6 月 30 日，长电科技同行业可比上市公司关于存货跌价准备计提比例的比较如下表所示：

单位：万元

股票代码	公司简称	存货账面余额	存货跌价准备	计提比例
002185.SZ	华天科技	112,301.47	1,107.67	0.99%
002156.SZ	通富微电	102,434.92	5562.48	5.43%
603005.SH	晶方科技	6,892.44	0.00	0.00%
600584.SH	长电科技	201,602.65	3,642.39	1.81%

注：因同行业可比上市公司未披露三季度财务报告附注，故使用 2017 年 6 月 30 日数据进行对比。2017 年 6-9 月，公司存货状况无重大变动。

从上表可以看出，长电科技截至 2017 年 6 月 30 日的存货跌价准备的计提比例为 1.81%，高于华天科技和晶方科技，低于通富微电，基本处于同行业可比上市公司的平均水平，具有合理性。截至 2017 年 9 月 30 日，长电科技存货跌价准备计提比例为 1.54%，仍高于华天科技和晶方科技截至 2017 年 6 月 30 日的存货跌价准备计提比例，具有合理性。

（三）发行人存货周转率高于同行业可比上市公司

发行人在有效控制存货合理余额，保障生产经营供应的情况下，加强对存货的管理，降低存货跌价损失。

发行人与同行业可比上市公司存货周转率对比如下：

年份	通富微电	华天科技	晶方科技	同行业平均	长电科技
2016 年	6.39	6.38	8.39	7.06	10.55
2015 年	5.86	7.04	7.89	6.93	8.39
2014 年	6.19	8.32	6.40	6.97	7.08

注：由于存货周转率为年度数据，表格中未列示 2017 年 1-9 月数据。

报告期内，发行人的存货周转率明显高于同行业可比上市公司平均水平，体现出良好的存货管控能力。发行人通过对存货的良好管控来降低存货跌价损失。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：发行人应收账款坏账准备与存货跌价准备计提政策符合企业会计准则的相关规定，减值准备计提充分、合理。

六、会计师的核查意见

经核查，会计师认为：公司应收账款坏账准备计提政策与存货跌价准备计提政策是合理的，与会计师在2015年度及2016年度审计过程中了解到的情况一致。

一般问题四

4.最近一期末，申请人长期股权投资金额为2.2亿元，报告期内，除最近一期外，申请人对联营企业和合营企业的投资收益均为负值。请申请人补充说明被投资企业运营情况，并结合其运营情况说明长期股权投资减值准备计提是否充分合理。

请保荐机构和会计师发表核查意见。

回复：

一、被投资企业运营情况

报告期内，公司长期股权投资情况如下：

单位：万元

被投资单位名称	截至2017年9月30日持股比例	2017/9/30	2016/12/31	2015/12/31	2014/12/31
国富瑞数据系统有限公司	-	-	5,294.77	4,645.77	3,895.15
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	9.48%	1,038.57	1,009.68	1,173.67	1,479.15
江阴达仕新能源科技有限公司	40.62%	3,643.48	3,728.40	3,863.76	-
SJ Semiconductor Corporation	8.65%	17,827.02	18,624.54	17,017.48	14,731.32
合计		22,509.07	28,657.39	26,700.68	20,105.62

被投资企业运营情况如下：

1、国富瑞

国富瑞主要从事云计算基础设施建设及运行服务、数据中心及网络安全服务

以及云计算服务等业务。国富瑞的主要产品包括 IDC（互联网数据中心）基础架构服务及其他以数据中心基础设施外包服务为核心的增值服务，如 IT 运维外包服务、数据中心建设咨询、数据中心测试评估、系统集成服务等。

鉴于国富瑞主营业务与公司主营业务相关性不高，为聚焦主业，于 2017 年 3 月 13 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于长电科技出售持有的国富瑞数据系统有限公司 19.99% 股权的议案》，同意公司向国富商通信息技术发展股份有限公司转让国富瑞 19.99% 股权，转让价格以国富瑞 2016 年经审计财务报表为依据，经双方协商确定为人民币 14,000 万元，产生投资收益人民币 8,685.78 万元。

公司已收到全部转让价款，国富瑞已于 2017 年 5 月办理完毕股权转让工商变更登记手续。

2、华进半导体

华进半导体主要从事 12 英寸先进封装工艺研发和技术服务，为国内外中高端芯片企业、系统厂家、设备和材料厂家等提供合作开发服务、技术服务和加工服务等。

华进半导体目前主要产品为 12 寸 TSV 硅转接板，硅通孔最大深宽比为 10:1，适合于高密度及高集成度芯片和系统级封装，是未来处理器、内存模块、人工智能芯片等高端产品的核心封装工艺之一。华进半导体可提供成套工艺流片代工及从设计开始客制化的一站式服务及基于硅转接板的 2.5D 封装，华进半导体的相关技术已达到国际水平、国内领先，并且有完善的专利储备。

华进半导体于 2012 年底成立，由于前期主要进行基础改造、设备购置，且作为研发型企业投入周期较长，故出现一定程度亏损。自 2015 年以来，华进半导体亏损额逐年减少且营业收入有较快增长。通过调整经营策略、业务方向，重视市场开拓、科研项目立项及成本控制，华进半导体于 2017 年 1-9 月已实现盈利。

3、达仕新能源

达仕新能源设立于 2014 年，除发生少许开办费用外，截至 2017 年 9 月 30

日达仕新能源尚未正式开展业务。达仕新能源经营范围包括：从事新能源技术的研究、开发及相关技术转让；太阳能电池及组件、自动化设备及配件的制造、加工；从事上述产品的批发及进出口业务；提供相关的技术咨询、安装维修服务。

4、中芯长电（开曼）

中芯长电（开曼）通过中芯长电（香港）控股中芯长电（江阴），中芯长电（江阴）为其实际经营主体，主要从事中段硅片制造业务，加工后仍形成以 12 英寸晶圆片的产品形式，主要为中芯国际提供配套封装服务，未来将向 2.5D、3D 芯片系统集成方向发展。中芯长电（江阴）已达到领先的中段加工企业标准。

由于前期投入大，中芯长电仍处于亏损状态。但近三年均有投资者看好中芯长电未来发展，以较高估值水平认购中芯长电新增股份。2016 年，中芯长电实现营业收入 1,278.21 万美元；2017 年 1-9 月，中芯长电实现营业收入 1,376.06 万美元（未经审计），且第三季度已实现单季度盈利（未经审计）。随着未来量产规模的扩大，中芯长电预计将逐步实现盈利。

二、长期股权投资减值准备计提是否充分合理的说明

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》第十八条，投资方应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，投资方应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

单位：万元

联营企业	2017/9/30 被投资公司所有者权益账面价值	投资比例	按投资比例享有的份额	长期股权投资账面价值	长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额
华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	13,252.10	9.48%	1,256.30	1,038.57	否
江阴达仕新能源科技有限公司	5,817.37	64.01%	3,723.62	3,643.48	否
SJ SEMICONDUCTOR	206,271.34	8.65%	17,842.47	17,827.02	否

联营企业	2017/9/30 被投资公司所有者权益账面价值	投资比例	按投资比例享有的份额	长期股权投资账面价值	长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额
CORPORATION					

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、江阴达仕新能源科技有限公司和中芯长电（江阴）2015 年度及 2016 年度财务报表均已经审计，并由注册会计师出具标准无保留意见。

最近一期末，公司对华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、江阴达仕新能源科技有限公司和 SJ SEMICONDUCTOR CORPORATION 的长期股权投资账面价值小于享有对其所有者权益账面价值的份额。此外，公司管理层未发现上述长期股权投资出现减值的其他迹象。

综上所述，最近一期末，长期股权投资减值准备计提充分合理，符合企业会计准则相关规定。

三、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了相关被投资公司的营业执照、公司章程及审计报告，了解了相关公司的运营情况。经核查，保荐机构认为：上述被投资企业运营情况正常，发行人长期股权投资减值准备计提充分合理。

四、会计师的核查意见

经核查，会计师认为：在对长电科技 2015 年度及 2016 年度合并财务报表进行审计过程中，会计师按照中国注册会计师审计准则对上述长期股权投资执行了审计程序，会计师认为于 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日公司对上述长期股权投资的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的要求。

一般问题五

5.请申请人补充说明最近一期末预计负债以及衍生金融负债中“最低采购承

诺”的具体内容，其确认和计量是否符合会计准则的相关规定。

请保荐机构和会计师发表核查意见。

回复：

一、发行人关于最近一期末预计负债的具体内容及其确认和计量是否符合会计准则相关规定的说明

截至 2017 年 6 月 30 日，公司预计负债余额为 12,332.89 万元，主要内容为 2015 年 8 月公司收购星科金朋之前，星科金朋针对其子公司星科金朋上海厂 SCC 和星科金朋韩国厂 SCK 历史期间通过 BVI 子公司销售给第三方客户交易相关的转让定价税务风险进行了计提并确认为预计负债。

该转让定价相关的税务风险属于特别纳税调整事项，公司在编制财务报表时，以其能够取得的可靠信息对该特别纳税事项进行了相应的会计处理，其确认和计量符合会计准则相关规定。

伴随近年经济合作与发展组织（OECD）“税基侵蚀与利润转移”（BEPS）行动计划在全球的持续推进，中国国家税务总局分别于 2016 年 6 月 29 日和 2017 年 3 月 17 日发布了第 42 号公告和第 6 号公告。上述最新颁布的转让定价法规强调价值链分析方法的重要性。长电科技 2017 年度重新评估了相关转让定价税务风险，聘请了专业税务顾问协助其与主管税务机关进行沟通和协商，并以自行调整的方式进行补税。其中：

1、针对星科金朋上海厂（SCC），在经过多次材料递交、解释说明并与上海市青浦区国家税务局的若干次协商后，公司就转让定价自行调整方案与上海市青浦区国家税务局达成基本一致意见。SCC 于 2017 年 7 月 31 日，就 2006-2015 年度转让定价事项进行自行调整并补缴企业所得税及其利息共计人民币 38,249,726.32 元，该税款及利息已于当天缴纳入库并收到《税收完税证明》，消除了 SCC 转让定价风险。

2、针对星科金朋韩国厂（SCK），就 2013-2015 年转让定价调整方案与韩国首尔税务局达成基本一致意见后，于 2017 年 9 月支付了转让定价相关的税金约 163 万美金（折合人民币 1,082 万元），消除了 SCK 转让定价风险。

通过上述措施,截至 2017 年 9 月 30 日,公司预计负债余额已经降低为 204.20 万元。

二、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:发行人预计负债系星科金朋被发行人收购之前的历史期间形成,其确认和计量符合会计准则的相关规定。

三、会计师的核查意见

在对长电科技 2015 年及 2016 年度合并财务报表进行审计过程中,会计师按照中国注册会计师审计准则对上述预计负债执行了审计程序,会计师认为:于 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日公司对预计负债的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的要求。

四、发行人最近一期末衍生金融负债中“最低采购承诺”的具体内容及其确认和计量是否符合会计准则相关规定的说明

关于“最低采购承诺”的具体内容,请参见本反馈回复“重点问题十一”之“一、发行人非经常性损益的主要内容”之“(三)公允价值变动损益”之“1、最低采购承诺公允价值变动收益”。“最低采购承诺”的确认和计量符合会计准则的相关规定。

五、保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:发行人对最低采购承诺的确认和计量符合会计准则的相关规定。

六、会计师的核查意见

在对长电科技 2015 年及 2016 年度合并财务报表进行审计过程中,会计师按照中国注册会计师审计准则对上述衍生金融负债执行了审计程序,会计师认为于 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日公司对衍生金融负债的会计处理在所有重大方面符合企业会计准则的要求。

一般问题六

6. 申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果及对本次发行的影响发表核查意见。

回复：

一、申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施

公司已于 2018 年 2 月 1 日公开披露了《江苏长电科技股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告》，对最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行披露，主要内容如下：

“经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。”

二、保荐机构的核查意见

保荐机构查阅了发行人在上海证券交易所网站披露的定期报告及其他公告文件，在上海证券交易所监管措施栏目、上市公司诚信档案栏目以及中国证监会网站、证券期货市场失信记录查询平台、江苏证监局等相关网站上对发行人进行了信息检索。

经核查，保荐机构认为：发行人最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况，也不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

(本页无正文,为《江苏长电科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》之签字盖章页)

江苏长电科技股份有限公司

2018年3月13日

(本页无正文,为《江苏长电科技股份有限公司与中银国际证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》之签字盖章页)

保荐代表人:

俞露

姚帅君

中银国际证券股份有限公司

2018年3月13日

保荐机构执行总裁关于反馈意见回复的声明

本人已认真阅读江苏长电科技股份有限公司本次反馈意见回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

法定代表人（执行总裁）：_____

宁敏

中银国际证券股份有限公司

2018年3月13日